



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

股票代號：6488

環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

114 年度年報

年報查詢網址：

公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>

本公司網址 <http://www.sas-globalwafers.com>

環球晶圓股份有限公司 編製

中華民國 115 年 3 月 31 日刊印

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：彭欣瑜
職稱：董事長特別助理
電話：(03)577-2255
電子郵件信箱：GWCIR@sas-globalwafers.com
代理發言人姓名：黃琮芸
職稱：董事長室主任管理師
電話：(03)577-2255
電子郵件信箱：GWCIR@sas-globalwafers.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司及工廠：新竹科學園區新竹市工業東二路8號；電話：(03) 577-2255
竹南工廠：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路21號；電話：(03) 577-2255
竹南二廠：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號1、3樓；電話：(03) 577-2255
篤行工廠：新竹科學園區新竹市篤行路6-5號1樓；電話：(03) 577-2255
中德分公司
竹科工廠：新竹科學園區新竹市研新一路2號；電話：(03) 578-3131
兆遠子公司
竹南新廠：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號1、4樓；電話：(037) 585-058

日本子公司

新潟工廠：新潟県北蒲原郡聖籠町東港6-861-5；電話：(+81) (25) 256 3200
徳山工廠：山口県周南市江口2-1-32；電話：(+81) (834) 41 3001
関川工廠：新潟県岩船郡関川村大字辰田新278；電話：(+81) (254) 64 0254
小國長晶中心：山形県西置賜郡小国町大字小国町378；電話：(+81) (238) 62 5926
宇都宮工廠：栃木県清原工業団地11-2；電話：(+81) (28) 667 6333

韓國子公司

天安工廠：854, Manghyang-Ro, Seonggeo-eup, Sebuk-gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-do, 331-831 Korea
電話：(+82) 41 550 4114

大陸子公司

昆山工廠：江蘇省昆山市城北高科技工業園區漢浦路 303 號；電話：(+86) 512 5778 1262
上海工廠：上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區；電話：(+86) 21 5990 1388
忻州工廠：山西省忻州市開發區正丰街南半導體產業園區；電話：(+86) 350 3305 557

馬來西亞子公司

吉隆坡工廠：Jalan SS 8/2, Sungai Way Free Industrial Zone, 47300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
電話：(+603) 7877 3277

新加坡子公司

Block D #01-41A, 11 Lorong 3 Toa Payoh, Singapore 319579；電話：(+65) 6361 9720

美國子公司

德州工廠：200 F.M. 1417 West Sherman, Texas, USA 75092；電話：(+1) 903 957 1999
密蘇里工廠：501 Pearl Drive, St. Peters, Missouri, USA 63376；電話：(+1) 636 474 5000
德州新廠：3200 Northgate Drive, Sherman, Texas, USA 75092；電話：(+1) 903 957 3700

義大利子公司

美拉諾工廠：Via Nazionale, 59, 39012 Merano (Bolzano), Italy；電話：(+39) 0473 333 333
諾瓦拉工廠：Viale Gherzi, 31, 28100 Novara, Italy；電話：(+39) 0321 33 4444

丹麥子公司

哥本哈根工廠：Siliciumvej 1, 3600 Frederikssund, Copenhagen, Denmark；電話：(+45) 47 36 56 00

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
地址：臺北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
網址：<http://www.yuanta.com.tw>
電話：(02) 2586-5859

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：吳俊源會計師、黃泳華會計師
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地址：台北市信義路五段7號68樓
網址：<http://www.kpmg.com.tw>
電話：(02) 8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

海外存託憑證：盧森堡交易所；<https://www.luxse.com/security/US37891E1038/250465> (Reg S GDS)
<https://www.luxse.com/security/US37891E2028/399669> (Rule 144A GDS)

六、公司網址：<http://www.sas-globalwafers.com>

目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	6
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	17
三、公司治理運作情形.....	23
四、簽證會計師公費資訊.....	88
五、更換會計師資訊.....	88
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	88
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	88
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係資訊.....	89
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	90
參、募資情形.....	91
一、資本及股份.....	91
二、公司債辦理情形.....	95
三、特別股辦理情形.....	96
四、海外存託憑證辦理情形.....	97
五、員工認股權憑證辦理情形.....	98
六、限制員工權利新股辦理情形.....	98
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	98
八、資金運用計畫執行情形.....	98
肆、營運概況.....	99
一、業務內容.....	99
二、市場及產銷概況.....	110
三、從業員工資訊.....	118
四、環保支出資訊.....	118
五、勞資關係.....	119
六、資通安全管理.....	122
七、重要契約.....	125
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	126

一、財務狀況.....	126
二、財務績效.....	127
三、現金流量.....	128
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	128
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	128
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....	130
七、其他重要事項.....	134
陸、特別記載事項.....	135
一、關係企業相關資料.....	135
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	135
三、其他必要補充說明事項.....	135
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	136

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

感謝大家撥冗參加環球晶圓股份有限公司 115 年度股東大會，也謝謝大家對本公司的支持與愛護。

114 年為半導體產業修復與轉折並行的一年，整體需求復甦呈現明顯分歧。受惠於 AI 與高效能運算相關應用持續擴展，先進製程與高階晶圓需求相對穩定，為整體營運提供基本支撐；然而，成熟製程需求回升力道較預期緩慢，終端需求能見度有限，拉貨動能仍偏保守，整體復甦節奏不均。整體半導體市場成長動能由高價值的 AI 相關產品所驅動，營收組合以出貨量為主轉向以價格與價值為核心，致使晶圓出貨量回升速度較溫和。此外，114 年匯率波動劇烈，環球晶圓因於全球多地設有營運據點，外幣交易比重較高，台幣升值對帳面營收與獲利表現帶來換算壓力；惟若以美元計價之全年合併營收則仍與去年持平，顯示整體動能穩定。環球晶圓 114 年全年的合併營收為新台幣 60,597,938 仟元，年減 3.24%，營業毛利新台幣 14,623,541 仟元，營業淨利新台幣 8,636,332 仟元，稅前淨利新台幣 9,516,376 仟元，稅後淨利為新台幣 7,311,661 仟元，稅後每股盈餘為 15.29 元。以下謹就 114 年度營業成果、115 年度營業計畫概要、未來公司發展、受到外部競爭、法規環境及總體經濟環境之影響等，概要報告如述：

一、114 年度營業成果

(一) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

年度 項目	114 年度	113 年度	增減百分比(%)
	(IFRSs)	(IFRSs)	
營業收入	60,597,938	62,626,004	-3.24%
營業成本	45,974,397	42,822,503	7.36%
營業毛利	14,623,541	19,803,501	-26.16%
營業費用	5,987,209	5,685,316	5.31%
營業淨利	8,636,332	14,118,185	-38.83%
稅前淨利	9,516,376	12,428,566	-23.43%
本期淨利	7,311,661	9,838,780	-25.69%

(二) 預算執行情形：本公司 114 年度無公告財務預測。

(三) 獲利能力分析

項 目		114 年度	113 年度	
財務 結構	負債佔資產比率	57.27%	59.47%	
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	153.14%	133.96%	
獲利 能力 分析	資產報酬率	3.70%	5.09%	
	權益報酬率	7.93%	12.50%	
	占實收資本比率	營業利益	180.63%	295.29%
		稅前純益	199.04%	259.95%
	純益率	12.07%	15.71%	
稅後每股盈餘 (元)	15.29	21.06		

(四) 財務收支情形

本公司 114 年度營業收入新台幣 60,597,938 仟元，營業成本新台幣 45,974,397 仟元，營業費用新台幣 5,987,209 仟元，營業外收支淨額為淨收入新台幣 880,044 仟元，稅前淨利新台幣 9,516,376 仟元，稅後淨利新台幣 7,311,661 仟元，財務收支正常。

(五) 研究發展狀況

1. 114 年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

項目/年度	114 年度	113 年度
研發費用	2,217,644	2,317,220
營業收入淨額	60,597,938	62,626,004
研發費用占營收淨額之比例	3.66%	3.70%

2. 114 年度研究發展成果：

技術或產品名稱

- (1) 12吋方形矽晶片
- (2) 12吋散熱應用碳化矽晶圓
- (3) 12吋碳化矽晶圓切割技術
- (4) 大尺吋碳化矽晶圓平坦化技術
- (5) 廢棄切割漿料回收再利用技術
- (6) 拋光液循環優化技術

- (7) 即時營運可視化與派工自動化平台系統開發
- (8) 影像邊緣量測自動回授系統開發
- (9) 大尺寸熱場跨徑設計開發
- (10) 研磨形貌控制自動回授系統
- (11) 奈米尺度表面形貌控制技術

3. 未來研究發展計劃：

- (1) 次世代高功率車用電子元件用碳化矽晶圓
- (2) GaN_HEMT用磊晶晶圓
- (3) 矽光子SOI晶圓
- (4) 高電阻ECAS晶圓襯底接合晶圓
- (5) 12吋鑽石線切割製程開發
- (6) 次世代3D記憶體用矽晶圓
- (7) 8吋碳化矽磊晶開發
- (8) 新世代碳化矽晶體生長爐
- (9) 先進封裝應用客製化特殊晶圓

二、115年度營業計畫概要

(一) 經營方針

- (1) 積極掌握市場趨勢及國際情勢，在政治及關稅政策影響下靈活調度產品生產，穩定出貨、滿足客戶需求。
- (2) 積極提升良率、解決瓶頸站點以最大化現有產能，謹慎控制資本支出，確保擴產計畫如期完成。
- (3) 持續研發新產品並與策略夥伴合作，發揮材料互補綜效。
- (4) 廣泛產官學合作，佈局利基型應用先進製程，快速提升新技術之開發能量。
- (5) 強化各事業體之營運績效，跨地整合研發、生產、行銷等，發揮最大效益。

(二) 預估銷售數量及其依據

根據世界半導體貿易統計協會（WSTS, World Semiconductor Trade Statistics）報告，全球半導體市場於 2025 年延續成長趨勢，全年市場規模約達 7,720 億美元，反映產業需求在運算相關應用帶動下持續回升。

該機構分析，2025 年市場成長仍主要由邏輯與記憶體兩大領域推動，其中邏輯產品維持最大市場規模並呈現顯著成長，記憶體則延續需求回升趨勢，持續支撐整體市場擴張。相較之下，分立元件、光電子元件、感測器及類比半導體等產品則呈現較為溫和的回升，顯示終端市場復甦節奏仍存在差異。就各區域表現來看，WSTS 預期 2025 年各主要市場均維持成長，其中美洲與亞太地區受惠於運算需求與電子市場回升，動能相對較

強，而歐洲與日本市場則呈現穩定發展態勢。

展望 2026 年，WSTS 預期全球半導體市場仍將維持成長趨勢，市場規模可望逼近 1 兆美元。該機構指出，未來市場成長動能仍將由邏輯與記憶體產品帶動，並可望逐步擴散至更多產品與應用領域。

由於總體經濟、世界情勢與各國匯率仍快速變遷，尚不確定對全球半導體之影響，以上為僅能依據目前狀況所做的最佳預測。

（三）重要產銷政策

- (1) 積極投入大尺寸半導體晶圓及特殊產品（化合物半導體、SOI、FZ）開發，以先進技術及產品擴大領先優勢，迅速切入新興應用及先進製程。
- (2) 謹慎控制通貨膨脹造成的成本上漲、穩定關鍵原料與零件供應來源，確保生產順暢。
- (3) 運用遍布全球的廣泛據點，彈性調度產能以就近供應客戶。
- (4) 持續研發專利並進行戰略佈局，以強化競爭優勢的核心基礎。
- (5) 將擴產產能迅速上線，取得客戶認證，並加速先進製程產品發展，以掌握產業發展趨勢。

（四）未來公司發展策略

- (1) 落實綠色製造、實踐企業社會責任、完備公司治理，建構永續經營基礎。
- (2) 藉由採用再生能源、提升能源使用效率、碳清除與購買碳補償商品，達到 2040 年前 100%使用再生能源。
- (3) 建構具有韌性及彈性的在地供應鏈，建立多元供應商，敏捷因應疫情及地緣政治衝擊。
- (4) 透過擴產以增加營運規模，同時緊密掌握產業動向、積極爭取政府補助，提升在半導體晶圓產業的競爭力。
- (5) 與重要合作夥伴積極簽訂長期合作計畫以鞏固合作基礎。

（五）受到外部競爭、法規環境及總體經濟環境之影響

- (1) 隨著半導體產業的發展與應用，其相關產品已深入人們的日常生活，舉凡食、衣、住、行、育、樂均可見到半導體產品的運用，因此半導體產業景氣跟總體經濟有相當程度的連結。由於公司的客戶群廣泛，終端產品遍及各產業及應用領域，如車用產品、電源類產品、記憶體等等…，可降低單一產業景氣循環的風險，因此當總體經濟不佳時，公司尚能藉此分散風險，使營運維持穩定。
- (2) 半導體晶圓產業累積數十年的發展，在技術、專利等各方面均建立起相當程度的進入門檻，但面對有雄厚資金的新競爭者，我們將時時密切觀察產業發展。為免新進廠商積極加入而引導產品售價下跌影響銷售及獲利，以既有基礎持續結合本公司全球各地的技術優勢，以核心技術能力開發利基產品，提升產品附加價值，並將成本極小化，以增加獲利空間。

- (3) 近期國際情勢變化劇烈、關稅及地域性貿易衝突亦對總體經濟帶來不小震盪，然環球晶圓在全球各地皆設有生產據點，將彈性調度生產以因應相關法規、降低貿易關稅對營運成本之影響；遍佈全球各區域的客戶也能有效分散其對營收帶來的衝擊並降低單一地區的經濟風險，環球晶圓亦與客戶及供應商維持緊密關係，建立具有韌性的在地供應鏈及 BCP（繼續營運計畫），彈性因應各項挑戰。
- (4) 碳中和已經是國際關注的重要議題，政府法規、投資機構，客戶及貿易夥伴的國家政策對於節能減碳的規範也越趨嚴格，減碳不僅是環保層次、更是經濟層次，電力成本及出口地的碳關稅嚴格考驗企業生存能力。環球晶圓致力於優化現有設備，同時也導入各項節能措施，以對環境更友善的方式生產。另外，母公司中美矽晶作為綠色能源全方位供應商（Green Energy Total Solution Provider），可利用其豐富經驗與垂直整合供應鏈優勢、協助集團興建太陽能電廠以增加綠色能源發電量，並以旗下續興能源協助媒合綠電需求。環球晶圓的新蓋廠區也在興建時期便導入各項節能設備及方案以降低能耗、並綜合運用各項綠色方案、擴大綠電使用比例，亦同時監控極端氣候所帶來的各項衝擊，將營運風險降到最低。

展望 115 年，隨著環球晶圓全球擴產陸續到位，資本支出高峰已過，營運重心正由建廠投資轉向產能放量與出貨成長。在產能利用率提升及各國補助逐步到位的助力下，擴產效益已開始轉化為營收貢獻，亞洲與丹麥既有廠區表現亮眼，美國與義大利新廠亦加速驗證並強化在地供應優勢，推動全球布局邁入收成階段。同時，隨著人工智慧與高效能運算需求持續擴展，先進製程、先進封裝及 12 吋晶圓需求可望維持高檔，成熟製程庫存亦逐步回歸健康水位，整體產業呈現「復甦不均但方向向上」趨勢。在此基礎下，公司憑藉美國、歐洲與亞洲多地先進產能布局，持續深化 SOI、GaN 與 SiC 等高附加價值產品，其中 GaN 產能維持滿載，SiC 亦由既有 6 吋與 8 吋產品延伸至 12 吋及半絕緣產品並持續推進客戶驗證。受惠於先進封裝散熱、高功率元件與 AI 伺服器等高成長應用帶動，環球晶圓整體營運可望隨產能利用率提升與訂單動能改善而穩步成長，並將持續以全球在地製造、彈性出貨與產品組合優化為核心優勢，穩健擴大競爭力與獲利基礎，為股東創造長期且永續的價值。

董事長 徐秀蘭



總經理 Mark Lynn England



主辦會計 吳財瑋



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

115年03月26日 單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主要關係人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	徐秀蘭	女 61~70歲	113.06.18	三年	100.10.01	847,879	0.18%	847,879	0.18%	—	—	—	—	伊諾大學碩士/電腦科學碩士/中美砂晶製品(股)公司總經理	註一	無	無	無	註九
董事	中華民國	中美砂晶製品(股)公司代表人：盧明光	男 71~80歲	113.06.18 113.06.18	三年 三年	100.10.01 100.10.01	223,007,864 1,000,000	46.64% 0.21%	223,007,864 1,000,000	46.64% 0.21%	—	—	—	—	榮譽大學博士/醫工同大學博士/醫工學院技術研究所 美砂晶製品(股)公司董事長/朋程科技(股)公司董事長/敦南科技(股)公司總經理/旭興科技(股)公司總經理/旭麗(股)公司副總經理	註二	無	無	無	—
董事	中華民國	中美砂晶製品(股)	男 61~70歲	113.06.18 113.06.18	三年 三年	100.10.01 100.10.01	223,007,864 202,253	46.64% 0.04%	223,007,864 202,253	46.64% 0.04%	—	674	—	—	淡江大學管研所碩士/中	註三	無	無	無	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經歷(學)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以上之關係、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
		公司 代表人： 姚宥梁													美矽晶製品 (股)公司總經理 (股)公司總科技 (股)公司製造 處協理					
董事	中華民國	陳國洲	男 61~70 歲	113.06.18	三年	103.05.26	665,773	0.14%	665,773	0.14%					南英商工/南 海光電科技 (股)公司董事 長/三信商業 銀行董事	註四	無	無	無	—
獨立 董事	中華民國	于明仁	男 61~70 歲	113.06.18	三年	110.08.24		—		—					紐約大學企 管碩士/摩根 大通銀行副 總經理/中強 光電(股)公 司財務長及 光模組事 業元資 群總經 理/元資 大證 券投 行富 資 副 總 經 理/ 智 康 集 團 經 理/ 深 副 總 行 董 事/ 及 台 光 電 子 (股) 公 司 財 務 長	註五	無	無	無	—
獨立 董事	中華民國	羅達賢	男 71~80 歲	113.06.18	三年	112.06.20		—		—					交通大學科 技管理研 究所/工 業研 究院 技 術 研 究 院 產 業	註六	無	無	無	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經歷(學)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主要股東或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
															程研究所副 教授/臺北科 技大學材料 及資源工程 系副教授					

註一：目前兼任環球晶圓(股)公司執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、朋程科技(股)公司法人董事代表人、宏捷科技(股)公司董事長、台灣特品化學(股)公司董事長、弘潔科技(股)公司董事長、SAS Sunrise Inc.法人董事代表人、續升綠能(股)公司法人董事代表人、續興(股)公司法人董事代表人、中美鑫投資(股)公司董事長、續日(股)公司董事長、旭愛能源(股)公司董事長、寰球鑫投資(股)公司董事長、GlobalSemiconductor Inc.董事、GlobiTech Incorporated 董事長及執行長、GlobalWafers Japan Co., Ltd.董事長、MEMC Japan Limited 董事長、昆山中辰矽晶有限公司副董事長、兆遠科技(股)公司董事長、Topsil GlobalWafers A/S 董事長、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事、GlobalWafers B.V.董事、MEMC Korea Company 董事、GlobalWafers America, LLC 董事長、光寶科技(股)公司董事長、Crystalwise Technology (HK) Limited 董事、環球晶資本(股)公司董事長、台達電子工業(股)公司獨立董事。

註二：目前兼任中美矽晶製品(股)公司董事長、朋程科技(股)公司董事長及榮譽董事長、光寶科技(股)公司董事長、朋程科技(股)公司獨立董事、安傑特科技(股)公司董事長、寰球鑫投資(股)公司法人董事代表人、瑞柯科技(股)公司董事長、大青節能科技(股)公司董事長、傳承光電(股)公司法人董事代表人、光寶科技(股)公司獨立董事、安傑特科技(股)公司董事長、寰球鑫投資(股)公司法人董事代表人。

註三：目前兼任中美矽晶製品(股)公司董事長、朋程科技(股)公司董事長及執行長、GlobiTech Incorporated 法人董事代表人、宏捷科技(股)公司法人董事代表人、續升綠能(股)公司法人董事代表人、中美鑫投資(股)公司法人董事代表人、瑞柯科技(股)公司法人董事代表人、鼎崑科技(股)公司法人董事代表人、台灣茂矽電子(股)公司法人董事代表人、杰力科技(股)公司法人董事代表人、寰球鑫投資(股)公司法人董事代表人、元鴻(山東)光電材料有限公司董事、環球晶資本(股)公司法人監察人代表人、安科思資本(股)公司董事長、Singapore Pte. Ltd.董事、GlobalWafers America, LLC 董事。

註四：目前兼任南海光電科技(股)公司董事。

註五：目前兼任臺灣水泥(股)公司財務長、和平電力(股)公司法人監察人代表人、國際中線投資控股(股)公司法人董事代表人、中聯資源(股)公司法人董事代表人。

註六：目前兼任中華民國企業經理協進會理事長、工業技術研究院特聘專家、財團法人潘文淵文教基金會執行長、工業技術研究院院友會秘書長、清華大學科技管理研究所兼任教授。

註七：目前兼任中華精測科技(股)公司獨立董事、金寶電子工業(股)公司獨立董事、資拓宏宇國際(股)公司獨立董事。

註八：目前兼任臺北科技大學資源工程研究所副教授、臺北科技大學材料與資源工程系副教授、宏捷科技(股)公司獨立董事。

註九：董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊；本公司董事長兼任執行長，係考量本公司之營運規模及為提升整體經營效率，本公司另設有總經理職位，執行長與總經理二者職權劃分不同，執行長重於規劃面(主要職掌為擬訂本公司經營方針、年度預算計畫、重要客戶關係維繫、策略聯盟規劃、轉投資佈局規劃及年度計畫實際達成情形追繳等)，總經理負責執行面(負責本公司業務之執行、協調並指揮監督所屬以達成營運目標，同時貫徹本公司之政策與執行長所規劃之經營策略及相關營運事項)，二者相輔相成；本公司由董事長兼任執行長，能有效將董事會學劃之公司發展藍圖落實到規劃執行面，亦能提高董事會對公司營運狀況之掌握度。本公司董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人，且董事會設有四席獨立董事席次，各功能性委員會成員並多數由獨立董事擔任，就各重要議題進行充分討論後向董事會提出建議，可強化董事會之監督職能及落實公司治理。

1. 法人股東之主要股東：

法人股東名稱	法人股東之主要股東
中美矽晶製品股份有限公司	弘望投資股份有限公司(3.91%)、台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶(3.53%)、彰化商業銀行股份有限公司受託保管元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金專戶(3.13%)、南山人壽保險股份有限公司(2.32%)、張清照(2.07%)、威連科技股份有限公司(2.05%)、盧明光(1.73%)、弘茂投資股份有限公司(1.63%)、凱基人壽保險股份有限公司(1.29%)、中華郵政股份有限公司(1.27%)

2. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

法人名稱	法人之主要股東
弘望投資股份有限公司	威連科技股份有限公司(39.02%)、環球晶圓股份有限公司(30.98%)、朋程科技股份有限公司(30.00%)
威連科技股份有限公司	弘茂投資股份有限公司(30.46%)、全德投資股份有限公司(10.75%)
弘茂投資股份有限公司	財團法人基督教中華信望愛基金會(16.34%)、財團法人平安信望愛文教基金會(16.34%)、公益信託恩典社會福利基金(16.34%)、財團法人威盛信望愛慈善基金會(16.34%)

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立董事獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董家數
董事長 徐秀蘭	<p>徐秀蘭女士於美國伊利諾大學取得電腦科學碩士學位，歷任中美矽晶業務協理、副總經理及總經理，自環球晶圓從中美矽晶分割獨立後，徐秀蘭女士便擔任環球晶圓董事長，目前亦身兼中美矽晶董事長。</p> <p>徐秀蘭女士在半導體產業深耕超過30年，身為高階經理人，對於公司經營所需的商務、法務、財務及會計等專業領域皆有涉獵，經驗豐富並充分具備公司營運所需之專業及能力。</p> <p>徐秀蘭女士未有公司法第30條所列之情事。</p>	不適用	1
董事 中美矽晶製品(股)公司 代表人： 盧明光	<p>盧明光先生為交通大學榮譽工學博士、大同大學名譽工學博士及工業技術研究院院士。盧明光先生歷任敦南科技及旭興科技總經理、中美矽晶董事長、及朋程科技董事長，目前為中美矽晶榮譽董事長及朋程科技榮譽董事長。</p> <p>盧明光先生在半導體產業服務超過40年，在企業經營上屢創佳績，擁有卓越管理能力、前瞻獨特眼界、商務談判技巧及深厚財會知識，充分具備公司營運所需的智慧及專業。</p> <p>盧明光先生未有公司法第30條所列之情事。</p>	不適用	1
董事 中美矽晶製品(股)公司 代表人： 姚宕梁	<p>姚宕梁先生於淡江大學管理研究所取得碩士學位，歷任中美矽晶總經理、旭興科技協理及兆遠科技董事長，目前為中美矽晶副董事長及朋程科技董事長。</p> <p>姚宕梁先生在產業深耕40年，具備豐沛的製造生產及管理知識，多年的高階管理人經驗使姚宕梁先生對於公司營運管理相當熟稔，具備豐富的跨領域企業經驗，能依不同總體經濟及產業情境提出獨特的觀點及建議。</p> <p>姚宕梁先生未有公司法第30條所列之情事。</p>	不適用	-
董事 陳國洲	<p>陳國洲先生畢業於南英商工，曾任南海光電科技(股)公司董事長及三信商業銀行董事。</p> <p>陳國洲先生對於資本市場及金融體系相當熟稔，亦對產業環境反應敏銳，對於公司營運方向及策略可以提供即時的觀點及見解，提供調整方向及建議。</p> <p>陳國洲先生未有公司法第30條所列之情事。</p>	不適用	-

<p>獨立董事 于明仁</p>	<p>于明仁先生於美國紐約大學取得企管碩士，歷任摩根大通銀行副總經理、中強光電財務長及背光模組事業群總經理、元大證券執行副總及富智康集團資深副總及執行董事、台光電子財務長、及臺灣水泥財務長。</p> <p>于明仁先生深耕銀行及產業雙領域，同時具備廣博財務金融知識與豐富業界實務操作。于明仁先生的專業、學識及財務專長對於營運規模迅速成長的環球晶圓而言有相當助益。</p> <p>于明仁先生未有公司法第 30 條所列之情事，暨符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條有關專業資格之規定。</p>	<p>于明仁先生符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條有關獨立性及第 4 條有關兼任限制之規定，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近二年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額未超過法定限額...等。</p>	-
<p>獨立董事 羅達賢</p>	<p>羅達賢先生為交通大學科技管理研究所博士，歷任工業技術研究院產業學院執行長、冠臣電子股份有限公司副總經理，亦曾作為兼任教授服務於清華大學、交通大學與逢甲大學，並擔任過中華民國科技管理學會理事長/秘書長及教育部大學責任計畫主審委員。</p> <p>羅達賢先生在學術界及教育界享有盛名，環球晶圓的成長節奏快速，羅達賢先生在科技產業及管理方面的豐富學識能為公司團隊帶來建設性的支持與建言，對於環球晶圓大有助益。</p> <p>羅達賢先生未有公司法第 30 條所列之情事，暨符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條有關專業資格之規定。</p>	<p>羅達賢先生符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條有關獨立性及第 4 條有關兼任限制之規定，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近二年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額未超過法定限額...等。</p>	-
<p>獨立董事 吳琮璠</p>	<p>吳琮璠女士為美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)會計資訊管理博士，曾於臺灣大學會計系任教超過 25 年，歷任金融監督管理委員會專任委員、合作金庫銀行常駐監察人、合作金庫金控董事、台灣證券交易所公益董事、證券櫃檯買賣中心公益董事等職務，並曾擔任多家公司之獨立董事，包括中華電信、臺灣永光化學工業、中華精測科技、金寶電子、台灣糖業等。</p> <p>吳琮璠女士於產官學界歷練豐富，尤其於金融與證券法規、資訊科技與會計分析等領域具備淵博知識與豐沛實務經驗，其專業知識及跨界經驗有助於環球晶圓建構更穩健完善的營運及財務運作。</p> <p>吳琮璠女士未有公司法第 30 條所列之情事，暨符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條有關專業資格之規定。</p>	<p>吳琮璠女士符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條有關獨立性及第 4 條有關兼任限制之規定，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近二年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額未超過法定限額...等。</p>	3
<p>獨立董事 蔡子萱</p>	<p>蔡子萱女士為臺灣大學化學工程系博士，目前為臺北科技大學資源工程研究所副教授及臺北科技大學材料及資源工程系副教授。</p> <p>蔡子萱女士的研究領域包括電化學工程、半導體製程、腐蝕工程、光電元件製程、以及能源科技等，其專業學識對於公司的研發方向及技術發展有相當大的裨益。</p> <p>蔡子萱女士未有公司法第 30 條所列之情事，暨符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條有關專業資格之規定。</p>	<p>蔡子萱女士符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條有關獨立性及第 4 條有關兼任限制之規定，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近二年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額未超過法定限額...等。</p>	1

4. 董事會多元化及獨立性：

一、董事會多元化：

本公司「公司治理實務守則」已有規範董事會成員之組成及整體應具備之能力，並訂有董事會成員多元化政策。本公司董事會成員組成已考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，如以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力
- 二、會計及財務分析能力
- 三、經營管理能力
- 四、危機處理能力
- 五、產業知識
- 六、國際市場觀
- 七、領導能力
- 八、決策能力

本公司董事會成員落實多元化情形如下

董事姓名	多元化核心項目	性別	年齡			兼任本公司員工	獨立董事任期年資		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	產業技術	國際市場觀	領導能力	決策能力	大專院校教授資歷
			51歲至60歲	61歲至70歲	71歲至80歲		3年以內	3至6年										
			徐秀蘭	女			✓											
中美矽晶製品股份有限公司 代表人：盧明光	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
中美矽晶製品股份有限公司 代表人：姚宕梁	男		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
陳國洲	男		✓					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
于明仁（獨立董事）	男		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
羅達賢（獨立董事）	男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳琮璠（獨立董事）	女		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
蔡子萱（獨立董事）	女	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

本公司第六屆董事會由 8 位董事組成，包含 4 位獨立董事，除有 3 名女性董事外，董事並分別具有營運管理、專業技術、商務及財務之相關豐富產學經驗，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司現任 8 位董事中，具員工身分之董事占比 12.5%，獨立董事占比 50%，女性董事占比 37.5%，4 位獨立董事中 3 位任期年資在 3 年以下、1 位介於 3 至 6 年。本公司注重董事會成員組成之產業經驗分佈，目標為半數以上董事具有半導體產業相關經驗，現任董事中具有半導體產業相關經驗者占比 62.5%；此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別分佈，女性董事目標為至少一席以上，目前本公司女性董事為三席，占比 37.5%，達到公司董事任一性別均達董事會席次三分之一以上。

二、董事會獨立性：

本公司第六屆董事會由 8 位董事組成，包含 4 位獨立董事，獨立董事占比 50%，獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條有關獨立性及第 4 條有關兼任限制之規定，另董事組成無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事（董事間、監察人間或董事與監察人間未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形），本公司董事會組成符合獨立性之要求。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

115年3月26日 單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
執行長	中華民國	徐秀蘭	女	100.10.01	847,879	0.18%	—	—	—	—	伊利諾大學電腦科學碩士/中美矽晶製品(股)公司總經理	註一	無	無	無	註六
總經理	美國	Mark Lynn England	男	103.10.01	—	—	—	—	—	—	University of Texas, Austin, Texas. BBA, Engineering Management/ GlobalWafers Co.Ltd. V.P., Sales & Marketing / Texas Instruments Manager, Product Engineering	註二	無	無	無	—
行銷副總	中華民國	洪聖雄	男	104.03.19	—	—	—	—	—	—	美國波士頓大學製造工程碩士/昆山中辰矽晶有限公司行銷及研發副總	註三	無	無	無	—
行銷協理	中華民國	尤天文	男	107.03.20	8,510	0.00%	—	—	—	—	台北商業專科學校企業管理科/中美矽晶製品(股)公司行銷副處長	註四	無	無	無	—
行銷協理	中華民國	何禧樂	女	113.05.07	—	—	—	—	—	—	陽明交通大學 EMBA 碩士/ Covalent Materials Taiwan 行銷業務副理	無	無	無	無	—
財務副總	中華民國	簡明輝	男	103.09.02	19,730	0.00%	—	—	—	—	台北大學企業管理研究所碩士/日盛國際商業銀行業務管理部經理、地泓全球光電(股)公司財務經理	註五	無	無	無	—
會計副理	中華民國	吳財璋	男	115.01.15	—	—	—	—	—	—	中原大學會計系/資誠聯合會計師事務所審計部副理、宏碁系統(股)公司會計課長、Finance Manager of Etch Home Technology Vietnam Co., Ltd.、Finance Manager of Darfon Vietnam Co., Ltd.	無	無	無	無	—
中德分公司總經理	中華民國	薛銀陞	男	109.01.02	—	—	—	—	—	—	俄亥俄州立大學材料工程所博士/中德電子材料(股)公司總經理	無	無	無	無	—
中德分公司研發副總	中華民國	陳亮欽	男	109.02.01	—	—	—	—	—	—	明尼蘇達大學化工材料所博士/德商世創電子台灣技術總監/中德電子材料(股)公司工程技術研發副總	無	無	無	無	—
中德分公司產品/產品整合副總	中華民國	黃耀毅	男	109.02.01	—	—	—	—	—	—	清華大學高階經營管理碩士/中德電子材料(股)公司品質保證副總、MEMC 全球客戶品質總監，聯華電子中央品質保證資深經理	無	無	無	無	—
中德分公司生產副總	中華民國	黃俊榮	男	109.02.01	—	—	—	—	—	—	成功大學機械工程所碩士/中德電子材料(股)公司生產副總	無	無	無	無	—
中德分公司專案副總	中華民國	黃俊偉	男	109.02.01	—	—	—	—	—	—	清華大學動力機械系/中德電子材料(股)公司專案協理	無	無	無	無	—

註一：目前兼任中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、朋程科技(股)公司法人董事代表人、宏捷科技(股)公司董事長、台灣特品化學(股)公司董事長、弘潔科技(股)公司董事長、SAS Sunrise Inc.法人董事代表人、續升綠能(股)公司法人董事代表人、中美鑫投資(股)公司董事長、續日(股)公司董事長、旭愛能源(股)公司董事長、寰球鑫投資(股)公司董事長、Global Semiconductor Inc.董事、GlobiTech Incorporated 董事長及執行長、GlobalWafers Japan Co., Ltd.董事長、MEMC Japan Ltd.董事長、昆山中辰矽晶有限公司副董事長、Topsil GlobalWafers A/S 董事長、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事、GlobalWafers B.V.董事、MEMC Korea Company 董事、GlobalWafers America, LLC 董事長、兆遠科技(股)公司董事長、Crystalwise Technology (HK) Limited 董事、環球晶資本(股)公司董事長、台達電子工業(股)公司獨立董事。

註二：目前兼任 GlobiTech Incorporated 董事及總經理、GlobalWafers Japan Co., Ltd.董事、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事、MEMC Korea Company 董事、MEMC LLC 董事及總經理、GlobalWafers America, LLC 董事及總經理。

註三：目前兼任昆山中辰矽晶有限公司董事、昆山辰巨電子科技有限公司董事及總經理、晶化科技(股)公司法人董事代表人。

註四：目前兼任昆山辰巨電子科技有限公司董事。

註五：目前兼任中美矽晶製品(股)公司採購副總、續升綠能(股)公司監察人、盛達電業(股)公司董事、續律能源(股)公司法人董事代表人、旭愛能源(股)公司法人董事代表人、旭信電力(股)公司董事長、弘望投資(股)公司董事長、GlobiTech Incorporated 董事、GlobalWafers Japan Co., Ltd.董事、昆山中辰矽晶有限公司監察人、Topsil GlobalWafers A/S 董事、MEMC Electronic Materials S.p.A.董事、MEMC Electronic Materials Sdn. Bhd.董事、GlobalWafers GmbH 董事、兆遠科技(股)公司法人董事代表人、上海召業申凱電子材料有限公司董事。

註六：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：

本公司董事長兼任執行長，係考量公司之營運規模及為提升整體經營效率，本公司另設有總經理職位，執行長與總經理二者職權劃分不同，執行長重於規劃面（主要職掌為擬訂本公司經營方針、年度預算計畫、重要客戶關係維繫、策略聯盟規劃、轉投資佈局規劃及年度計畫實際達成情形追蹤等），總經理負責執行面（負責本公司業務之執行、協調並指揮監督所屬以達成營運目標，同時貫徹本公司之政策與執行長所規劃之經營策略及相關營運事項），二者相輔相成；本公司由董事長兼任執行長，能有效將董事會學劃之公司發展藍圖落實到規劃執行面，亦能提高董事會對公司營運狀況之掌握度。本公司董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人，且董事會設有四席獨立董事席次，各功能性委員會成員並多數由獨立董事擔任，就各重要議題進行充分討論後向董事會提出建議，可強化董事會之監督職能及落實公司治理。

二、最近年度(114年)給付董事、總經理及副總經理等之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金：

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金			
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例			本公司	財務報表內所有公司	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報表內所有公司				
董事	徐秀蘭	30	30	0	0	36,600	39,400	140	140	36,770	39,570	79,453	82,253	30,442	
	中美矽晶製品(股)公司 代表人：盧明光									0.5029%	0.5412%	1.0866%	1.1249%		
	中美矽晶製品(股)公司 代表人：姚容梁														
	陳國洲														
獨立董事	于明仁									7,940	7,940	7,940	7,940	0	
	羅達賢	3,000	3,000	0	0	4,800	4,800	140	140	0.1086%	0.1086%	0.1086%	0.1086%		
	吳琮瑞														
	蔡子萱														

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司除每月支付獨立董事酬金外，公司得視獨立董事對公司營運參與之程度與貢獻，及參酌其董事績效評估結果，另由依年度獲利狀況所提撥之董事酬勞中分別決定獨立董事酬勞分配數額。前述獨立董事獲配之酬勞數額，經薪資報酬委員會審議通過後，提請董事會決議。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過114年度決議配發之董事酬勞金額，表列金額係為估算數。

註2：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過114年度分派之員工酬勞金額，表列金額係為估算數。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	獨立董事： 于明仁、 羅達賢、 吳琮璠、 蔡子萱	獨立董事： 于明仁、 羅達賢、 吳琮璠、 蔡子萱	獨立董事： 于明仁、 羅達賢、 吳琮璠、 蔡子萱	獨立董事： 于明仁、 羅達賢、 吳琮璠、 蔡子萱
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	一般董事： 徐秀蘭、中美 矽晶製品(股) 公司(代表 人：盧明光、 姚宕梁)、陳 國洲	一般董事： 中美矽晶製品 (股)公司(代表 人：盧明光、姚 宕梁)、陳國洲	一般董事： 中美矽晶製 品(股)公司 (代表人：盧 明光、姚宕 梁)、陳國洲	一般董事： 中美矽晶製 品(股)公司 (代表人：盧 明光、姚宕 梁)、陳國洲
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	一般董事： 徐秀蘭	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	一般董事： 徐秀蘭	一般董事： 徐秀蘭
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	共 8 人	共 8 人	共 8 人	共 8 人

(二) 總經理及副總經理之酬金：

114年12月31日 單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額(D)(註3)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	財務報告內所有公司		
執行長	徐秀蘭														
總經理	Mark Lynn England														
副總經理	徐文慶(註1)														
副總經理	洪聖雄														
副總經理	李崇偉(註2)														
副總經理	簡明輝														
中德分公司 總經理	薛銀陞	33,019	46,706	788	788	29,875	34,098	76,700	76,700	0	76,700	0	140,382	158,291	13,881
中德分公司 副總經理	陳亮欽														
中德分公司 副總經理	黃耀毅														
中德分公司 副總經理	黃俊榮														
中德分公司 副總經理	黃俊偉														

註1：原研發暨製造副總徐文慶先生於114年4月15日退休。

註2：原企業發展副總李崇偉先生於115年1月1日退休。

註3：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過114年度分派總經理及副總經理之員工酬勞金額，表列金額係為估算數。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	李崇偉	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	李崇偉
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	徐文慶	徐文慶
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	黃耀毅、黃俊榮、黃俊偉	黃耀毅、黃俊榮、黃俊偉
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	洪聖雄、簡明輝、陳亮欽、 Mark Lynn England	洪聖雄、簡明輝、陳亮欽
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	薛銀陞	Mark Lynn England、薛銀陞
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	徐秀蘭	徐秀蘭
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	共 11 人	共 11 人

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

114年12月31日 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	執行長	徐秀蘭	—	83,100	83,100	1.14%
	總經理	Mark Lynn England				
	副總經理	徐文慶(註1)				
	副總經理	洪聖雄				
	副總經理	李崇偉(註2)				
	行銷協理	尤天文				
	行銷協理	何禧樂				
	財務副總	簡明輝				
	會計經理	羅玉婷(註3)				
	中德分公司總經理	薛銀陞				
	中德分公司副總經理	陳亮欽				
	中德分公司副總經理	黃耀毅				
	中德分公司副總經理	黃俊榮				
中德分公司副總經理	黃俊偉					

註1：原研發暨製造副總徐文慶先生於114年4月15日退休。

註2：原企業發展副總李崇偉先生於115年1月1日退休。

註3：原會計經理羅玉婷小姐於115年1月15日辭任。

註4：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過114年度分派經理人之員工酬勞金額，表列金額係為估算數。

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例之分析

單位：%

職 稱	114 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)		113 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董 事	0.61%	0.65%	0.41%	0.43%
總經理及副總經理	1.92%	2.16%	1.46%	1.63%

註：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過 114 年度分派之董事酬勞金額以及分派經理人之員工酬勞金額，表列比例係為估算數。

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 本公司董事酬金包含董事報酬、董事酬勞、及業務執行費用三大項，係依公司章程及相關規定辦理；總經理及副總經理酬金包含薪資、獎金及員工酬勞三類，係依公司章程及核決權限訂定之。

(2) 訂定酬金之程序

本公司章程規定：「本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。」董事酬勞之訂定，係以董事對公司營運參與之程度與貢獻，及參酌其董事績效評估結果，依公司章程及「董事及功能性委員會酬金給付辦法」規定辦理。總經理及副總經理所領取之酬金係依據公司章程以及每年董事會所通過年度預算之營運績效額度，併同考量其所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，另參酌同業水準議定之，並依「經理人薪資報酬管理辦法」及「員工酬勞分派辦法」程序辦理。

本公司於 103 年 9 月 2 日成立薪資報酬委員會，該委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；以及定期評估並審核董事及經理人之薪資報酬之內容及數額，並呈送董事會決議。

(3) 經營績效及未來風險之關連性

本公司董事及經理人之績效評估及酬金支付除參考其所任職位、對公司營運參與程度（包含董事之出席率、溝通頻率、提供之建議...等）、個人績效貢獻（包含財務性指標如營收及獲利達成率，以及非財務性指標如法令及內控遵循、ESG 績效指標，或特殊功績...等）及參酌同業通常水準外，並綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來面臨之風險等事項，與其所負公司經營責任及整體績效呈高度關連性。

於非財務性指標方面，為落實本公司對永續發展之承諾，亦將 ESG（環境、社會、治理）等非財務績效面向納入本公司高階經理人績效評估範圍（高階經理人包括總經理、副總經理、各廠廠長等），ESG 績效指標項目及權重占比依據高階經理人其職務範圍及內容個別訂定，ESG 績效指標項目包括國內外相關 ESG 評鑑評等、減緩氣候變遷與調適相關作為（如溫室氣體減量、節能減碳目標達成率、再生能源使用比率等）、環境管理績效（水資源、廢棄物管理目標達成率）、職業安全衛生推動...等，權重占比則於 20% 以內分別訂定，高階經理人於其績效考核時依據上述個別之 ESG 績效指標項目之達成情形以及權重占比將其 ESG 績效納入考核計算以評定薪酬。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

本屆董事會董事任期為 113 年 6 月 18 日至 116 年 6 月 17 日，114 年度董事會開會 7 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	徐秀蘭	7	0	100%	第六屆 (113年6月18日選任)
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：盧明光	7	0	100%	
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：姚宕梁	7	0	100%	
董事	陳國洲	7	0	100%	
獨立董事	于明仁	7	0	100%	
獨立董事	羅達賢	7	0	100%	
獨立董事	吳琮璠	7	0	100%	
獨立董事	蔡子萱	7	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用第 14 條之 3 規定。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

1. 114 年 5 月 6 日第六屆第七次董事會：

■ 議案內容：本公司 113 年度董事酬勞分配案

■ 利益迴避董事：全體董事個別利益迴避

■ 應利益迴避原因以及參與表決情形：本案依個別董事酬勞逐項表決，個別董事於討論及決議其個人酬勞時，因利益迴避，不參與討論及表決。

2. 114 年 5 月 6 日第六屆第七次董事會：

■ 議案內容：本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案

■ 利益迴避董事：徐秀蘭

■ 應利益迴避原因以及參與表決情形：董事長徐秀蘭女士因兼任執行長具有經理人身份，因利益迴避，不參與討論及表決。

3. 114 年 9 月 26 日第六屆第九次董事會：

■ 議案內容：本公司擬與續興股份有限公司簽署離岸風電購售電契約以採購 15.5MW 的離岸風電案

■ 利益迴避董事：徐秀蘭

■ 應利益迴避原因以及參與表決情形：董事長徐秀蘭女士因同時擔任續興股份有限公司之董事，因利益迴避，不參與討論及表決。

4. 114 年 11 月 4 日第六屆第十次董事會：

■ 議案內容：修訂本公司「董事及功能性委員會酬金給付辦法」案（調整提名暨

永續發展委員會委員報酬)

- 利益迴避董事：徐秀蘭、于明仁、羅達賢、吳琮璠、蔡子萱
- 應利益迴避原因以及參與表決情形：董事長徐秀蘭女士以及獨立董事于明仁先生、羅達賢先生、吳琮璠女士、蔡子萱女士為提名暨永續發展委員會委員，因利益迴避，不參與討論及表決。

三、董事會及功能性委員會評鑑執行情形：

<內部自評>

評估週期：每年執行一次

評估期間：對 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日之績效進行評估

提報董事會日期：115 年 3 月 3 日

評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
董事會	董事自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 6. 對永續經營(ESG)之關注	各面向平均得分率皆達到標準以上，顯示整體董事會運作狀態良好，符合公司治理需求。
個別董事成員	董事自評	1. 公司目標與任務之掌握及對永續經營(ESG)之關注 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制	各面向平均得分率皆達到標準以上，顯示各董事對於其參與董事會情形與董事會運作具有正面且高度的評價。
審計委員會	董事自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制	各面向平均得分率皆達到標準以上，顯示整體審計委員會運作狀態良好，符合公司治理需求。
薪資報酬委員會	董事自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任	各面向平均得分率皆達到標準以上，顯示整體薪資報酬委員會運作狀態良好，符合公司治理需求。
提名暨永續發展委員會	董事自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提名暨永續發展委員會職責認知 3. 提升提名暨永續發展委員會決策品質 4. 提名暨永續發展委員會組成及成員選任	各面向平均得分率皆達到標準以上，顯示整體提名暨永續發展委員會運作狀態良好，符合公司治理需求。

〈外部評估〉

評估週期：至少每三年執行一次

評估機構：社團法人中華公司治理協會

評估期間：對 113 年 7 月 1 日至 114 年 6 月 30 日之績效進行評估

提報董事會日期：114 年 11 月 4 日

評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
董事會及功能性委員會	委任外部專業機構進行績效評估	1. 董事會之組成與分工 2. 董事會之指導與監督 3. 董事會之授權與風管 4. 董事會之溝通與協作 5. 董事會之自律與精進	整體績效評估結果良好，顯見公司在推動公司治理及企業永續方面已具相當成效；公司並已針對評估報告建議研擬並著手進行相關改善事宜。

上述董事會績效內部自評及外部評估報告揭露於本公司網站>投資人專區>公司治理>董事會>董事會暨功能性委員會績效評估結果 (<https://www.sas-globalwafers.com/corporate/>)。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

1. 設置獨立董事及審計委員會，加強專業董事獨立客觀功能，監督董事會運作：本公司於 104 年 1 月 19 日股東臨時會改選董事，並選任三席獨立董事，同時成立審計委員會取代監察人制度。
2. 設立薪酬委員會協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度，並定期檢討董事及經理人等之報酬是否合宜。
3. 設置提名委員會協助公司覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人，並建構及發展董事會及各委員會之組織架構。
4. 因應公司治理及永續發展趨勢，為強化董事會在 ESG 層面之督導職能，本公司於 114 年 11 月 4 日董事會決議通過變更「提名委員會」為「提名暨永續發展委員會」，擴大原有提名委員會之職掌，將永續發展相關事項納入其職責範疇。
5. 持續提昇資訊透明度：本公司指定專人負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新等，並設置投資人專區提供財業務資訊，以及利害關係人專區提供利害關係人暢通及有效的多向溝通管道。
6. 提昇董事會職能及專業知識：本公司已制定「董事會議事規範」加強落實董事會之職能，另本公司鼓勵董事會成員參與各項專業課程，並於董事會進行相關法令宣導，以提昇董事會決策能力及符合相關法令規範。
7. 設置公司治理主管協助董事執行職務並提升董事會效能：本公司於 108 年 5 月 7 日董事會通過設置公司治理主管，並訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，以即時有效協助董事執行職務之原則處理董事要求事項，以增加本公司對董事之支援及加強公司治理相關法令規章之遵循。

(二) 審計委員會運作情形：

本公司於 104 年 1 月 19 日設置審計委員會取代監察人制度。

本屆審計委員會委員任期為 113 年 6 月 18 日至 116 年 6 月 17 日，114 年度審計委員會共召開 7 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註									
獨立董事 (召集人)	于明仁	7	0	100%	第四屆 (113 年 6 月 18 日選任)									
獨立董事	羅達賢	7	0	100%										
獨立董事	吳琮璿	7	0	100%										
獨立董事	蔡子萱	7	0	100%										
審計委員會成員之專業資格與經驗請參閱本年報「貳、公司治理報告／(一)董事資料／3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容														
審計委員會之組成與運作： 本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，委員會之運作以下列事項之監督為主要目的： (一) 公司財務報表之允當表達。 (二) 簽證會計師之選(解)任及其能力資格、獨立性與績效。 (三) 公司內部控制之有效實施。 (四) 公司遵循相關法令及規則。 (五) 公司存在或潛在風險之管控。														
其他應記載事項： 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理： (一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 114 年度各議案均經審計委員會全體出席委員同意通過後經董事會全體出席董事同意通過，議案內容請詳下表(五、審計委員會年度運作情形)。 (二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)： (一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通 1.本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。 2.本公司簽證會計師每季於審計委員會議中，針對本公司及子公司財務報表核閱或查核結果及其他法令要求之溝通事項向獨立董事進行報告。 (二)114 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要														
<table border="1"><thead><tr><th>日期</th><th>溝通重點</th><th>建議及結果</th></tr></thead><tbody><tr><td>114.02.25 審計委員會</td><td>113 年度內部稽核業務報告 113 年度內部控制制度聲明書</td><td>無異議</td></tr><tr><td>114.05.06 審計委員會</td><td>114 年度第一季內部稽核業務報告</td><td>無異議</td></tr></tbody></table>						日期	溝通重點	建議及結果	114.02.25 審計委員會	113 年度內部稽核業務報告 113 年度內部控制制度聲明書	無異議	114.05.06 審計委員會	114 年度第一季內部稽核業務報告	無異議
日期	溝通重點	建議及結果												
114.02.25 審計委員會	113 年度內部稽核業務報告 113 年度內部控制制度聲明書	無異議												
114.05.06 審計委員會	114 年度第一季內部稽核業務報告	無異議												

114.08.05 審計委員會	114 年度第二季內部稽核業務報告	無異議
114.11.04 審計委員會	114 年度第三季內部稽核業務報告 115 年度內部稽核計劃	無異議

(三) 114 年度獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點	建議及結果
114.02.25 審計委員會	113 年度合併及個體財務報告查核結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通	無異議
114.05.06 審計委員會	114 年第一季合併財務報告核閱結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通	無異議
114.08.05 審計委員會	114 年第二季合併財務報告核閱結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通	無異議
114.11.04 審計委員會	114 年第三季合併財務報告核閱結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通	無異議

四、審計委員會年度工作重點彙整：

114 年度審計委員會共召開 7 次，審議的事項主要包括一

1. 審核財務報表及會計政策與程序：
審核 113 年度財報及 114 年度第一季至第三季財報。
2. 內部控制制度及其有效性之考核：
審核內部稽核報告及 113 年度內部控制制度之有效性。
3. 修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之處理程序；審核重大之資產、衍生性商品、資金貸與及背書或保證交易。
4. 簽證會計師之委(解)任、報酬、適任性、獨立性及其績效：
審核 113 年度簽證會計師之適任性、獨立性及其績效，以及 114 年度簽證會計師之委任。
5. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
6. 審核重大交易：本公司擬與續興股份有限公司簽署離岸風電購售電契約以採購 15.5MW 的離岸風電案。

五、審計委員會年度運作情形：

審計委員會 期別/日期	議案內容	證交 法第 14-5 所列 事項	審計委員 會決議結 果及公司 對審計委 員會意見 之處理
第四屆 第四次 114.02.25	1. 衍生性金融商品承作報告案	V	經審計委 員會全體 出席委員 同意通過 後提董事 會由全體 出席董事 同意通過
	2. 內部稽核業務報告案	V	
	3. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案	V	
	4. 本公司 113 年度盈餘分配表暨 113 年下半年度盈餘分派案	V	
	5. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨續委任案	V	
	6. 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案	V	
	7. 本公司擬發行國內無擔保普通公司債案	V	
	8. 本公司擬與金融機構簽訂 Cash Pool Agreement 並提供保證案	V	
第四屆 第五次 114.04.07	1. 本公司擬增加對荷蘭子公司 GlobalWafers B.V. 之投資案	V	

第四屆 第六次 114.05.06	1.衍生性金融商品承作報告案	V
	2.內部稽核業務報告案	V
	3.本公司風險管理之年度執行情形報告	V
	4.本公司 114 年度第一季合併財務報告案	V
	5.本公司向金融機構申請商業本票承銷額度案	V
	6.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函（LOS）案	V
	7.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司擔任保證人案	V
	8.本公司資金貸與子公司案	V
第四屆 第七次 114.08.05	1.114 年 6 月底衍生性金融商品承作報告案	V
	2.內部稽核業務報告案	V
	3.本公司 114 年度第二季合併財務報告案	V
	4.本公司向金融機構申請商業本票承銷額度案	V
	5.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函(LOS)案	V
	6.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司擔任保證人案	V
	7.子公司環球晶資本股份有限公司增資案	V
第四屆 第八次 114.09.26	1.本公司擬與續興股份有限公司簽署離岸風電購售電契約以採購 15.5MW 的離岸風電案	V
第四屆 第九次 114.11.04	1.114 年 9 月底衍生性金融商品承作報告案	V
	2.內部稽核業務報告案	V
	3.本公司 114 年度第三季合併財務報告案	V
	4.修訂本公司「內部控制制度」案	V
	5.本公司 115 年度內部稽核計畫案	V
	6.本公司向金融機構申請商業本票承銷額度案	V
	7.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函(LOS)案	V
第四屆 第十次 114.12.09	1.本公司 114 年上半年度以資本公積配發現金案	V
	2.本公司向金融機構申請商業本票承銷額度案	V
	3.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函（LOS）案	V
	4.本公司會計主管異動案	V

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」制訂本公司「公司治理實務守則」並揭露於公司網站。
二、公司股權結構及股東權益	V		(一) 本公司委託元大證券股份有限公司服務代理部處理股東相關問題，並且依規定建立發言人制度處理相關事宜，亦於網站上設置投資人專區及利害關係人專區頁面，收納各項提問或建議。
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(二) 本公司掌握董事、經理人及持股5%以上之大股東持股情形。本公司均按月申報相關資訊至公開資訊觀測站。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(三) 本公司內部控制涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之營運活動，訂有「環球晶圓對子公司之監理辦法」，落實對子公司風險控制機制；並訂定「關係人間財務業務監督及管理作業規範」及「集團企業暨特定公司及關係人交易作業程序」，對關係企業之進銷貨交易、取得處分資產、背書保證及資金貸與等事項加以規範。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(四) 本公司訂有「防範內線交易管理程序」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		
三、董事會之組成及職責	V		(一) 本公司「公司治理實務守則」已有規範董事會成員之組成及整體應具備之能力，並訂有董事會成員多元化政策。本公司各董事之學經歷、專業資格、獨立性及多元化情形等相關資訊請參閱本報「貳、公司治理報告／(一)董事資料」，以上資訊並同步揭露於公司網站。
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(二) 公司章程載明得於董事會下設置功能性委員會，相關委員會之設置及職權係依主管機關所訂辦法進行。本公司目前已設置功能性委員會如下：民國103年設置薪資報酬委員會，目前
(二) 公司除依法設置薪酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運	V		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	是	否	<p>由4位獨立董事組成；民國104年設置審計委員會，目前由4位獨立董事組成；民國106年設置企業永續發展委員會，由經營團隊組成並由董事長擔任主任委員定期向董事會報告；民國109年設置提名委員會，並於民國114年11月變更「提名委員會」為「提名暨永續發展委員會」，擴大原有提名委員會之職掌，將永續發展相關事項納入其職責範疇，目前由董事長及4位獨立董事組成。</p> <p>(三) 本公司訂有經董事會通過之「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，於每年年度結束時，由總經理室統籌，透過內部自評問卷方式進行包括董事會、個別董事成員及功能性委員會（包含審計委員會、薪資報酬委員會及提名暨永續發展委員會）之績效評估，評估結果將呈報董事會並作為個別董事薪資報酬及遴選或提名董事時之參考暨改善董事會及功能性委員會運作效能之建議。評估項目主要包含對公司營運之參與程度、提升會議決策品質、董事會暨功能性委員會之組成與結構、董事及委員的選任及持續進修以及內部控制等。本公司於115年1月已執行114年度之董事會暨功能性委員會績效評估，各面向評核結果皆達成指標，顯示整體董事會及功能性委員會運作狀態良好，績效評估結果已呈報115年3月3日董事會並揭露於公司網站。此外，本公司於113年11月5日董事會決議通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，規範本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並將評估結果提報董事會。本公司於114年委由「社團法人中華公司治理協會」執行首次董事會及功能性委員會之外部績效評估，並於114年11月4日向董事會呈報評估結果及未來改善方向，整體績效評估結果良好，顯見環球晶圓在推動公司治理</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		
		<p>摘要說明</p> <p>理及企業永續方面已具相當成效，公司並已針對評估報告建議研擬並著手進行相關改善事宜。上述相關內容，請參閱本報「貳、公司治理報告／三、董事會及功能性委員會評鑑執行情形」。</p> <p>(四)本公司訂有經董事會通過之「會計師獨立性及績效評估辦法」，每年評估簽證會計師之獨立性、適任性及績效，並將審計品質指標 (AQIs) 列入評估參考，評估結果將提報審計委員會及董事會通過。本公司於本年度已執行114年度會計師獨立性及適任性評估，評估結果已由115年3月3日審計委員會及董事會審議通過。</p> <p>獨立性指標評估項目包含簽證會計師無擔任審計客戶之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利害關係、簽證會計師與本公司無重大密切之商業關係及僱佣關係、簽證會計師無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券等15項；適任性及績效指標評估項目包含服務品質、專業程度及時效配合等項目；審計品質指標 (AQIs) 評估項目則包括專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等5大構面及13項指標—如查核經驗與受訓時數、案件品質管制複核 EQCR、非審計服務占比、外部檢查缺失及處分、及創新規畫或倡議等。</p>		
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?	V		<p>(一)本公司於108年5月7日董事會決議通過設立公司治理主管一職，並於112年12月12日董事會通過由本公司總經理室陳昱如經理擔任現任公司治理主管。陳昱如經理已具備公開發行公司從事財務、服務主管職務經驗達三年以上，且未兼任本公司或其他公司之任何其他職務。</p> <p>本公司公司治理主管負責帶領及督導總經理室進行公司治理相關事務之辦理及提供董事支援，職權範圍包括：</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2. 製作董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修。 4. 提供董事執行業務所需之資料。 5. 協助董事遵循法令。 6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 7. 辦理董事異動相關事宜。 8. 其他依公司章程所訂定之事項等。 <p>(二)本年度公司治理主管業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬定及規劃公司治理相關規章辦法之檢視及增修訂以落實法令遵循。 2. 提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令。 3. 安排個別董事之進修課程（每位董事每年度至少受訓6小時，新任董事當年度至少受訓12小時）。 4. 各次董事會議之規劃及至少於會議7日前通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，並於會後20日內寄發董事會議事錄。 5. 依法辦理股東會事前登記，製作開會通知，議事手冊，年報與議事錄，並辦理公司變更登記。 6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 <p>(三)公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時。最近年度及截至年報刊印日止，公司治理主管進修情形如下：</p>	

評估項目	運作情形		摘要說明				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	是		114.07.03	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導企業併購後整合暨管理機制建立	3.0	無重大差異
			114.07.09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	
			114.07.24	證券櫃檯買賣中心	114年度上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0	
			<p>本公司設有發言人及代理發言人，並於公司網站設置利害關係人專區，針對各類別利害關係人建立對應窗口，並由專人負責回應相關問題（請參閱本公司網站>企業永續>利害關係人專區(https://www.sas-globalwafers.com/stakeholder/)）。</p> <p>本公司另於永續報告書「第一章、永續管理/1.2重大議題與利害關係人溝通」中揭露本公司依據營運活動、商業關係及參考行業而鑑別出7大類利害關係人（包括客戶、員工、股東/投資人、供應商/承攬商、政府機構、媒體、社區/非政府組織/非營利組織等）以及本公司與各類別利害關係人之溝通管道、回應方式、溝通頻率及其關注議題等。本公司經由與各類別利害關係人的互動及溝通並透過問卷調查方式，114年度共鑑別出13項永續重大議題，包括氣候策略與行動、能源管理、資安與個資保護、永續供應鏈管理、公司治理、職場健康與安全、經營策略與財務績效、水資源管理、人才發展、人才吸引與留任、廢棄物管理及循環再生、產品品質與安全、道德誠信，並據以擬定各重大議題之管理方針。上述與各利害關係人溝通情形之相關資訊除揭露於本公司</p>				

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	否	網站>企業永續>利害關係人專區以及永續報告書外，並每年度向董事會呈報，最近一次呈報董事會日期為114年5月6日。 本公司委任元大證券為本公司專業之股務代理機構辦理各項股東會事務。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一) 本公司已架設網站，提供財務業務相關資訊及公司治理資訊。
(二) 公司是否採用其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V	V	(二) 本公司設有英文網站，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露。本公司自公開發行以來，依循主管機關及相關法令規定辦理各項資訊之公告及申報；股東均可於公開資訊觀測站或本公司網站查詢及知悉公司各項訊息及重大事項（包含法人說明會等相關資訊）。本公司並確實落實發言人及其代理人制度。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？			(三) 本公司因海外子公司眾多，會計師事務所查核年度財務報告時程較長，故於會計年度終了後三個月內之法定期限內公告並申報年度財務報告。季度財務報告因係由會計師核閱，故本公司得配合於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，以提升公司資訊揭露透明度及時效性。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		(一) 員工權益與僱員關懷：本公司一向重視勞資關係，並以誠信對待員工，依勞基法保障員工合法權益；並透過各項員工福利制度及良好的教育訓練制度，與員工建立互信互賴之良好關係。 (二) 投資者關係：透過公開資訊觀測站及公司網站充分揭露資訊，讓投資人充分瞭解公司營運狀況，並透過股東會及發言人與投資者溝通。 (三) 供應商關係：本公司與供應商均保持良好互動的關係，並不

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>定期進行稽核以確保供應商品質。</p> <p>(四)利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人，並於公司網站設置利害關係人專區，利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。</p> <p>(五)董事進修之情形：本公司董事均具備相關專業知識並依法令規範進修相關研習課程，並符合進修時數之規定。</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司一向以穩健的原則進行相關之風險管理，訂有相關內部規章及內部控制制度以防範各項風險，並由內部稽核單位定期及不定期的查核內部控制制度的落實程度。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係並秉持客戶至上之政策，以創造公司利潤。</p> <p>(八)為董事購買責任保險：本公司已為董事購買責任保險，以強化股東權益之保障，並揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <p>113年度（第十一屆）公司治理評鑑結果，本公司名列上櫃公司排名前5%，已改善及擬改善事項說明如下：</p> <p>(一)已改善事項</p> <p>1. 於五月底前召開股東常會。</p> <p>2. 制定「提升企業價值計畫」並揭露於公開資訊觀測站。</p> <p>3. 變更「提名委員會」為「提名暨永續發展委員會」，將永續發展相關事項納入其職責範疇。</p> <p>(二)擬改善事項</p> <p>1. 研議發行或投資永續發展債券。</p>			

(四) 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

115 年 3 月 31 日

身分別		姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)		于明仁		請參閱本年報「貳、公司治理報告／(一)董事資料／3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容	請參閱本年報「貳、公司治理報告／(一)董事資料／3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容	-
獨立董事		羅達賢	-			
獨立董事		吳琮璿	3			
獨立董事		蔡子萱	1			

2. 薪資報酬委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (1) 定期檢討薪資報酬委員會組織規程及董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估並審核董事及經理人之薪資報酬之內容及數額。

3. 薪資報酬委員會年度工作重點彙整

114 年度薪資報酬委員會共召開 4 次，審議的事項主要包括一

1. 檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構：
審核本公司「員工酬勞分派辦法」以及「董事及功能性委員會酬金給付辦法」之修訂。
2. 評估並審核董事及經理人之薪資報酬之內容及數額：
審核 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
3. 審核本公司經理人之調薪案以及晉升案。

4. 薪資報酬委員會年度運作情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人，全體由獨立董事組成。

(2) 本屆委員任期：113 年 6 月 18 日至 116 年 6 月 17 日，最近年度(114 年)薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	于明仁	4	0	100%	第五屆 (113 年 6 月 18 日委任)
委員	羅達賢	4	0	100%	
委員	吳琮璿	4	0	100%	
委員	蔡子萱	4	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明

薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

三、薪資報酬委員會年度運作情形：

薪資報酬委員會期別/日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第二次 114.02.25	1.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2.本公司經理人調薪案		
第五屆第三次 114.05.06	1.修訂本公司「員工酬勞分派辦法」案	全體出席委員同意通過	
	2.本公司113年度董事酬勞分配案		
	3.本公司113年度經理人員工酬勞分配案		
第五屆第四次 114.11.04	1.修訂本公司「董事及功能性委員會酬金給付辦法」案	全體出席委員同意通過	
第五屆第五次 114.12.09	1.本公司會計主管異動案	全體出席委員同意通過	

(五) 提名暨永續發展委員會成員資料及運作情形：

本公司於 109 年 12 月設置提名委員會。因應公司治理及永續發展趨勢，為強化董事會在 ESG 層面之督導職能，本公司於 114 年 11 月 4 日第六屆第十次董事會決議通過變更「提名委員會」為「提名暨永續發展委員會」，擴大原有提名委員會之職掌，將永續發展相關事項納入其職責範疇。

1. 敘明公司提名暨永續發展委員會成員之委任資格條件及其職責

本公司提名暨永續發展委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有半數(含)以上為獨立董事，並由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1)依據本公司董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之需求，覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- (2)建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- (3)訂定並檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任規畫。
- (4)監督本公司企業社會責任之履行，以及企業永續發展策略，包含環境、社會、公司治理等各面向之規畫與執行。
- (5)其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

2. 提名暨永續發展委員會成員專業資格與經驗及年度運作情形

- (1) 本公司現任提名暨永續發展委員會委員共計五人，其中四人為獨立董事。

于明仁獨立董事為第三屆提名暨永續發展委員會之召集人，其具備財務管理、經營管理以及公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力。

- (2) 本屆委員任期：113 年 6 月 18 日至 116 年 6 月 17 日，最近年度(114 年)提名暨永續發展委員會開會 3 次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	企業永續專業知識與能力	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人 (獨立董事)	于明仁	請參閱本年報「貳、公司治理報告／(一)董事資料／3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容	再生能源管理、風險管理	3	0	100%	第三屆 (113 年 6 月 18 日委任)
委員 (一般董事)	徐秀蘭		再生能源管理、永續發展與企業管理	3	0	100%	
委員 (獨立董事)	羅達賢		永續發展與企業管理	3	0	100%	
委員 (獨立董事)	吳琮璠		金融與證券法規遵循、風險管理	3	0	100%	
委員 (獨立董事)	蔡子萱		減廢與循環經濟	3	0	100%	

其他應記載事項：

敘明提名暨永續發展委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名暨永續發展委員會成員建議或反對事項內容、提名暨永續發展委員會決議結果以及公司對提名暨永續發展委員會意見之處理。

提名暨永續發展委員會期別/日期	議案內容	決議結果	公司對提名暨永續發展委員會意見之處理
第三屆第一次 114.02.25	1.本公司董事會暨功能性委員會績效評估案	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第三屆第二次 114.11.04	1.本公司董事會外部績效評估報告案	全體出席委員同意通過	
	2.變更「提名委員會」為「提名暨永續發展委員會」案		
第三屆第三次 114.12.09	1.本公司會計主管異動案	全體出席委員同意通過	

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、 公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理層處理，及董事會監督導情形？</p>	<p>是</p> <p>V</p>	<p>否</p>	<p>摘要說明</p> <p>本公司經董事會通過訂定「永續發展實務守則」，以董事會為永續發展最高層級，負責審核、監督與指導本公司永續發展政策、制度與目標，並定期督導ESG相關管理方針及具體推動計畫，給予反饋或修正指示。因應公司治理及永續發展趨勢，為強化董事會在ESG層面之督導職能，本公司於114年11月經董事會決議通過變更功能性委員會「提名委員會」為「提名暨永續發展委員會」，擴大原有提名委員會之職掌，將永續發展相關事項納入其職責範疇。提名暨永續發展委員會由董事會推舉五名董事組成，其中半數(含)以上為獨立董事，負責監督本公司企業社會責任之履行，以及企業永續發展策略與環境、社會、公司治理等面向向永續發展之規畫與執行，以協助董事會強化管理機制並健全公司治理及永續發展。</p> <p>在管理與執行層面，本公司於106年6月成立「企業永續發展委員會」，由各單位主管組成，為公司內部最高層級的永續發展決策與管理中心，並受董事會督導，定期向董事會報告。企業永續發展委員會由董事長擔任主任委員，督導本公司相關業務發展方向與目標擬定，由財務長擔任總幹事，統籌委員會相關事務；另設永續長，由董事長擔任，帶領公司相關業務功能設置五個子委員會，包括「永續營運委員會」、「綠色製造子委員會」、「永續供應鏈子委員會」、「社會與企業關懷子委員會」以及「公司治理與風險管理子委員會」，由相關業務單位主管組織並擔任召集人，負責策略及管理方針之擬訂，確保永續發展策略充份落實於公司日常營</p>

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>運中。企業永續發展委員會設置「永續發展推動小組」，擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台，自114年起，永續發展推動小組每季舉辦工作會議追蹤永續目標執行成效及持續改善，另依各項ESG專案而設之任務小組就相關議題進行跨部門整合及執行推動。企業永續發展委員會每年召開全會議，針對本公司重大永續議題檢視當年度目標達成情形，並檢視短、中、長期目標之設定。</p> <p>企業永續發展委員會受董事會之督導，除每年度（至少一年一次）向董事會呈報永續發展推行情形與目標訂定及達成績效外，每季並由永續長向董事會報告氣候與環境相關議題之績效指標及相關數據（最近一次呈報董事會日期為115年3月3日）。本公司主要參考全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, 簡稱 GRI）所發行的「永續性報告準則」要求及永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, 簡稱 SASB）所發行的「永續會計準則」依循半導體行業類別指標及「上櫃公司編製及申報永續報告書作業辦法」及TCFD氣候相關財務揭露的建議與實施指引進行永續報告書之編製，永續報告書並於發布公告前經提報董事會討論決議通過。董事會督導本公司永續發展之目標訂定及推行情形檢討，並依據企業永續發展委員會報告內容給予相關建議與指導。</p>	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>員協助督導。高階管理階層負責規劃及指揮調度董事會風險管理決策之執行，及協調跨部門之風險管理互動與溝通，以降低策略性風險。各功能單位負責分析、管理及監控所屬單位內之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效執行。另由內部稽核做為獨立單位，協助董事會監督風險管理機制之落實程度，查核各功能單位風險應變與控制之執行，提供風險監控改善建議。風險管理範疇包括危害風險、營運風險、財務風險、策略風險、合規風險/合約風險、環境風險及其他風險等，透過風險管理流程（包括風險辨識、風險衡量、風險監控、風險報告、風險之回應）之有效執行以落實公司之風險管理機制。</p> <p>本公司企業永續發展委員會依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，將重大議題分析納入公司整體風險管理中，以辨識出相關風險項目並據以訂定風險減緩因應措施，風險評估邊界涵蓋本公司所有營運及生產據點。本公司114年度重大議題包括「公司治理、經營策略與財務績效、道德誠信、資安與個資保護、產品品質與安全、永續供應鏈管理、氣候策略與行動、能源管理、廢棄物管理及循環再生、水資源管理、人才吸引與留任、人才發展、職業健康與安全」，另參考最新版之《全球風險報告》，考量與公司營運及半導體產業價值鏈密切相關之永續議題，辨識中長期（3-10年以上）可能對營運及價值鏈產生重大影響之新興風險，包括「氣候變遷與關鍵資源供應風險、關鍵技術演進與AI應用風險、半導體產業人才短缺風險、地緣政治與供應鏈重組風險」。上述各項議題、辨識出的風險項目，以及相對應之風險減緩因應措施等詳細資訊，請</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務異情形及原因
	是	否	
三、 環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V	<p>本公司透過在集團各生產據點推動「ISO14001環境管理系統」及「ISO50001能源管理系統」，導入產品生命週期之概念，從製程及產品設計階段改善做起，真正做到源頭原物料之減量。本公司配合環境及能源管理系統每年訂定節能、節約物料使用之目標，亦持續實施水回收、減廢之措施，以珍惜資源降低資源使用量，同時達到降低溫室氣體排放之成效。集團各生產據點「ISO14001環境管理系統」及「ISO50001能源管理系統」取得認證效期皆涵蓋115年度。</p> <p>集團各生產據點取得「ISO14001環境管理系統」及「ISO50001能源管理系統」認證相關資訊請參閱本公司網站>企業永續>環安衛管理>相關認證 (https://www.sas-globalwafers.com/ehs-management-system/)。</p>	無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	<p>參閱本公司永續報告書「第二章、治理與營運/2.3風險管理」。為落實風險管理機制，本公司企業永續發展委員會每年定期（至少一年一次）向審計委員會及董事會報告公司及相關之環境、社會、公司治理之重大議題、風險項目及相關因應策略、管理運作與執行情形，並由審計委員會及董事會給予意見與指導，最近一次呈報日期為114年5月6日。另考量氣候變遷議題之重要性與特殊性，企業永續發展委員會每季另向董事會報告環境指標績效與目標、氣候變遷議題之因應與管控等相關事務。</p> <p>本公司於各生產據點導入「ISO50001能源管理系統」，積極推動各項節能措施，選用提升能源效率之設備，監測重大能源使用設備，並定期追蹤改善措施之績效，以達到持續改善、節能減碳的目標。本公司用電量與目標達成情形請參閱永續</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實績守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>報告書「第四章、永續環境／永續目標；4.2能源管理」。</p> <p>本公司另推動「ISO14001環境管理系統」，導入產品生命週期之觀念，減少原物料耗用及廢棄物產出，以達成永續經營、環境保護的目標。本公司各廠區依製程特性不同，儘可能地使用再生物料，各廠區使用的再生物料包含矽原料、切削液（載劑）、產品包裝紙箱及晶舟盒等項目；本公司生產使用之主要原料為矽料，在長晶階段盡可能使用廠內回收的頭尾料不但可節省購料之成本，亦可減少廢棄物之產出。本公司再生物料使用情形請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.4.1原物料再利用」。</p>	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V	<p>本公司依據金融監督管理委員會「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「上市櫃公司永續發展行動方案」之推動主軸，並參考國際金融穩定委員會制定之氣候變遷相關財務架構揭露指引（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Recommendation, TCFD）及國際財務報導準則第 S2 號（IFRS S2）架構，揭露本公司對氣候相關風險與機會之治理、策略、風險管理、指標和目標等核心內容之事項，以鑑別評估氣候變遷對於公司的風險與機會、潛在財務衝擊，以及相應的應對策略與措施。</p> <p>本公司識別出與環球晶圓相關之10項實體風險項目、16項轉型風險項目，以及10項機會項目，依據發生可能性與衝擊程度評分計算風險機會值，並考量產業特性，參考同業鑑別結果，篩選並聚焦於風險機會值較高的3項氣候風險與3項氣候機會，評估各項風險與機會對公司的潛在財務衝擊，並分別擬定應對策略及措施。以上相關分析資訊請參閱本報「貳、</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	<p>公司治理解報告／三、公司治理運作情形／(七)上市上櫃公司氣候相關資訊」以及本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.1氣候策略與行動」。</p> <p>集團各生產據點每年盤查追蹤溫室氣體排放量、用水量、廢棄物量、再生物料使用情形、及用電量等，相關盤查數據及資料涵蓋範圍請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.1.1溫室氣體盤查；4.2能源管理；4.3水資源管理；4.4廢棄物管理；4.4.1原料再利用」。</p> <p>本公司依營運活動之影響，推動各項措施以降低公司營運對自然環境之衝擊。本公司在節能減碳項目建置能源管理系統(ISO 50001:2018)、溫室氣體減量項目建置溫室氣體盤查(ISO 14064:2018)、減少用水項目進行產品水足跡查證(ISO 14046:2014)、以及清潔生產評估，以上均委外進行第三方驗證/查證通過。驗證之相關資訊請參閱本公司網站>企業永續>環安衛管理>相關認證(https://www.sas-globalwafers.com/ehs-management-system/)。</p> <p>本公司針對用電量、溫室氣體排放量、用水量、及廢棄物量等分別設定有年度目標及短期、中期、長期目標，相關目標資訊及達成情形請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／永續目標」。</p> <p>本公司並藉由下述推動措施以達成上述設立之目標： (1) 能源耗用與溫室氣體排放減量：本公司溫室氣體之主要排放來源是電力，因此電力使用之減量及能源效率之提升為公司首要之務。本公司藉由導入「ISO50001能源管理系統」，監督量測重大能源使用設備，並提出行動改</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>善計畫，定期追蹤相關改善措施的成效，另於內部宣導節約能源，以達到持續改善、節能減碳的目標。</p> <p>此外，因應轉型風險，本公司已制定「溫室氣體管理政策」，並擬定及持續推動以下五項溫室氣體減量策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 採用再生能源：以自建太陽能發電系統與購買外部再生能源及再生能源憑證等內外部兩種管道併行以持續提升再生能源使用比例。 ● 提升能源使用效率：透過設備改良、再設計，以及汰換老舊能效較差的設備等，進而降低設備運作時耗用之能源。 ● 上游價值鏈分級管理：依照採購原物料造成之碳排放量，對供應商進行分級管理，推動供應商進行產品碳足跡盤查，並將其減碳規劃與執行情形納入採購評估機制，以促進範疇三溫室氣體排放之減量。 ● 購買碳補償商品：透過購買自願性碳權等碳補償商品，達成階段性的碳中和與2050年淨零排放的承諾。 ● 支持碳清除與碳捕捉：支持推展植樹造林的自然碳捕捉與人為碳捕捉計畫，同時參與其他自然解決方案及自然保護計畫。 <p>集團各生產據點最近三年度之溫室氣體排放量及用電量、減量目標、管理措施以及達成情形等，請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／永續目標；4.1.1溫室氣體盤查；4.2能源管理」，其中溫室氣體排放量最近二年度皆經第三方驗證通過，「ISO50001能源管理系統」認證效期涵蓋115年度。</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>(2) 減少用水：本公司節水措施管理流程，主要分為廠務系統及製程設備進行分項管理，持續提升製程改善會議及宣導節約用水。集團各生產據點最近三年度之用水量、減量目標、管理措施以及達成情形等，請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／永續目標；4.3水資源管理」。</p> <p>(3) 廢棄物管理：本公司重視廢棄物管理，從製程改善及源頭減量，以減少廢棄物（包含空氣污染源排放物質）之產出，並於廠內進行回收再利用，減少新購原物料量，同時也減少廢棄物之產生。集團各生產據點皆已通過「ISO14001環境管理系統」驗證（認證效期涵蓋115年度），並每年持續驗證。最近三年度之廢棄物產出量、量化管理目標、管理措施以及達成情形等，請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／永續目標；4.4廢棄物管理」。</p> <p>(4) 污染防治：本公司推動綠色產品與綠色生產，從製程設計與技術提升，減少原物料之耗用，不僅從源頭減少污染排放，亦能降低營運成本、減少資源消耗及降低對環境之衝擊。</p>	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V	<p>本公司認同並支持《聯合國世界人權宣言》(Universal Declaration of Human Rights)、《聯合國全球盟約》(United Nations Global Compact)、《國際勞工公約》(International Labour Conventions)、《聯合國工商企業與人權指導原則》(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) 與《責任商業聯盟行為準則》(Responsible Business Alliance Code of Conduct) 等國際人權公約所揭示之人權保護精神與基本原則，並依循相關勞動法規及上述國際人權公</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>約，制定有「人權政策」，致力於建構平等、安全且有尊嚴的工作環境。本公司「人權政策」請參閱公司網站>企業永續>永續報告書與相關政策> ESG 相關政策 (https://www.sas-globalwafers.com/csr-download-tw/)。</p> <p>本公司「人權政策」適用於集團全體員工（包括正職員工、契約及臨時人員、實習生等），並致力推動合作及供應鏈夥伴以相同的標準落實營運架構，於「企業永續發展委員會」轄為最高層級的人權治理機構，於「企業永續發展委員會」轄下「社會與企業關懷子委員會」成立跨部門人權工作團隊，包括人力資源、法務、環安衛、營運生產等功能組織，共同推動人權管理作為，並定期向委員會報告相關執行成果。</p> <p>本公司「人權政策」之五大政策方針及其相關執行情形如下： (1) 持續創造多元包容性與平等機會，禁止任何形式的歧視（含性別（含性傾向）、種族、國籍、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙等）； 本公司在所有招募、任用、營運過程中，持續宣導禁止所有不當歧視的行為。除此之外，為善盡照顧移工的責任，與人力仲介合作，致力於提升其海外生活的起居條件。 本公司致力於落實友善、平等的職場環境，依據《性騷擾防治準則》及《工作場所性騷擾防治措施準則》訂有完善的「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」並公告於廠區佈告欄。 針對女性員工，本公司亦提供多元的資源以鼓勵其職涯</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>持續發展，如完善的母性保護措施、依據性別工作平等法制定規範、制定內部講師、在職進修、教育訓練等政策，以提供多元的發展機會。</p> <p>本公司致力於促進職場多元平等共融，訂有「多元、平等、共融 (DEI) 職場宣言」及政策，嚴格遵守各國當地法令，無論性別、種族、國籍、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、文化、黨派、性傾向、階級或身心能力等因素，每個人都能在這裡感受到尊重和包容。具體成果如：114年度，本公司女性職員佔全體員工比例為22.40%，女性主管則佔全體主管人數的21.23%；全球員工總數為7,061人，國內員工佔全體員工比例為22.60%，海外員工則佔全體員工比例為77.40%；全球身心障礙聘僱人數共計95人，佔全體員工比例為1.35%；30歲以下員工佔16.38%、30~50歲員工佔50.19%、50歲以上員工佔33.43%。</p> <p>(2) 禁止人口販運、強迫勞動與僱用童工；</p> <p>本公司遵循所有勞動相關法令，制定相關規定於「人事任用辦法」及「商業與員工道德行為準則」當中，認同並支持《聯合國工商企業與人權指導原則(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)》、《聯合國世界人權宣言(Universal Declaration of Human Rights)》、《國際勞工組織的工作基本原則與權利宣言(ILO Declaration of Fundamental Principles and Right of Work)》、《責任商業聯盟行為準則(Responsible Business Alliance Code of Conduct)》、《RBA驗證審計計畫執行手冊：收取費用之定義(RBA Validated Audit Program (VAP) Operations Manual: Definition of Fees)》，尊重所有員工的意願，並鼓勵兼顧工作與家庭；確保無任何形式</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>的強迫勞動，包括但不限於債役或契約勞工、非自願或剝削性監獄勞工、奴役或販賣的人口；保障勞工出入工作場所自由，也確保勞工在工作場所內的行動自由，適用包括勞工宿舍或生活住所；公司嚴格禁止任何形式的強迫勞動，並承諾不向勞工收取費用或任何何何主之中介人或二級中介人向勞工收取招聘費用或任何何其聘用相關之費用；如有發現相關情形，將即時採取改善活動補救措施，以確保勞工權益。此外，確保所有營運活動中沒有不法童工，若發現童工涉及營運過程中，相關補救計畫將持續六個月或直到童工滿十六歲止，以保障兒童權益。</p> <p>(3) 建立安全與健康的工作環境，禁止任何形式的騷擾行為及不人道之待遇；</p> <p>本公司對任何形式之職場不當行為採取零容忍立場，包括但不限於職場暴力、職場霸凌、性騷擾及就業歧視等情形。公司致力於建立一個安全、尊重與平等的工作環境，嚴禁任何透過言語、行為或其他方式對員工造成身心傷害之行為，並將積極預防、即時處理及採取必要之糾正與懲處措施，以保障所有員工之人格尊嚴與合法權益。</p> <p>本公司持續提供免費健康檢查、安排職業醫學專科醫師臨廠服務、舉行健康促進活動、追蹤特殊族群...等，來提升員工自我健康管理意識。於114年度，本公司國內廠區共規劃92場次的健康促進措施，如講座、緊急救護課程、防癌篩檢等，共計8,781人次參與。此外，海外廠區也經常舉辦多元的健康促進活動來保障員工健康，共計508次相關活動場次及設施使用次數，計20,685人次參與。</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>或使用健康促進設施。本公司另訂定各項工作安全與衛生管理程序、作業標準，特殊危害作業管制、化學品管理、作業環境監測讓同仁遵循，預防職業傷病，消除危害及降低環境安全風險，提供員工安全的作業環境。</p> <p>(4) 提供公平合理的薪資與工作條件： 本公司定期審視同業薪資水平，並參考總體經濟指標、物價指數等客觀數據，對員工薪酬作適當調整；同時為了公平性，同仁敘薪標準皆依職位、年資與專業能力等工作相關項目進行判斷，確保同工同酬並避免性別、年齡或其他條件上之歧視與差異。此外，公司也嚴格控管工時不逾法令上限，透過定期的工時分析報告、出勤異常管理系統來累積極防範過勞。</p> <p>(5) 提供自由表達意見的管道及環境，尊重員工自由結社之權利： 本公司每季舉辦至少1次勞資會議、每半年舉辦1次移工溝通會議，就勞資關係協調、勞動條件、勞工福利等事項進行討論，以促進勞資關係和諧。公司內亦於適當明顯處設置員工意見箱，以提供員工檢舉不法、申訴不平，使員工的不滿與疑惑得以抒發、解決。114年度，台灣廠區共舉辦33場勞資會議與6場移工溝通會議。海外廠區共計2,326名員工參加其所屬國家之公司工會或產業工會，團體協約涵蓋的員工百分比為32.96%。無論員工是否參加工會，均可透過會議、電話或電子郵件等以具名或不具名方式向公司經營團隊提出改善工作環境或工作條件等建議，強化公司經營團隊與員工間的良好溝通。</p>	
		本公司每年依循《責任商業聯盟行為準則 (Responsible	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>Business Alliance Code of Conduct》之標準進行人權、勞工權益等風險評估，公司持續利用RBA設計的標準化風險評估範本（Self-Assessment Questionnaire, SAQ），自行鑑別業務中「勞工、健康與安全、環境、道德規範以及強迫勞工」相關實質作為、風險以及管理體系，114年度Corporate SAQ分數達到89.6分的「低風險」範圍內。本公司並將標準制定於「人事任用辦法」、「性騷擾防制措施、申訴及懲戒辦法」當中，員工可透過匿名的申訴管道，如：信箱與電話來申訴不法侵害，相關的委員會將以全程保密的方式處理，會議結果將用以積極追蹤、監督並給予當事人必要的支持，以保障人權及避免再發生。本公司海外廠區於114年度共發生2起人權事件申訴（強迫勞動、童工、歧視、騷擾及違反結社自由），相關部門已立即組成委員會並啟動調查、保護及再教育，後續也立即優化全體員工的人權教育訓練以防範未然。</p> <p>訓練部分，新進人員於到職即辦理人權相關教育訓練，在職人員則為不定期安排職場暴力侵害、性騷擾防治宣導等課程，此外，更依據公司鑑別出的主要利害關係人，將主管職員工列為必修人員，極力預防職場不法侵害的發生。於114年度舉辦相關課程共計7,809人次參與、總訓練時數14,093小時。</p> <p>依據《聯合國工商企業與人權指導原則（United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights），所有企業都負有尊重人權之責任，人權盡職調查在環球晶圓的營運政策及活動當中是不可或缺的環節，本公司依循(1)鑑別與評估、(2)採取行動、(3)檢視成效、(4)對外溝通之調查流程進行人權盡職調查以確保涵蓋國際人權組織所建議的核心要素。</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>114年度人權盡職調查執行情形：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調查範圍：集團全體員工、供應商 ● 權責單位：人力資源、環安衛、健康中心、法務以及採購單位共同承辦。 ● 調查流程：(1)鑑別與評估、(2)採取行動、(3)檢視成效、(4)對外溝通。 ● 評估工具：包含但不限於(1)勞動法律遵循、(2)RBA SAQ、(3)員工健康檢查、(4)員工申訴機制、(5)勞資會議、(6)員工協助方案EAP、(7)內部控制制度、(8)母性保護相關危害評估、(9)供應商風險評估及現場稽核、(10)供應商行為準則暨供應商承諾書。 ● 重大人權風險議題：勞動法規、童工、強迫勞動、工作條件、歧視與騷擾、人口販運、集會結社自由、平等與同工同酬、母性保護共9項目。 ● 減緩及補救措施：針對上述各項重大人權風險議題，本公司提出減緩及補救措施，包括制定並落實勞動法令遵循與內控制度、強化招募與身分查核以杜絕童工與強迫勞動、建立工時與工作負荷管理機制、推動職場反歧視與反騷擾教育訓練、落實公平薪酬與同工同酬原則、保障員工集會結社與申訴權利、設置多元溝通與申訴管道、提供員工協助方案(EAP)與健康檢查、執行母性健康保護...等措施，並於發生疑似或實際人權事件時，即時啟動調查、矯正、補償與持續追蹤改善機制，以確保人權風險獲得有效控管與補救。 <p>關於上述各項重大人權風險議題之鑑別與評估，以及其減緩及補救措施施行成果之詳細資訊，請參閱本公司永續報告書</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等), 並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V	<p>「第五章、人才發展與社會共融/5.4人權/人權盡職調查」。本公司依據公司章程第三十一條所載, 年度如有獲利應提撥3%~15%為員工酬勞, 前項員工酬勞數額中, 應提撥不低於該數額之60%為基層員工分派酬勞, 並依本公司「員工酬勞分派辦法」之程序按員工績效公平核給發放之, 期將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。115年度本公司已經董事會決議提撥114年度獲利之4.35%分派員工酬勞, 並自前項員工酬勞數額中, 提撥60%為基層員工分派酬勞。</p> <p>本公司依照勞動基準法制定出勤辦法, 載明員工休假權利, 本公司員工除享有勞保、健保、團保、退休金給付等一般福利外, 由公司提供之福利包括發給年節獎金、生日及節慶禮品、舉辦年終晚會、婚喪喜慶、員工旅遊、急難救助、獎學金補助、在職進修補助、生育補助、提供團膳、及提供完整之教育訓練講習等, 並成立ECP (Employee Caring Program) team, 透過跨部門小組, 整合規劃提升員工整體福利, 讓員工在遇到個人問題時, 能選擇適當的資源獲得協助。</p> <p>本公司自110年起亦增加員工福利儲蓄信託, 員工可自行評估加入與否, 參與者則依照個人提撥金額給予100%的獎勵金。</p>	無重大差異
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期實施安全與健康教育?	V	<p>本公司依照ISO45001國際標準, 建立職業安全衛生管理系統, 系統涵蓋公司主要的營運場域, 將安全與健康深植於日常營運之中。本公司已取得職業安全衛生管理系統(ISO45001:2018)之認證, 認證效期為2025年8月1日至2028年7月31日, 其他分公司及子公司取得ISO45001認證之詳細資訊請參閱本公司網站>企業永續>環安衛管理>相關認證(https://www.sas-globalwafers.com/ehs-management-system/)。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實踐及原因異情形
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>勞工作業環境監測：為保障勞工免於作業場所中有害物質的危害，提供勞工健康舒適的工作環境，公司每年均執行2次作業環境監測，以瞭解工作人員的暴露實態。</p> <p>職業安全衛生查核：除了規定期與不定期的安全作業查核外，為了強化員工對安全的重視，我們將每年9月訂為「工安月」，並透過各項查核與活動強化安全管理。114年度『工安月』採取系統化架構，聚焦四大核心領域展開專案活動，旨在全面深化員工安全意識並落實各項管理作為，推動範圍涵蓋：強化化學品源頭管理、評估極端氣候營運風險、深研過往安全事故教訓，以及落實緊急應變演練，透過這四大面向的深度整合，構築更具韌性的職場安全文化。</p> <p>設備安全管理：對於危險性機械及設備均予以列管，並依照「危險性機械及設備安全檢查規則」辦理定期檢查，確保設備能安全操作。</p> <p>為提升工作者的職業安全衛生意識與應變能力，本公司每年依據內部管理需求、同仁反饋及外部議題，規劃安衛教育訓練計畫，強化工作者在職場中的安全素養與風險發展的關聯力。此外，我們視員工健康為企業邁向成功與永續發展的關鍵，並以「母性保護」、「預防異常工作負荷」、「中高齡及高齡員工健康保護」、「預防職場不法侵害」及「因人因性危害預防」五大主軸，規劃企業內部的員工關懷方案（ECP, Employee Caring Program），提供員工全方位的健康照護。</p> <p>近三年工安教育訓練與宣導：本公司將安全衛生教育訓練列</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實踐守則差異情形及原因								
	是	否									
		<p>摘要說明</p> <p>為員工入職與在職期間的必修課程，內容涵蓋危害物質辨識、緊急逃生演練、個人防護具穿戴、消防訓練操作、機械防護、人因肌肉骨骼傷害預防、AED&CPR急救訓練等，透過訓練及宣導確保員工自入職起即具備環安衛意識，降低或消除職業危害風險。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>安全衛生教育訓練人次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>22,535</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>28,374</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>29,571</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司職業災害統計分析資料，係依據勞動部及GRI準則所公布之失能傷害統計指標，以每百萬工時為基準，以失能傷害頻率(FR)、失能傷害嚴重率(SR)、職業病率(ODR)及缺勤率(AR)做為主要統計依據(失能傷害統計數字不包含廠外交通意外事故)。114年度，台灣區共發生10件工傷失能事件，海外區共發生39件工傷失能事件，全球廠區失能傷害頻率(FR)為3.51，失能傷害嚴重率(SR)為95，職災人數佔員工總人數比率為0.69%，所有職災事件皆已進行事故調查分析並執行相應改善措施。為有效防止職業災害發生，本公司定期實施員工、承攬商職安衛教育訓練、工作環境巡檢及內/外部稽核，檢視公司之環境、安全、衛生作業，以確保工作者環境安全，並以邁向零災害事故為目標。有關職業災害統計及管理等詳細資訊，請參閱本公司永續報告書「第六章、職業健康與安全/6.1.4 職業傷害與事件統計」。</p> <p>本公司於114年度火災之件數、死傷人數及死傷人數佔員工總人數比率均為0。本公司為提升安全管理(包含消防安全管管理)、有效應變災害發生及矯正/預防事件再發，訂有「事</p>	年度	安全衛生教育訓練人次	112	22,535	113	28,374	114	29,571	
年度	安全衛生教育訓練人次										
112	22,535										
113	28,374										
114	29,571										

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V		無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際標準則，並制定相關保護消費者客戶權益政策及申訴程序?	V		無重大差異

運作情形

摘要說明

件通報、處理及調查管理程序」、「緊急應變處理程序」、「不符合事項、矯正及預防措施管理程序」等相關程序文件，並針對可能發生的緊急狀況辦理應變演練。

本公司每年依據營運策略及短中長期目標，規劃年度教育訓練計畫，並視人才培育和技術傳承為執行重點，強化人才資料庫，以掌握集團人才動態及發展方向，並舉辦不同類型的訓練課程及產學合作、專案研究，俾利員工即時掌握全球政經趨勢動態、技術新知，並輔以職務代理、職務輪動與在職訓練等機制，強化員工不同的職能。本公司亦推展六大學院、體系，包含新入學學院、後勤通識學院、管理經營學院、專業核心學院、環安衛生學院、健康促進學院等六大學院，訓練單位將針對各學院專業領域設計相關課程，提供同仁上課。採行學院制擁有避免重複性開課、可進行學程規劃、訓練學習堆疊透明化等諸多好處。

114年度共計辦理新人職能訓練290堂、927人次、開課時數共計28,598小時；專業職能訓練1,179堂、15,220人次、開課時數共計39,027小時；通識職能訓練3,198堂、45,898人次、開課時數共計57,878小時。

本公司對產品與服務，皆遵循本公司產業別所適用之相關法規及準則，透過供應商管理，確保供應鏈採納「責任商業聯盟行為準則」(RBA)、「無衝突礦產」、「無強迫勞動成分之矽原料」、「環保產品」(RoHS、REACH、WEEE)……等業界標準及政策，實踐社會及環境責任；本公司同時致力遵循客戶所要求之產品標準及廠區作業規範，全力達成允諾事項，維持優質合作關係。本公司並設有法令遵循單位確保商務條件、產品、流程和服務能符合競爭法與管轄權之出

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>口管制相關法規要求。本公司與客戶合作之前，均應簽署經悉法務單位核准之保密協議（NDA），且人員不得洩露所知之營業秘密，俾充分保障雙方之敏感及機密資訊。</p> <p>本公司於公司網站揭露客戶政策，秉持「嚴格自我要求，堅持優良品質水準，了解客戶需求，提供穩定的高品質產品，全力達成允諾事項，以維持優質的長久合作關係」之經營理念。本公司於「誠信經營程序及行為指南」第十四條訂有防範產品或服務損害關係人之權益、健康、安全，以及確保產品合規之相關規範。此外，行銷單位制定「客戶訴願管理流程」，與客戶間保持良好之溝通管道，並對產品與服務提供透明且有效之客訴處理程序，亦於公司網站公告客訴聯絡窗口資訊。</p> <p>關於客戶個人資料保護，本公司已制定「隱私權政策」，詳細規範本公司在蒐集、處理、利用、存取和揭露可識別特定自然人之資料（個人資料，適用範圍包含員工、客戶人員、供應商人員、承攬商人員...等所有自然人）的過程中，所應遵循的規範及程序，主要包含「隱私保護」、「個人資料之蒐集、處理、利用」、「安全措施」三個面向，其具體內容已發布於本公司網站>企業永續>永續報告書與相關政策>ESG相關政策</p> <p>(https://www.sas-globalwafers.com/csr-download-tw/)供利害關係人查詢。除上述「隱私權政策」外，本公司亦訂有「個人資料保護管理辦法」以資管理，規範同仁對於業務所經手個人資料之蒐集、處理、利用行為，並由本公司法令遵循課定</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	是	否	<p>期執行查核及舉辦「個人資料保護教育訓練」，責成資料權責單位對於業務所涉及之個人資料實施盤點，確保資料權責單位對於個人資料之蒐集、處理、利用行為，均以符合個人資料保護法規定方式辦理。114年度，本公司發放Global Data Protection Survey對海外主要營運廠區執行查核，發現缺失者，由法務單位配合當地法令輔導各廠建置或改善政策、辦法及程序書內容，及簽訂當地法規要求文件(如PDPA Transfer Agreement等)，以確保本公司持續以最高標準執行個人資料保護；此外，並舉行隱私保護教育訓練(註：合併於企業勞工與道德行為準則教育訓練辦理)，參與人次計1,718人。本公司於114年未發生任何個資外洩、竊取、竄改、毀損、滅失、洩漏...等侵害隱私權之不法情事。</p> <p>本公司訂有「供應商評鑑管理流程」，並於本公司官網揭露企業永續之供應鏈管理政策，其中要求供應商遵守行為準則，除了誠信原則之外，致力遵行「責任商業聯盟行為準則(RBA, Responsible Business Alliance)」旨在確保勞動安全、商業營運環保與道德操守，建立勞工、健康與安全、環境及商業道德標準與規範，包含RoHS、REACH及WEEE等綠色法規指令且不使用衝突礦產、配合投入綠色採購行列及環境保護暨職業安全衛生、智慧財產權、及勞動人權等。</p> <p>鑒於《現代奴役法案》，本公司於各國營運活動皆符合勞動人權，遵守當地法律，包括人口販賣和反奴隸制度各項法案，故本公司亦要求供應商共同遵守並堅持其所有的商業交易、商業關係和供應鏈活動皆符合道德規範，以誠信為上。</p> <p>本公司「供應商評鑑管理流程」，包括書面評審與實地評鑑，</p>
			無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>每年由品保、採購、環安衛、研發及相關單位組成供應商評鑑小組，執行供應商稽核、文件審查（包含品質、上游供應商管理、環境與安全、營運計畫、人權、資安等），並與其主管與員工面談，發現問題並進行改善。</p> <p>本公司鼓勵供應商取得 ISO14001、ISO45001、RBA、ISO14064、ISO14067、ISO27001 等認證，善盡企業社會責任，每年追蹤並於季度評核時加分，並增加採購比例予以鼓勵。</p> <p>本公司並依據 RBA 標準及公司永續目標，制定「供應商永續標準」，導入供應商管理自評與覆評機制，此機制不僅有助於提升供應商於環境、社會責任及公司治理（ESG）方面的表現，亦能推動其持續改善。透過每年自評問卷與相應管理，公司能夠掌握供應商在可持續發展領域的表現及進展，並對其進行必要的輔導與協助，確保供應鏈發展方向與本公司一致，並確保其實踐效果。</p> <p>本公司對供應商之永續管理評鑑，不僅深化與供應商的合作關係，亦提升供應鏈的韌性與透明度，為企業的永續發展奠定堅實的基礎。截至114年12月，本公司已完成108家主要供應商的永續評鑑，供應商自評達成率89%，其中有81家(67%)已獲取ISO14001認證，20家(17%)已獲取ISO14064-1溫室氣體盤查認證，11家(9%)已獲取ISO14067產品碳足跡認證，14家(12%)已獲取RBA認證，14家(12%)已獲取ISO27001認證。主要原料供應商在永續評鑑的覆評結果中，20%獲得滿意的評分(Level A, Satisfaction)，80%為良好(Level B, Acceptable)。本公司持續推動供應商取得溫室氣體盤查與碳足跡認證，並</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>啟動降低溫室氣體排放計畫。</p> <p>為了推動供應鏈落實ESG，本公司呼籲供應商夥伴：</p> <p>(1)優化流程：精簡程序，以減少浪費並提升交易效率。</p> <p>(2)提升良率：改進生產方法、設備，以最大化效率並降低單位成本。</p> <p>(3)創新材料：探索環保替代品，降低環境影響，同時兼顧成本效益。</p> <p>為實現綠色半導體生態，本公司要求所有主要供應商達成對應等級的永續目標，例如：設定近期目標 (SBTi committed)、完成主要產品的碳足跡評估、提出減碳計畫等。</p> <p>此外，本公司在供應商ESG管理部分，著重於以下面向的表現，並進一步評核供應商等級，推動供應商與環球晶圓共同達成永續發展的目標。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 碳足跡準備度：確認符合ISO14067標準。 • 碳足跡定期審核：每兩年進行一次，重點關注減排比率。 • 碳減排目標：制定2030年前應實現最低之減碳比率。 <p>本公司於114年在Carbon Disclosure Project (CDP) Climate Change 問卷之 Supplier Engagement Assessment (SEA) 中獲得A評分，為該評估之最高等級。此評分反映本公司於供應鏈治理、減碳目標、範疇三排放管理及價值鏈參與之制度化管理成熟度。(Source: CDP Worldwide)</p> <p>本公司在供應商永續管理評鑑中依循RBA框架之要求，將人權風險辨識、評估、預防與改善納入供應鏈管理。調查流程</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>主要透過問卷自評與文件審查，針對本公司關鍵物料供應商進行人權風險盤點，並依風險程度採取抽樣方式執行實地稽核。審查內容涵蓋重大人權議題，包括薪資給付與工時管理、職場健康與安全、結社自由、不歧視與平等對待原則、申訴機制設計與反報復保護等（依 RBA 條目與在地法規相容性檢核）。對於調查中發現之缺失或改善需求，本公司將提供必要之教育訓練、溝通輔導與改善支持，並要求供應商提出矯正行動計畫並持續追蹤其完成情形。人權盡職調查之執行與改善結果納入年度供應鏈永續管理工作中，並定期檢討以確保供應鏈在人權議題之管理能符合國際標準與公司永續目標。</p> <p>114年度供應商人權盡職調查執行情形：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調查方式：書面審查與實地稽核 ● 書面審查：108家供應商 ● 實際稽核：2家供應商 ● 實地稽核組成員：採購、人資、及環安衛等跨部門人員 ● 主要目的：確認供應商在勞動權益、工作條件、職業安全及人道標準之符合性。 ● 重大人權議題：薪資給付與工時管理、職場健康與安全、結社自由、不歧視與平等對待原則、申訴機制之設計與反報復保護等議題。 ● 執行情況：稽核完成率100% ● 減緩及補救措施：持續定期進行供應商自評與供應商永續稽核，依據評核結果要求供應商提出矯正行動計畫，提供其必要之教育訓練、溝通輔導與改善支持，並持續追蹤，作為後續評估與管理優化之依據。 	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實際情形及原因
	是	否	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V	<p>關於資訊安全及隱私權保護議題，本公司於113年取得ISO27001資通安全管理系統認證，並相應訂定供應商緊急情況通報與溝通準則，結合永續評鑑機制帶領客戶資產安全強化。本公司在供應商永續評鑑中進行相關調查，例如是否導入ISO27001資通安全管理系統、是否制訂資訊安全管理之相關政策、近一年是否進行資通安全演練、是否遵守《供應商永續標準》(涉及隱私及個資保護等規定)等；此外公司基於IAATF16949所制定之企業持續供應計畫，包含資訊技術失效及遭受網路攻擊等情境，要求關鍵原料供應商遵從並建立標準，例如供應商應於災害發生6小時內進行通報，24小時內提供詳細產線受損狀況及災變復工計畫，以符合持續供應的基本原則及預防供應鏈中斷之風險。</p> <p>114年度企業持續供應計畫調查執行情形：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調查方式：書面審核供應商持續供應計畫，簽署「供應商緊急情況通報與溝通」 ● 調查家數：81家供應商 ● 主要目的：確認供應商緊急災害應變計畫有效性 ● 執行情況：調查完成率100% 	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明 之編製。本公司114年度永續報告書經優麗國際管理系統股份有限公司(DQS Taiwan Inc.)查證符合 GRI Standards參考要求及AA1000 AS v3標準的Type II中度保證等級的要求，114年度永續報告書揭露於公開資訊觀測站及本公司網站>企業永續>永續報告書與相關政策 (https://www.sas-globalwafers.com/csr-download-tw/)。	
	<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已訂定「永續發展實務守則」，公司業已致力於推動永續發展，與所訂守則無重大差異。</p> <p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1.環保方面：推動環保低碳活動人人有責，本公司除加強製程之節能管控外，積極落實垃圾分類，資源回收工作，並推展節能減碳，投入節能減碳設備支出。 2.社會公益：本公司持續評估營運所在地社區的風險與機會，台灣區營運所在地包括新竹、苗栗與宜蘭，海外廠區營運所在地包括美國、義大利、日本、韓國、中國大陸及馬來西亞...等。本公司致力於關懷營運所在地偏鄉弱勢，如經濟弱勢家庭、兒少、身心障礙等，期能透過公益捐贈活動支援並改善其生活及教育條件，另經由志工服務落實營運所在地環境保護的具體行動方案，期能協助解決營運所在地社區之社會/環境問題並促進社區發展。</p>		
114年度台灣區投入社會公益活動資源如下：			
捐贈活動		受贈單位	金額 / 數量
塭內社區生態遊程開發及智慧實驗農場計畫		苗栗竹南塭內社區	NT\$910,000
《台灣超人》公益放映計畫		台灣產業創生平台	NT\$150,000
派歐尼(Pioneer)秧苗計畫-2025年公益科普營		愛惜社區推展協會	NT\$550,000
2025 全國智慧製造大數據分析競賽		教育部	NT\$1,500,000
丹娜絲/樺加沙(花蓮)風災修繕		天主教中華聖母基金會	NT\$271,600
懸吊式移位系統改善計畫		創世基金會苗栗分院	NT\$227,600
獨木舟雙體帆船的學習與製作		孩子的書屋	NT\$103,400
中秋節愛心募集行動		財團法人私立天主教華光智能發展中心、財團法人新竹縣天主教世光教養院、財團	NT\$79,000

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
2025 冬暖慈幼園遊會捐款	法人台灣省私立香園紀念教養院 新竹家扶中心		NT\$15,000
2025 友善地球淨灘活動	苗栗縣龍鳳漁港		共號召 116 人參與，共清除約 200 公斤垃圾
員工捐血活動	新竹捐血中心		參與員工共 187 人次，合計共捐血 81,000c.c.

本公司海外廠區亦積極投入社會關懷活動，展現企業的社會責任：

- 美國廠區一社區關懷與慈善捐贈活動
GlobiTech Incorporated、GlobalWafers America, LLC 長期關注在地社區需求，並透過多元公益行動回饋社會。114 年，各廠區員工與各地的慈善機構合作，捐贈罐頭食品，並參與每週及感恩節期間的食物發放服務，協助將物資送達有需要的家庭，以實際行動支持社區糧食安全。另外，員工也一同募集兒童玩具與生活用品，為弱勢兒童準備節慶禮物，讓更多家庭在節日期間感受到關懷與溫暖。這些舉措不僅展現企業關懷社會的價值，也深化與在地社區的合作與連結。
- 中國廠區一慈善捐贈活動
昆山中長矽晶有限公司於每年春、秋兩季定期前往昆山市福利院進行關懷與捐贈活動。公司捐贈衣物及食品等生活物資，為院內無依兒童提供實質支持，並傳遞溫暖與關懷。
- 馬來西亞廠區一員工關懷與團隊交流活動
MEMC Electronic Materials Sdn. Bhd. 藉由多元活動關懷員工及其家庭，營造溫暖且互助的職場氛圍。114 年，公司提供員工子女文具補助，支持孩子們的學習需求，並安排流感疫苗接種計畫，守護員工們的健康，提升工作環境的安心感。廠區亦舉辦 Hari Raya 節慶聚會，讓員工在充滿歡樂的氛圍中交流互動、增進情誼。隨著新廠區啟用，員工也共同參與志願活動，為新環境的建立與完善付出心力。這些行動展現了企業對員工及家庭的支持，進一步打造充滿活力與關懷的工作環境。
- 韓國廠區一志工服務與物資捐贈活動
MEMC Korea Company 員工前往在地社福機構參與環境清潔志工活動，協助維護院內環境整潔，並捐贈嬰幼兒益生菌、洗衣精及嬰兒濕紙巾等生活必需品，提供機構日常照護所需資源，透過志工服務與物資捐贈，展現企業的社會責任。
- 日本廠區一公益捐血與環境維護活動
GlobalWafers Japan Co., Ltd. 透過公益行動與在地社區建立良好連結。114 年共舉辦 7 次員工捐血活動，累計 138 名員工熱情響應捐血，為醫療體系提供穩定的用血支持。另外，廠區積極配合當地鎮政府的環境清潔計畫。每年兩次與社區共同進行周邊環境整理，員工們齊心撿拾

評估項目	運作情形		與上市櫃公司永續發展實守則差異情形及原因
	是	否	
<p>散落在道路與公共空間的垃圾。透過這些實際行動，除了提升廠區周邊環境的整潔度，更讓員工在參與過程中凝聚向心力，與社區一同為更宜居的生活環境努力。</p> <p>● 義大利廠區－慈善與社會參與活動</p> <p>MEMC Electronic Materials S.P.A.長期投入社會關懷、教育文化與環境保護等面向。114年，廠區捐款支持多個社會福利機構，並資助長者及病患交通服務計畫，協助提升行動不便族群的生活便利性。此外，廠區參與結合科學、道路安全與運動議題的公共講座，促進社區交流與知識推廣；同時執行Novara市政府推動的城市生物多樣性計畫，透過維護綠地自然生長，支持授粉昆蟲與城市生態的健康發展。員工也積極參與多項社區活動，包括企業路跑與足球友誼賽，活動報名費全數捐贈予協助無家可歸者的慈善機構；在節慶期間，廠區亦透過捐贈蛋糕點支持在地公益組織。透過持續推動多元公益行動，企業與社區建立穩固連結。114年度義大利廠區慈善捐贈金額合計約34,695歐元。</p> <p>3.消費者權益：公司內部訂有「客戶訴願管理流程」，提供客戶訴願管道，並與客戶簽訂有供貨合約，品質合約等，對客戶權益有完善保障。</p> <p>4.人權方面：本公司長期致力推動職場平權，不論其種族、性別、年齡皆享有同等的工作權利，提供個人自由表達和發展的機會，以達到尊重個人尊嚴。</p> <p>5.安全衛生：本公司以零災害為目標，致力於安全衛生政策之推動並持續改善製程及作業環境，經由全體員工的共同努力，不斷提升職業安全衛生績效。</p> <p>6.員工健康關懷：本公司定期為員工實施健康檢查，讓員工了解自身健康狀況，進而愛護與強化自己的健康。在工作場所中，為掌握員工工作環境實態並評估危害因子暴露狀況，除了在適當地點設置測警報設備外，也定期實施作業環境檢測，以作為職場環境改善的依據。</p> <p>7.人力資本發展：本公司透過完善的績效獎勵連結制度、培育在學專業人才、補助在職員工進修、關鍵人才留任等制度，識別、培育並獎勵人才，以達到長期留任的效果，除此之外也透過員工福利儲蓄信託、頒發久任獎牌表揚資深員工等，提升人才久任意願。</p> <p>(1)產學合作：本公司與學術單位進行產學合作、策略聯盟，透過合作研究項目進行專業知識和技術的交流，彼此互補優勢，共同解決產品開發過程的技術問題，於持續提升公司研發人員的專業技能之外，亦同時培養學術界高素質人才，推動科技創新和產業發展。114年持續進行合作計畫有12件，合作院校有清華大學、陽明交通大學、中央大學、台灣科技大學等。</p> <p>(2)人才培育：本公司與清華大學心理諮商系合作，分享國際人力資源管理經驗及面試技巧，幫助學生了解職場趨勢，提升實務能力，促進學術與業界交流，為未來職場培養更多優秀人才。</p> <p>(3)大專院校實習生：本公司自106年起與大專院校合作，迄今已成功培育68名以上在學生於畢業前至企業累積經驗，提供其專業技能培訓及實際應對實務場域能力，這些學生分別來自清華大學、中央大學、陽明交通大學、臺灣科技大學、雲林科技大學、Nagaoka University of Technology等多所大專院校，並專精於電子、工業工程、機械、心理諮商...等相關領域，分別安排至研發、製程、製造、其他支援部門實習，為實習生提供寶貴的學習和成長機會，有助於順利踏入職業生涯的起點。</p>	摘要說明		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明	
		<p>(4)碩博士獎學金：訂有「碩博士獎學金申請辦法」，持續資助相關領域的專業人才獎學金，並於畢業後直接進入公司就業。</p> <p>(5)在職進修補助：訂有「在職進修補助辦法」，全額補助績效優良且具進修意願員工在職進修，以鼓勵員工發展個人職涯。</p> <p>(6)關鍵人才留任：針對具備策略規劃能力的管理人員或於自身專業有不可替代性者簽署重要幹部合約，以達到人才留任的目的，確保本公司人力資本永續發展。</p> <p>(7)研究員計畫：本公司在集團內推動研究員計畫 (Fellow Program)，旨在發掘並培養專業領域中的優秀人才，所有提名者必須經過委員會的嚴格選拔，確保選出最具潛力與專業能力的員工，至今已有一百九十三名優秀員工通過此計畫，獲得認可並在公司內部發揮重要影響力。此計畫不僅促進了員工的專業成長，也進一步強化了公司在技術創新與人才發展方面的競爭力。</p> <p>8. 員工健康與安全關懷：隨著後疫情時代的來臨，全球工作與生活方式發生了重大變化，雖然許多防疫措施已經逐步放寬，部分改變將成為永久性的，例如提高洗手頻率和保持個人衛生習慣等，以降低疾病傳播風險。本公司將持續推動多元健康關懷措施，保障員工的安全，並積極發揮企業的正向影響力，營造健康、安全的工作環境。</p> <p>(1)健康資訊分享：為確保員工能夠即時獲得正確的健康管理資訊，本公司健康管理中心定期彙整國內外健康資訊，並依據最新資訊動態更新相關措施，使員工能快速掌握有效的健康保護資訊。</p> <p>(2)身心健康關懷：本公司定期關懷員工的身體狀況，特別是有健康異常症狀的員工，並提供適當的支持與追蹤，幫助員工維持身體健康。</p> <p>(3)工作環境衛生管理：本公司制定清潔與消毒標準，定期清潔公共區域並調整消毒頻率，此外，於公共區域備有消毒液，並在洗手間張貼正確洗手指導，以確保員工在安全、清潔的環境中工作。</p> <p>(4)身心平衡支持：為了關注員工的身心狀況，並促進員工的心理健康，本公司於110年導入員工協助方案 (EAPC)，每年提供每位員工兩次免費的心理諮詢服務，並定期發送心理健康相關資訊，幫助員工管理壓力與情緒，維持良好的身心平衡。</p>	

(七) 上市上櫃公司氣候相關資訊：

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p> <p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>本公司已訂定「風險管理政策與程序」，董事會為本公司風險管理最高治理單位，並由審計委員會協助督導風險管理相關事項。關於氣候變遷議題，董事會負責督導本公司氣候相關風險與機會的發展策略、短中長期目標與整體管理作為，並提供建言與反饋。另考量氣候變遷議題之重要性與特殊性，董事會並每季督導公司關於氣候變遷議題因應策略以及關鍵環境指標績效與目標達成狀況等相關事務。董事會除了將氣候議題納入公司治理與經營策略的考量，更將氣候風險與機會管理融入整體政策之中，透過持續監督各項風險管理機制的執行，期許在業務持續成長的同時，也能落實氣候變遷相關管理作為，展現本公司對於氣候治理的重視。</p> <p>本公司定義氣候風險與機會影響時間短期為1-3年、中期為3-10年、長期為10年以上，蒐集相關氣候風險與機會資訊，辨識出與環球晶圓相關的氣候風險與機會，並聚焦風險機會值較高的3項氣候風險與3項氣候機會，據以評估各項風險與機會對公司的潛在財務衝擊，分別擬定應對策略及措施，相關資訊摘要如下，詳細評估分析資訊請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.1氣候策略與行動」。</p> <p>氣候風險與機會辨識如下：</p> <table border="1" data-bbox="853 197 1311 1496"> <thead> <tr> <th>類別</th> <th>短期 (1-3年)</th> <th>中期 (3-10年)</th> <th>長期 (10年以上)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>實體風險</td> <td>淹水(暴雨)、土石流、坡地災害、低溫、閃電、颱風、強風、乾旱(少雨)</td> <td>無</td> <td>高溫、海平面上升</td> </tr> <tr> <td>轉型風險</td> <td>碳稅/碳費、燃料稅/能源稅、總量管制交易與排放交易、強制申報、產品標示法規與標準、再生能源法規、一般環境法規、國際公約/協議、自願性倡議、低碳產品/服務需求、利害關係人的關注與負面回饋日益增加</td> <td>新技術投資、低碳技術轉型、市場訊息不確定性</td> <td>法律訴訟、顧客偏好改變</td> </tr> <tr> <td>機會</td> <td>採用更高效率的運輸方式、使用更高效率的生產和配銷流程、回收再利用、減少用水量、使用低碳能源、採用獎勵性政策、參與碳交易市場、客戶偏好轉變</td> <td>業務活動多元化</td> <td>轉用更高效的建築物</td> </tr> </tbody> </table>	類別	短期 (1-3年)	中期 (3-10年)	長期 (10年以上)	實體風險	淹水(暴雨)、土石流、坡地災害、低溫、閃電、颱風、強風、乾旱(少雨)	無	高溫、海平面上升	轉型風險	碳稅/碳費、燃料稅/能源稅、總量管制交易與排放交易、強制申報、產品標示法規與標準、再生能源法規、一般環境法規、國際公約/協議、自願性倡議、低碳產品/服務需求、利害關係人的關注與負面回饋日益增加	新技術投資、低碳技術轉型、市場訊息不確定性	法律訴訟、顧客偏好改變	機會	採用更高效率的運輸方式、使用更高效率的生產和配銷流程、回收再利用、減少用水量、使用低碳能源、採用獎勵性政策、參與碳交易市場、客戶偏好轉變	業務活動多元化	轉用更高效的建築物
類別	短期 (1-3年)	中期 (3-10年)	長期 (10年以上)														
實體風險	淹水(暴雨)、土石流、坡地災害、低溫、閃電、颱風、強風、乾旱(少雨)	無	高溫、海平面上升														
轉型風險	碳稅/碳費、燃料稅/能源稅、總量管制交易與排放交易、強制申報、產品標示法規與標準、再生能源法規、一般環境法規、國際公約/協議、自願性倡議、低碳產品/服務需求、利害關係人的關注與負面回饋日益增加	新技術投資、低碳技術轉型、市場訊息不確定性	法律訴訟、顧客偏好改變														
機會	採用更高效率的運輸方式、使用更高效率的生產和配銷流程、回收再利用、減少用水量、使用低碳能源、採用獎勵性政策、參與碳交易市場、客戶偏好轉變	業務活動多元化	轉用更高效的建築物														

項目

執行情形

聚焦氣候風險與機會摘要如下：

氣候風險

風險項目	影響時間	潛在財務衝擊	應對策略及措施
再生能源法規	短期	<ul style="list-style-type: none"> ● 2025 年度本公司 1 處台灣廠區因應《再生能源發展條例》規定，須於 2025 年底前設置再生能源設備至少達契約容量 10%，該廠區於 2025 年度投入設置太陽能光電面板及相關設施，資本支出金額為新台幣 2,316.6 萬元；另其 2025 年度購置再生能源電力加計輸配費用金額為新台幣 1,538.3 萬元。 ● 持續推動多項應對再生能源法規之措施，包括在多棟廠房與場域屋頂建置太陽能系統、擴增裝置容量、簽訂購電協議購買再生能源等，因而產生資本支出，致現金流出。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 透過自建太陽能電廠、簽訂綠電購電協議與購買再生能源憑證，輔以集團再生能源藍圖規劃，分階段達成再生能源使用目標。 ● 搭配溫室氣體減量策略，降低生產過程碳排放量與產品單位碳排放量，減少碳費與傳統能源相關費用支出，降低法規遵循風險，同時增加客戶採購意願。
低碳產品/服務需求	短期	<ul style="list-style-type: none"> ● 2025 年度本公司未有因市場低碳產品需求而造成生產訂單下滑的財務影響。 ● 因應市場與客戶需求，投入研發成本、輔導及系統導入費用，以及進行產品碳足跡盤查規畫，造成營運成本與相關費用增加，惟相關估計值之計算涉及商業敏感資訊，故無法提供量化資訊。 ● 開發的低碳產品因符合客戶需求，預期導致營業收入增加，進而影響營業損益及淨利，惟相關估計 	<ul style="list-style-type: none"> ● 持續投入研發資源，開發可應用於電動車 (EV)、電力系統、風力發電及太陽能發電等領域之關鍵產品，並支援提升電網運作效率與能源轉換效能。此外，開發終端應用所需的低耗能先進製程晶圓，以因應低碳產品的需求。另擬定溫室氣體減量策略，透過製程改善，降低生產過程碳排放量與產品碳足跡(例如加速晶熱場對低碳製術的開發)，以符合市場對低碳製

項目	執行情形			
			<p>值之計量及商業敏感資訊，故無法提供量化的資訊。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2025 年度本公司未有因乾旱缺水而造成停工之損失情形，故無直接財務影響。 ● 氣候異常造成旱災，生產可能受影響而導致財務損失、營收下降，以及用水成本提高。 ● 設置多項製程用水優化與廢水回收技術，包括研廢水回收、再生水再利用等節水與回收水裝置，產生資本支出，致現金流出。 	<p>造產品的需求。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 適時調配用水系統，推動各廠區節水措施，以及增加冷卻水回收與雨水回收設施，提升廠內製程廢水回收率，降低用水相關支出 ● 評估製廠區早災風險，研擬與執行風險減緩措施(如租用水車載水)。
乾旱		短期		
氣候機會	使用更高效的生產和配銷流程	短期	<p>潛在財務影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 開發新製程與製程改善，並推動多項節能、節水方案，短期可能產生資本支出，惟有助於中長期提升生產流程能源使用效率，降低能源使用成本，減少現金流出。 ● 集團各生產據點導入 ISO50001 能源管理系統，短期內將反映認證之費用及相關人力成本，對營運成本結構產生影響，惟中長期將有助於能源管理制優化與持續改善能源使用效率，強化成本控制能力與營運韌性。 ● 透過優化物料計劃與供應配置，並可就近供應客戶的在地供應模式為核心，使公司可降低與庫存相關之營運波動風險，減少跨區運輸 	<p>應對策略及措施</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 持續推動各項節水/節能措施，如長晶熱場設計開發、回收水系統，提升生產效率、降低用水與用電等成本，並評估採用高效率原料，減少生產成本。 ● 強化物料計劃與供應配置管理，同時持續發展可就近供應客戶的在地供應模式，並彈性調整貨源分配與物流安排，以提升交付彈性並降低跨區運輸相關的不確定性。

項目		執行情形		
		成本結構穩定性與整體營運韌性。		
減少用水量	短期	<ul style="list-style-type: none"> 透過設置節水設備減少外部取水及耗水，降低長期營運成本並提升水資源自給率，降低購買水資源費用。 	<ul style="list-style-type: none"> 「減少用水量」之應對策略及措施請參見上表第3項「氣候風險／乾旱／應對策略及措施」之說明。 	
使用低碳能源	短期	<ul style="list-style-type: none"> 因建置再生能源設備，降低外購電力，可減少購買非再生能源（灰電）之支出，降低現金流出。 提升低碳能源使用比例，可降低單位產品碳排放，有機會優先取得國際大廠供應鏈資格，擴大營收，惟相關估計值之計算涉及多項會隨當時情境不同之變因，故僅以質性說明。 	<ul style="list-style-type: none"> 「使用低碳能源」之應對策略與措施，請參見上表第1項「氣候風險／再生能源法規／應對策略及措施」之說明。 	
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>針對極端氣候事件及轉型行動對財務之影響，說明如下：</p> <p>1.極端氣候事件：長期性實體風險如高溫，可能造成成用電量上升，進一步造成營運成本增加；立即性實體風險如颱風、淹水（暴雨），可能造成電力供給問題，亦有停班及影響生產等風險導致相關損失，並衍生費用支出增加、營收下降等財務影響。</p> <p>2.轉型行動：依不同氣候轉型情境，可能衍生的政策、法規、市場轉變、商譽等轉型風險，包含徵收碳稅/碳費、節能政策或法規趨嚴、枯水期徵收耗水費、低碳創新產品與技術生產之開發成本增加等，對財務的影響主要為費用支出增加。</p>		
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	<p>本公司持續注重氣候變遷因應與管控，透過定期的風險辨識、衡量、監控、報告到回應等風險管理程序，將氣候變遷議題納入公司整體風險管理中。為落實風險管理機制，本公司企業永續發展委員會每年定期（至少一年一次）向董事會及審計委員會（由4位獨立董事組成）報告與公司營運相關之環境、社會、公司治理之重大議題及風險項目相關因應策略、管理運作與執行情形。另考量氣候變遷議題之重要性與特殊性，企業永續發展委員會每季另向董事會報告環境指標績效與目標、氣候變遷議題因應與管控等相關事務。</p>		

項目	執行情形
<p>5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>本公司依據TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) 架構及參考國際能源總署 (International Energy Agency, IEA) 及聯合國政府間氣候變化專門委員會 (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 發布的最新科學評估報告建立氣候情境分析。</p> <p>實體風險考量IPCC於AR6的SSP5-8.5 (極高排放情境)，此情境假設全球經濟的快速增長主要依賴於化石燃料的開發和高能源密集型產業，且幾乎沒有任何氣候政策加以管控。本公司為能因應未來的氣候變化，採用SSP5-8.5 (極高排放情境) 來推估未來降雨及高溫等氣候災害之情形，以進行實體風險之財務衝擊分析。</p> <p>轉型風險則參考IEA的2050淨零排放情境 (NZE)，考量全球氣候政策與承諾現況及未來趨勢，致力控制升溫於1.5°C內已蔚為國際共識，故採用2050年淨零排放情境 (NZE) 進行轉型風險之財務衝擊分析。</p> <p>本公司綜合考量上述情境所鑑別出之實體及轉型風險結果及其對財務影響，詳如上揭項目2之說明。上述詳細資訊請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境/4.1氣候策略與行動」。</p>
<p>6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>本公司已訂定「單位電力耗用量」及「絕對溫室氣體 (範疇一和二) 排放量」(2025年起從單位強度目標調整為絕對減量目標) 之短中長期減量目標，目標涵蓋範圍為本公司所有營運據點。「單位電力耗用量」以2019年為基準年，短期目標 (1-3年) 較基準年度減量1-3%，中期目標 (3-10年) 較基準年度減量3-10%，至2030年應較基準年度減量10%，長期目標 (10年以上) 較基準年度減量大於10%；「絕對溫室氣體 (範疇一和二) 排放量」則對標科學基礎減碳倡議 (SBTi) 的目標規劃，以2022年為基準年，短期目標 (1-3年) 較基準年度減量1-3%，中期目標 (3-10年) 較基準年度減量3-8%，至2030年應較基準年度減量8%，長期目標 (10年以上) 預計於2050年前實現涵蓋全價值鏈的溫室氣體淨零排放。</p> <p>再生能源方面，本公司於2021年率先承諾將逐步在全球營運據點實現2050年100%使用再生能源，並於2022年正式加入RE100倡議。為展現公司永續經營決心，環球晶圓於2025年提出更積極的再生能源目標，宣布將原訂2050年達成100%使用再生能源的時程，提前10年調整至2040年。另輔以氣候藍圖的分階段規劃，以減少發電過程所產生的碳排放量，強化永續競爭性。</p> <p>環球晶圓秉持「負責任的成長」理念，加入科學基礎減量目標倡議 (Science Based Targets initiative, SBTi)，將依循母公司中美矽晶通過審查的科學基礎減量目標，以2022年為基準年，於2035年將範疇一與範疇二的溫室氣體排放量減少63%；範疇三則以2024年為基準年，於2035年達成將涵蓋「採購商品與服務」、「資本財」及「燃料與能源相關活動」之溫室氣體排放量減少37.5%的絕對減量目標。另</p>

項目	執行情形
<p>7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>外，環球晶圓已於2025年正式承諾以科學為基礎的減碳目標，預計將送出獨立於中美矽晶的承諾目標，規劃於2026年上半年通過SBTi官方審查。</p> <p>為推動低碳投資、提升能源使用效率，並激勵內部減碳行動，本公司於2024年起正式導入內部碳價格制度，用以評估溫室氣體排放的成本，並展現本集團對於未來碳排放法規趨嚴格之預先因應措施。環球晶圓內部碳定價機制係採用以集團總部統一核定費率的影子價格模型，依據各廠範疇一及範疇二的碳排放量徵收內部碳費。本集團之碳定價政策綜合考量國內外碳費趨勢與半導體產業所訂定的內部碳價格，並同步參考歐盟 CBAM（碳邊境調整機制）的憑證價格，輔以本集團設置的價格模型，逐年調整徵收費率，2025年本集團以每噸碳排放13.5歐元作為內部碳價格基礎，未來將提高內部碳定價之金額，以更有效追蹤和管理各工廠的碳排放狀況、分析碳排放熱點，實現公司RE100計畫與減碳目標。</p>
<p>8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵消或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵消之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	<p>本公司已訂定「單位電力耗用量」及「絕對溫室氣體（範疇一和二）排放量」（2025年起從單位強度目標調整為絕對減量目標）之短中長期減量目標，目標涵蓋範圍為本公司所有營運據點。「單位電力耗用減量」以2019年為基準年，短期目標（1-3年）較基準年度減量1-3%，中期目標（3-10年）較基準年度減量3-10%，至2030年應較基準年度減量10%，長期目標（10年以上）較基準年度減量大於10%；「絕對溫室氣體（範疇一和二）排放量」則對標科學基礎減碳倡議的目標規劃，以2022年為基準年，短期目標（1-3年）較基準年度減量1-3%，中期目標（3-10年）較基準年度減量3-8%，至2030年應較基準年度減量8%，長期目標（10年以上）預計於2050年前實現涵蓋全價值鏈的溫室氣體淨零排放。環球晶圓另外依循母公司中美矽晶通過審查的科學基礎減量目標，以2022年為基準年，於2035年將範疇一與範疇二的溫室氣體排放量減少63%；範疇三則以2024年為基準年，於2035年達成將涵蓋「採購商品與服務」、「資本財」及「燃料與能源相關活動」之溫室氣體排放量減少37.5%的絕對減量目標。</p> <p>本公司減碳行動包括範疇一、範疇二和範疇三的排放量，目標涵蓋所有營運據點的營運活動，透過提高使用再生能源（配合當地政府法規和本公司再生能源能源規劃路徑）、落實能源使用效率提升及低碳技術轉型（廠務設施、製程優化、再設計等節能方案）等作為，以達成範疇一和範疇二的相關減量目標；範疇三減碳策略則鎖定來自上游價值鏈的排放，依照採購原物料造成的碳排放量將供應商分成三種等級，以落實供應商的產品碳足跡盤查(ISO14067)覆蓋率，持續追蹤供應商提出的減碳路徑計畫，並且邀請大宗碳排放原物料供應商或排放源共同響應科學基礎減量目標倡議 (SBTi)，以達成範疇三的減量。另外由於本公司的營運據點涵蓋實施不同制度的國家或地區，包含電證合一和電證分離兩種型態，且取得再生能源或能源屬性的管道較為多元，2025年本公司再生能源能源耗用情形如下所述：</p>

項 目	執行情形
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。	<p>(1) 台灣據點 (採電證合一制度)：取得再生能源憑證數量2,716張、再生能源耗用量共計3,038,746度，能源種類皆屬於太陽能，取得方式分別為自外部購買以及廠區自有的案場自發自用。</p> <p>(2) 國外據點 (採電證分離制度)：再生能源耗用量共計100,997,300度，包含(a)電證分離憑證80,734,586度，再生能源種類包含太陽能、風能或多種再生能源混合型等；(b)外購水力耗用量12,659,760度，為日本據點所耗用；(c)廠區自有的太陽能案場自發自用，再生能源耗用量7,602,954度，包括丹麥廠地面型太陽能案場、日本宇都宮屋頂型太陽能案場、日本新潟屋頂型太陽能案場，以及韓國天安廠屋頂型太陽能案場。</p> <p>本公司歷年再生能源憑證數量以及氣候目標「單位電力耗用量」及「絕對溫室氣體 (範疇一和二) 排放量」歷年達成進度等詳細資訊請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境/4.1氣候策略與行動」。</p> <p>溫室氣體盤查及確信情形如下表1-1。</p> <p>溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫如下表1-2。</p>

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。			
範疇一 (涵蓋範圍)	年度	總排放量(公噸 CO2e)	密集度(公噸 CO2e/百萬元)
環球晶圓股份有限公司(母公司)	2024 年(查證)	2,447.1313	0.0884
	2025 年(查證)	2,582.1562	0.1016
範疇二 (涵蓋範圍)	年度	總排放量(公噸 CO2e)	密集度(公噸 CO2e/百萬元)
	2024 年(查證)	156,074.0930	5.6380
環球晶圓股份有限公司(母公司)	2025 年(查證)	136,559.2068	5.3754

註 1：2024-2025 年資料涵蓋範圍包括總公司新竹廠、竹南廠、竹南二廠以及中德分公司。
 註 2：2024 年度及 2025 年度環球晶圓母公司營業收入分別為新台幣 27,682,470 千元及新台幣 25,404,393 千元。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。				
年度	確信範圍	確信機構	確信準則	確信意見
2024	環球晶圓股份有限公司(母公司) - 總公司新竹廠及竹南廠	立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)	ISO 14064-3: 2019	範疇一及範疇二： 合理保證等級
	環球晶圓股份有限公司(母公司) - 總公司竹南二廠	艾法諾國際股份有限公司(AFNOR)	ISO 14064-3: 2019	範疇一及範疇二： 合理保證等級
	環球晶圓股份有限公司(母公司) - 中德分公司	英商勞盛股份有限公司台灣分公司(LRQA)	ISO 14064-3: 2019	範疇一及範疇二： 合理保證等級
2025	環球晶圓股份有限公司(母公司) - 總公司新竹廠、竹南廠、竹南二廠	艾法諾國際股份有限公司(AFNOR)	ISO 14064-3: 2019	範疇一及範疇二： 合理保證等級
	環球晶圓股份有限公司(母公司) - 中德分公司	英商勞盛股份有限公司台灣分公司(LRQA)	ISO 14064-3: 2019	範疇一及範疇二： 合理保證等級

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

1. 減量基準年及其數據：對標科學基礎減碳倡議 (SBTi) 的近期目標，環球晶圓以 2022 年作為溫室氣體排放減量基準年 (範疇一和範疇二共計 576,396.79 公噸 CO₂e)，因本公司半導體材料製造產業的特性，組織邊界內的溫室氣體排放熱點為範疇二，其約佔基準年 95% 的範疇一及範疇二排放量，故環球晶圓對於溫室氣體排放減量主要的策略與行動著眼於能源耗用的減量。
2. 減量目標：「絕對溫室氣體 (範疇一和二) 排放量」對標科學基礎減碳倡議 (SBTi) 的目標規劃，以 2022 年為基準年，短期階段 (1-3 年) 目標較基準年度減量 1-3%，中期階段 (3-10 年) 較基準年度減量 3-8%，至 2030 年應較基準年度減量 8%，長期階段 (10 年以上) 較基準年度減量大於 8%。
3. 減量策略：環球晶圓為了回應氣候議題，制定適用所有營運據點的溫室氣體管理政策、分階段性導入再生能源的目標、以及循環經濟 4R 策略，透過響應國際倡議承諾、訂定減量目標與各項行動措施，持續推動減少溫室氣體排放量；為了達成設定的溫室氣體減量與承諾願景，本公司擬定減量策略與對應的行動方案如下所列：
 - (1) 採用再生能源：以自建持有的太陽能發電系統 (包含：地面型和屋頂型兩種型態案場)、購買外部再生能源 (例如：簽署長期購電合約、採用水力發電)、購買再生能源憑證 (RECs 或者其他相同於 I-REC 的再生能源憑證制度、非石化燃料憑證)，透過內外部兩種管道併行持續提升再生能源之使用比例。本公司於 2025 年度再生能源使用比例約 7.83%^{註 1} (RE100 的達成比例為 9.04%^{註 2})。
 - (2) 提升能源使用效率：透過設備改良、再設計、汰換老舊能效較差的設備等，進而降低設備運作時耗用之能源 (例如：導入汽電共生系統、汰換 COP 值較低的冰水主機、天然氣鍋爐改以熱泵鍋爐取代、長晶爐機台製程再設計等)。
 - (3) 上游價值鏈分級管理：依照採購原物料造成的碳排放量將供應商分成三種等級，用以落實供應商的產品碳足跡第三方盤查，將溫室氣體的減量規劃與實施進度納入採購評分準則；並且持續追蹤供應商提出的減碳路徑計畫，邀請大宗碳排放量供應商共同響應科學基礎減量目標倡議 (SBTi)，以達成範疇三的減量。
 - (4) 購買碳補償商品：透過購買自願性碳權來達成自願性的階段性產品碳中和，與在符合 SBTi 指引準則下抵銷剩餘溫室氣體排放量以達成 2050 年淨零排放的承諾。
 - (5) 支持清除與碳捕捉：支持推展植樹造林的自然碳捕捉與人為碳捕捉計畫，同時參與其他自然解決方案及自然保護計畫。

註 1：再生能源使用比率=再生能源(GJ)/ 總使用能源(GJ)。

註 2：RE100 達成比例=再生能源耗用量(MWh) / 總電力耗用量(MWh)。

4. 具體行動計畫：

- (1)更積極的再生能源承諾：環球晶圓於2021年先行自主宣示將於2050年達成100%使用再生能源的目標，後於2022年加入RE100倡議組織成為正式企業成員，面對全球氣候變遷的挑戰，環球晶圓於2025年6月主動將RE100目標時程大幅提前10年，與此同時更積極地調整階段目標，將全集團再生能源使用比例各階段里程碑從2030年20%、2035年35%、2040年50%、2050年100%予以更新為2030年35%、2035年55%，並且於2040年全集團100%使用再生能源。
 - (2)科學基礎減量倡議 (SBTi)：環球晶圓依循母公司中美矽晶通過審查之科學基礎減量目標，以2022年為基準年，於2035年將範疇一與範疇二的溫室氣體排放量減少63%；範疇三則以2024年為基準年，於2035年達成將涵蓋「採購商品與服務」、「資本財」及「燃料與能源相關活動」之溫室氣體排放量減少37.5%的絕對減量目標。為了展現更積極的減碳決心，環球晶圓2025年在原先科學基礎減碳的近期目標設定外，另擬定長期目標與淨零承諾，並規劃於官方審查通過後公布及依循更新減碳目標。
 - (3)能源轉型與溫室氣體排放減量：環球晶圓為有效管理氣候變遷相關風險與機會對公司之衝擊，以實際行動支持淨零轉型，透過提升能源使用效率、低碳技術轉型（優化設施及製程之節能行動計畫）並搭配簽訂購電協議（Power Purchase Agreement, PPA）、購買再生能源憑證（Renewable Energy Certificates, RECs）、與上游價值鏈議合共同採購再生能源等策略，擬逐步達成氣候藍圖規劃之階段性目標，最終實踐全集團絕對溫室氣體（範疇一和二）排放量的減量目標。
 - (4)上游大宗供應商的碳足跡證覆蓋率：範疇三減碳策略鎖定來自上游價值鏈的排放，其中能源上游排放與再生能源的使用比例將成正相關的關係，故減量重點將放在「採購原物料和資本財上」，依照其對於公司營運邊界造成的排放量與影響程度，將供應商分成三種等級，用以分級與落實供應商的產品碳足跡盤查（ISO14067）覆蓋率，持續追蹤供應商提出的減碳路徑計畫。
5. 減量目標達成情形：歷年達成情形等詳細數據資訊請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.1 氣候策略與行動」。

(八) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>否</p>	<p>(一) 本公司訂有經董事會通過、詳載誠信經營政策具體內容之「誠信經營守則」及「道德行為指南」，並訂有經董事長通過之「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」以求誠信經營政策之具體實踐。本公司制式契約對外文件悉已要求交易相對人遵守誠信經營政策；董事會及高階管理階層均簽署書面聲明，積極落實誠信經營政策之承諾，公司於內部管理及商業活動中亦確實執行，包含於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。相關政策請參閱本公司網站「投資人專區>公司治理>公司內部規章」(https://www.sas-globalwafers.com/corporate/)。</p> <p>(二) 本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」中針對「誠信經營守則」第七條第二項列舉不誠信行為，訂定風險評估機制，包含：藉由年度部門應遵循之相關法令檢視表、質性訪談、資訊單位電子郵件追蹤…等控管方法蒐集資料，定期分析評估、辨識具較高風險者，並於必要時執行個案調查，並輔以內部稽核單位的查核機制，據以訂定防範行賄及收賄、提供非法政治獻金或不當利益、侵害智慧財產權、不公平競爭…等不誠信行為方案，確保公司經營符合誠信經營守則。本公司各單位人員於營業活動範圍內，對前揭不誠信行為控管方法均有配合法令遵循單位調查之義務。</p> <p>(三) 本公司依「誠信經營守則」所訂防範不誠信行為方案包含「道德行為指南」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」；其等明確規範不得收受任何不正當利益，或作出違反誠信、不法等行為，並鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為，另規</p>
			無重大差異

評 估 項 目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明 定定期向董事及員工宣導誠信行為之重要性。前揭方案之依據不誠信行為為風險之評估機制所訂方式，定期檢討防範方案之妥適性與有效性，並進行適當調整或修正。114年依據外部專家建議，對「檢舉非法與不誠信行為案件之處理辦法」完成第五次改版，優化措施包含：(1)整合一個獨立可信賴之舉報案件統籌單位（法務單位），各權責單位接獲檢舉時，應統一通報法務單位；(2)新增「通報獨立董事」程序，使獨立董事得即時同步掌握舉報案件狀況及監督後續處理情形，進一步強化吹哨人機制；(3)新增處理人員利益衝突迴避原則。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V V V V V		無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，明確規範不得收受任何不正當利益，或作出違反誠信、不法等行為；上述內部規章並由法令遵循參考外部規範之變動及內部監督執行情形，不定期檢討並調整、修正。114年依據外部專家建議，對「檢舉非法與不誠信行為案件之處理辦法」完成第五次改版，優化措施包含：(a)整合一個獨立可信賴之舉報案件統籌單位（法務單位），各權責單位接獲檢舉時，應統一通報法務單位；(b)新增「通報獨立董事」程序，使獨立董事得即時同步掌握舉報案件狀況及監督後續處理情形，進一步強化吹哨人機制；(c)新增處理人員利益衝突迴避原則。</p> <p>(2)對內與對外政策宣導</p> <p>本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」等相關重要內規已公告於公司網站及內部網站供外界與公司同仁隨時查詢；另本公司要求供應商簽署遵循法令、道德、環境及品質規範之「供應商行為準則暨供應商承諾書」，且與商業往來交易對象簽訂之制式契約內容亦已包含遵守誠信經營行為之相關條款。</p> <p>(3)檢舉管道、處置與檢舉人保護</p> <p>本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，建立違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並於公司廠房與內、外部網站設置並公告員工意見箱、電子信箱及申訴專線，以鼓勵公司內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為。本公司允許匿名檢舉，對於檢舉人身分及檢舉內容會確實保密，由人資單位負責查證與處理；如有違反誠信經營規定者，將視情節輕重予以適當處置，必要時應向主管機關報</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>告或移送司法機關偵辦。</p> <p>(4)教育訓練 本公司定期擬訂並實施教育訓練，114年度授課對象及時數列舉如下：</p> <p>1. 對董事、部級以上主管及新進員工實施1小時「防範內線交易教育訓練」；內容包含內線交易法令解析（構成要件、重大消息公開方式及時點、司法見解）及內部人股權異動法令解析（事前／事後申報義務、董監持股成數維持），參與人次計213人。</p> <p>2. 對董事、部級以上主管及新進員工實施2小時「誠信經營教育訓練」；內容包含營業秘密保護、競爭法、反貪腐、防範利益衝突、出口管制及吹哨者舉報管道使用宣導...等，與科技產業密切相關之重大法令遵循議題，參與人次計214人。</p> <p>(三)本公司於「道德行為準則」明訂本公司人員應以客觀及有效率之方式處理業務，避免利用其在公司擔任之職務，使其自身、他人或他企業獲致不當利益之防止利益衝突政策，且於「誠信經營程序及行為指南」詳細規範利害關係人就董事會各項議案有利益衝突時所應行利益迴避方式。又，本公司提供之利益衝突陳述管道依主體不同，區分如下：董事或獨立董事應向總經理室或公司治理主管為之；經理人則應向法令遵循單位為之；其餘同仁應陳報直屬主管及法遵單位，並由直屬主管適當指導之。本公司已制訂「員工利益迴避宣導暨確認函」，發放新進同仁到職時簽回，據以向同仁宣導利益衝突迴避的各項要點及管理措施，確認員工無利益衝突情事，並使員工明確了解發生利益衝突時其所負主動通報之義務。</p> <p>(四)本公司已建立會計制度及內部控制制度，並落實執行，且由</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>內部稽核人員依不誠信行為風險之評估結果，擬訂包括稽核對象、範圍、項目、頻率等內容之稽核計畫，據以查核防範方案遵循情形；查核結果應通報高階管理層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會。另本公司為確保制度之設計及執行持續有效，每年進行檢視及修訂作業，以建立良好公司治理與風險管控機制，作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。</p> <p>(五)本公司定期擬訂並實施教育訓練，課程包括公司治理、誠信經營、商業行為有關係法令等相關領域；針對「誠信經營」及「防範內線交易」課程，就現任董事、經理人及依需求或經認有修課必要之受僱人至少每二年辦理一次，新任董事及經理人於上任後三個月內辦理，新進受僱人員則由人資單位於職前訓練時併同辦理。此外，依本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，亦安排董事長或公司治理主管於董事會及主管會議向董事、經理人、主管等傳達誠信之重要性。本公司114年度開設之相關訓練課程有「防範內線交易教育訓練」及「誠信經營教育訓練」，具體課程內容參照上述(二)(4)說明，修課人數累計427人次。</p>	
	V		無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準及相關程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>法」依被檢舉人及涉案態樣不同，分別訂有相對應之調查、處理程序；又檢舉案之處理均以保密、全力保護檢舉人、提供相對人申訴機會...等方式為之，以確保檢舉人及相對人之合法權益。檢舉情事經查證屬實者，後續將立即要求被檢舉人停止、為適當之處置、責成相關單位檢討並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生；法務單位將另就檢舉情事、處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告之。本公司114年依據外部專家建議，對「檢舉非法與不誠信行為案件之處理辦法」完成第五次改版，優化措施包含：(1)整合一個獨立可信賴之舉報案件統籌單位（法務單位），各權責單位接獲檢舉時，應統一通報法務單位；(2)新增「通報獨立董事」程序，使獨立董事得即時同步掌握舉報案件狀況及監督後續處理情形，進一步強化吹哨人機制；(3)新增增處理人員利益衝突迴避原則。</p> <p>(三)本公司依「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」以保密方式處理檢舉案件，允許匿名檢舉，並全力保護檢舉人，其身分將絕對保密，亦不因檢舉情事而遭不當處置；處理檢舉案之人員另應向檢舉人書面表示其身分與檢舉內容將被保密。</p>	
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形；本公司已訂定「誠信經營守則」，清楚規範公司人員應遵守之事項，另檢舉與懲處亦已明定於各相關辦法中，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。			

評 估 項 目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
	摘要說明		
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)</p> <p>1. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，以作為落實誠信經營之基本前提；對於環境及品質政策之遵行，亦不遺餘力採取高標準對待。</p> <p>2. 本公司「董事會議事規範」及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。</p> <p>3. 本公司訂有「防範内线交易管理程序」，明文內外部人、準內外部人、消息受領人依法不得有實際知悉重大消息，而於重大消息明確後未公開前或上市後十八小時內，進行買賣本公司之上市或證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券、或賣出本公司内线交易管理程序」規定證券商營業處所買賣之股票者因未諳法規誤觸内线交易紅線。此外，「防範内线交易管理程序」和每季財務報告公告期間，並由總經理室安插封閉期，並由總經理室安插封閉期，並由總經理室安插封閉期，並由總經理室安插封閉期。</p> <p>4. 本公司訂有「內外部重大資訊一致性及正確性探詢或蒐集義務」，建立本公司良好之內外部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外發給之重大資訊，均經內外部重大資訊及受僱人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，亦不得向知悉本公司內外部重大資訊之個人職權範圍外洩露。</p> <p>5. 本公司依據外部專家建議，對「檢舉非法與不誠信行為案件之處理辦法」於114年5月16日完成第五次改版，優化措施包含：(1)整合一個獨立董事得即時同步掌握報案案件狀況及監督後處置情形，進一步強化吹哨人機制；(2)新增「通報法務單位」程序，使獨立董事得即時同步掌握報案案件狀況及監督後處置情形，進一步強化吹哨人機制；(3)新增處理人員利益衝突迴避原則。</p>			

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

1. 本公司網站：<http://www.sas-globalwafers.com> 「投資人專區」及「企業永續」
2. 董事進修情形：請參見公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)
首頁>彙總報表>公司治理>董事/獨立董事/監察人>董事及監察人出(列)席董事會及進修情形彙總表 (市場別：上櫃；公司代號：6488)。

(十) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：請參見公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)
首頁>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告 (市場別：上櫃；公司代號：6488)。
網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 114 年股東常會(114.05.26)重要決議及執行情形

重要決議	執行情形
1.通過修訂「公司章程」案	經股東會決議後，於 114 年 6 月 4 日經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局准予登記。
2.通過承認 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案	經股東會決議照案承認。

2. 董事會重要決議

日期	重要決議
第六屆 第五次 114.02.25	1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司義大利子公司 MEMC Electronic Materials S.p.A. 2016 年 12 月至 2018 年盈餘不匯回分配案。 3.本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 4.本公司 113 年度盈餘分配表暨 113 年下半年度盈餘分派案。 5.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨續委任案。 6.本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 7.修訂本公司「公司章程」案。 8.本公司「基層員工」範圍訂定案。 9.召開 114 年股東常會議程暨受理股東提案之相關事宜案。 10.本公司擬發行國內無擔保普通公司債案。 11.本公司擬與金融機構簽訂 Cash Pool Agreement 並提供保證案。 12.本公司經理人調薪案。
第六屆 第六次 114.04.07	1.本公司擬增加對荷蘭子公司 GlobalWafers B.V.之投資案。
第六屆 第七次 114.05.06	1.本公司 114 年度第一季合併財務報告案。 2.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案。 3.本公司向金融機構申請商業本票承銷額度案。 4.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函 (LOS) 案。

日期	重要決議
	5.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司擔任保證人案。 6.本公司資金貸與子公司案。 7.本公司 113 年度「永續報告書」暨「企業永續發展委員會」之年度推行與執行情形。 8.本公司 114 年度「永續報告書」之執行獨立確信或查證之第三方機構委任案。 9.修訂本公司「員工酬勞分派辦法」案。 10.解除本公司經理人競業禁止之限制案。 11.本公司研發主管異動案。 12.本公司 113 年度董事酬勞分配案。 13.本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案。
第六屆 第八次 114.08.05	1.本公司 114 年度第二季合併財務報告案。 2.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案。 3.本公司向金融機構申請商業本票承銷額度案。 4.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函(LOS)案。 5.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司擔任保證人案。 6.修訂本公司「提名委員會組織規程」案。 7.訂定本公司「稅務治理政策」案。 8.子公司環球晶資本股份有限公司增資案。
第六屆 第九次 114.09.26	1.本公司擬與續興股份有限公司簽署離岸風電購售電契約以採購 15.5MW 的離岸風電案。
第六屆 第十次 114.11.04	1.本公司 114 年度第三季合併財務報告案。 2.修訂本公司「內部控制制度」案。 3.本公司 115 年度內部稽核計畫案。 4.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案。 5.本公司向金融機構申請商業本票承銷額度案。 6.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函（LOS）案。 7.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司擔任保證人案。 8.變更「提名委員會」為「提名暨永續發展委員會」案。 9.修訂本公司「董事及功能性委員會酬金給付辦法」案。 10.修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」案。 11.修訂本公司「永續發展實務守則」案。 12.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
第六屆 第十一次 114.12.09	1.擬訂本公司 115 年度營運計畫案。 2.本公司 114 年上半年度以資本公積配發現金案。 3.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案。 4.本公司向金融機構申請商業本票承銷額度案。 5.為子公司向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函（LOS）案。 6.本公司代理發言人異動案。 7.本公司會計主管異動案。
第六屆 第十二次 115.01.12	1.本公司會計主管異動案
第六屆	1.本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

日期	重要決議
第十三次 115.03.03	2.本公司 115 年度「基層員工」範圍訂定案。 3.本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。 4.本公司 114 年度盈餘分配表暨 114 年下半年度盈餘分派案。 5.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨續委任案。 6.本公司 114 年度會計師簽證公費案。 7.本公司 114 年度「內部控制制度聲明書」案。 8.修訂本公司「誠信經營守則」案。 9.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案。 10.為子公司簽訂租賃契約，由本公司擔任連帶保證人案。 11.本公司擬發行國內無擔保普通公司債案。 12.為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案。 13.召開 115 年股東常會議程暨受理股東提案之相關事宜案。 14.本公司 115 年度四年期員工獎酬方案。 15.人事晉升案。 16.本公司經理人年度調薪案。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	吳俊源	114 年度	7,490	稅務相關服務 3,214	10,704	
	黃泳華					

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：

公司最近二年度及其期後期間更換會計師情形：本公司最近二年度更換簽證會計師係安侯建業聯合會計師事務所內部組織調整及業務調度，並無更換簽證會計師事務所。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形：

請參見公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)

股權移轉：首頁>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表 (公司代號：6488)。

網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1

股權質押變動情形：首頁>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告 (公司代號：6488)。

網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1

(二)股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(三)股權質押相對人為關係人資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

單位：股；%；115年3月26日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
中美矽晶製品股份有限公司 代表人：徐秀蘭	223,007,864	46.64%	—	—	—	—	無	無	
	847,879	0.18%	—	—	—	—	無	無	
富邦人壽保險股份有限公司	12,561,000	2.63%	—	—	—	—	無	無	
彰化商業銀行股份有限公司受託保管元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金專戶	8,354,000	1.75%	—	—	—	—	無	無	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管WGI新興市場基金公司投資專戶	7,733,000	1.62%	—	—	—	—	無	無	
國泰人壽保險股份有限公司	6,900,000	1.44%	—	—	—	—	無	無	
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶	6,493,000	1.36%	—	—	—	—	無	無	
德商德意志銀行台北分行受託保管雷查德資產管理有限公司經理之雷拉新興市場股票組合投資專戶	5,144,000	1.08%	—	—	—	—	無	無	
南山人壽保險股份有限公司	5,141,000	1.08%	—	—	—	—	無	無	
新光人壽全權委託台新投信股票投資帳戶第六期	3,648,000	0.76%	—	—	—	—	無	無	
德商德意志銀行台北分行受託保管蓋茲基金會信託委託外部經理人威斯伍全球投資有限合夥投資專戶	3,300,000	0.69%	—	—	—	—	無	無	

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

114年12月31日

單位：仟股；%

轉投資事業(註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
GlobalSemiconductor Inc.	23,000	100.00%	-	-	23,000	100.00%
GlobalWafers Japan Co., Ltd.	128	100.00%	-	-	128	100.00%
GlobalWafers GmbH	48,025	100.00%	-	-	48,025	100.00%
GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.	41,674	100.00%	-	-	41,674	100.00%
GlobalWafers B.V.	0.1	100.00%	-	-	0.1	100.00%
旭愛能源股份有限公司	104,500	100.00%	-	-	104,500	100.00%
旭信電力股份有限公司	14,134	100.00%	-	-	14,134	100.00%
寰球鑫投資股份有限公司	25,000	100.00%	-	-	25,000	100.00%
環球晶資本股份有限公司	93,261	79.41%	24,178	20.59%	117,440	100.00%
弘望投資股份有限公司	30,976	30.98%	-	-	30,976	30.98%
兆遠科技股份有限公司	43,836	100.00%	-	-	43,836	100.00%
Crystalwise Technology (HK) Limited	-	-	47,650	100.00%	47,650	100.00%
元鴻(山東)光電材料有限公司	-	-	(註2)	100.00%	(註2)	100.00%
昆山中辰矽晶有限公司	-	-	(註2)	100.00%	(註2)	100.00%
MEMC Electronic Materials Sdn. Bhd.	-	-	89,586	100.00%	89,586	100.00%
昆山辰巨電子科技有限公司	-	-	(註2)	100.00%	(註2)	100.00%
上海召業申凱電子材料有限公司	-	-	(註2)	100.00%	(註2)	100.00%
忻州元鴻信息材料有限公司	-	-	(註2)	90.00%	(註2)	90.00%
MEMC Japan Ltd.	-	-	750	100.00%	750	100.00%
MEMC Electronic Materials S.p.A.	-	-	65,000	100.00%	65,000	100.00%
MEMC Electronic Materials France SarL	-	-	0.5	100.00%	0.5	100.00%
GlobiTech Incorporated.	-	-	1	100.00%	1	100.00%
MEMC LLC	-	-	-	100.00%	-	100.00%
GlobalWafers America, LLC	-	-	1	100.00%	1	100.00%
MEMC Korea Company	-	-	25,200	100.00%	25,200	100.00%
安科思資本股份有限公司	-	-	624,000	100.00%	624,000	100.00%
MEMC Ipoh Sdn. Bhd.	-	-	612,300	100.00%	612,300	100.00%
Topsil GlobalWafers A/S	-	-	1,000	100.00%	1,000	100.00%

註1：係公司採用權益法之投資。

註2：為有限公司，故無股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 已發行股份種類

115年03月31日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名普通股	478,113,725	521,886,275	1,000,000,000	該股票係屬上櫃股票

2. 股本形成經過

115年03月31日；單位：新台幣元；股

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金外財產抵充者	現以之其他
100/10	10	300,000,000	3,000,000,000	180,000,000	1,800,000,000	設立資本 1,800,000,000元	無	註1
101/05	10	400,000,000	4,000,000,000	317,500,000	3,175,000,000	現金增資 1,375,000,000元	無	註2
104/01	10	400,000,000	4,000,000,000	349,250,000	3,492,500,000	現金增資 317,500,000元	無	註3
104/09	10	400,000,000	4,000,000,000	369,250,000	3,692,500,000	現金增資 200,000,000元	無	註4
106/05	10	600,000,000	6,000,000,000	437,250,000	4,372,500,000	現金增資 680,000,000元	無	註5
111/11	10	600,000,000	6,000,000,000	435,237,000	4,352,370,000	註銷庫藏股減資 20,130,000元	無	註6
112/11	10	1,000,000,000	10,000,000,000	436,113,725	4,361,137,250	與兆遠科技進行 股份轉換發行新股 8,767,250元	無	註7
113/04	10	1,000,000,000	10,000,000,000	478,113,725	4,781,137,250	現金增資 420,000,000元	無	註8

註1：新竹科學園區管理局 100年10月18日園商字第1000030345號核准函。

註2：新竹科學園區管理局 101年05月16日園商字第1010014266號核准函。

註3：新竹科學園區管理局 104年02月25日竹商字第1040005439號核准函。

註4：新竹科學園區管理局 104年10月15日竹商字第1040029649號核准函。

註5：新竹科學園區管理局 106年05月17日竹商字第1060012613號核准函。

註6：新竹科學園區管理局 111年11月09日竹商字第1110035918號核准函。

註7：新竹科學園區管理局 112年11月17日竹商字第1120037966號核准函。

註8：新竹科學園區管理局 113年04月19日竹商字第1130011578號核准函。

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

115年3月26日；單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
中美矽晶製品股份有限公司		223,007,864	46.64%
富邦人壽保險股份有限公司		12,561,000	2.63%
彰化商業銀行股份有限公司受託保管元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金專戶		8,354,000	1.75%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管WGI新興市場基金公司投資專戶		7,733,000	1.62%
國泰人壽保險股份有限公司		6,900,000	1.44%
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶		6,493,000	1.36%
德商德意志銀行台北分行受託保管雷查德資產管理有限公司經理之雷拉新興市場股票組合投資專戶		5,144,000	1.08%
南山人壽保險股份有限公司		5,141,000	1.08%
新光人壽全權委託台新投信股票投資帳戶第六期		3,648,000	0.76%
德商德意志銀行台北分行受託保管蓋茲基金會信託委託外部經理人威斯伍全球投資有限合夥投資專戶		3,300,000	0.69%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

依據本公司之章程規定，本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分配之：

- (1) 彌補虧損。
- (2) 提存百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。
- (3) 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- (4) 當年度盈餘扣除上列一至三項後，如尚有盈餘併同以前年度未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配案，以現金方式為之時，依公司法第240條第5項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息或紅利之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司為維持公司永續經營發展及每股盈餘之穩定成長，股東股利以當年度稅後盈餘扣除當年度依法應提列特別盈餘公積後之百分之五十以上為原則，分配比率為現金股利不低於百分之五十。

本公司依公司法第241條規定，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金，以現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數決議之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發放之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。董事酬勞以現金方式分派，員工酬勞以股票或現金方式分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2. 本次股東會報告股利分配之情形

依本公司章程規定，授權董事會於每半年度終了後，得決議以現金分派盈餘及資本公積。本公司董事會決議核准之民國 114 年各半年度現金股利，其金額與發放日期如下：

民國 114 年	核准日期 (民國年/月/日)	發放日期 (民國年/月/日)	每股現金股利(新台幣元)			現金股利總金額 (新台幣元)
			盈餘	資本公積	合計	
上半年度	114/12/9	115/1/30	0	2.0	2.0	956,227,450
下半年度	115/3/3	115/8/14	5.7	0	5.7	2,725,248,233
合計			7.7			3,681,475,683

3. 預期股利政策將有重大變動說明：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工酬勞及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

請詳上述(三) 1. 股利政策之說明。

2. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

(1) 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎：依公司章程規定估列。

(2) 本期以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：員工酬勞若以股票分派之股數計算基礎係依據最近一期會計師查核之財務報告淨值為計算基礎，本期並無以股票分派員工酬勞情形。

(3) 本期實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：股東會決議與估列數如有差異，視為估計變動，列為當期損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司於115年3月3日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞如下：

員工酬勞：新台幣400,996,489元，全數以現金發放。

董事酬勞：新台幣41,400,000元，全數以現金發放。

員工酬勞及董事酬勞實際配發情形與114年度財務報表認列數並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4. 前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工酬勞及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞經 114 年 2 月 25 日董事會決議配發如下

單位：元

項目	董事會決議配發	實際分派情形	差異數	差異說明
員工現金紅利	366,824,575	366,824,575	無	不適用
董監酬勞	36,690,000	36,690,000	無	不適用

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：

115年3月31日

公司債種類	110年度第1期 無擔保普通公司債	110年度第2期 無擔保普通公司債	113年度第1期 無擔保普通公司債
發行(辦理)日期	110.05.11	110.08.19	113.03.19
票面金額	新台幣 1,000,000 元	新台幣 1,000,000 元	新台幣 1,000,000 元
發行及交易地點	中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格	依面額 100%發行	依面額 100%發行	依面額 100%發行
發行總額	新台幣 6,500,000,000 元	甲券:新台幣 7,100,000,000 元 乙券:新台幣 5,400,000,000 元	甲券:新台幣 2,500,000,000 元 乙券:新台幣 2,500,000,000 元
票面利率	固定年利率 0.62%	甲券:固定年利率 0.50% 乙券:固定年利率 0.60%	甲券:固定年利率 1.70% 乙券:固定年利率 1.75%
期限	5 年期, 到期日:115.05.11	甲券: 3 年期, 到期日:113.08.19 乙券: 5 年期, 到期日:115.08.19	甲券: 5 年期, 到期日:118.03.19 乙券: 7 年期, 到期日:120.03.19
保證機構	無	無	無
受託人	台北富邦商業銀行 股份有限公司	台北富邦商業銀行 股份有限公司	台北富邦商業銀行 股份有限公司
承銷機構	元大證券、凱基證券	元大證券、凱基證券 富邦證券	富邦證券、凱基證券
簽證律師	一誠聯合法律事務所 郭惠吉律師	一誠聯合法律事務所 郭惠吉律師	一誠聯合法律事務所 郭惠吉律師
簽證會計師	安侯建業聯合會計師事務所 陳振乾會計師	安侯建業聯合會計師事務所 鄭安志會計師	安侯建業聯合會計師事務所 鄭安志會計師
償還方法	到期一次還本	到期一次還本	到期一次還本
未償還本金	新台幣 6,500,000,000 元	乙券:新台幣 5,400,000,000 元	甲券:新台幣 2,500,000,000 元 乙券:新台幣 2,500,000,000 元
贖回或提前清償 之條款	無	無	無
限制條款	無	無	無
信用評等機構名稱、 評等日期、公司債評 等結果	不適用	不適用	不適用
附其他 權利	已轉換普通 股、海外存 託憑證或其 他有價證券 之金額	不適用	不適用
	發行及轉換 辦法	無	無
發行及轉換辦法、發 行條件對股權可能稀 釋情形及對現有股東 權益影響	無	無	無
交換標的委託保管機 構名稱	無	無	無

115年3月31日

公司債種類	114年度第1期 無擔保普通公司債	114年度第2期 無擔保普通公司債
發行(辦理)日期	114.05.28	114.09.24
票面金額	新台幣 1,000,000 元	新台幣 1,000,000 元
發行及交易地點	中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格	依面額 100%發行	依面額 100%發行
發行總額	甲券:新台幣 3,300,000,000 元 乙券:新台幣 2,800,000,000 元 丙券:新台幣 1,400,000,000 元	甲券:新台幣 4,700,000,000 元 乙券:新台幣 4,400,000,000 元 丙券:新台幣 700,000,000 元 丁券:新台幣 2,200,000,000 元
票面利率	甲券:固定年利率 2.01% 乙券:固定年利率 2.08% 丙券:固定年利率 2.18%	甲券:固定年利率 1.86% 乙券:固定年利率 1.92% 丙券:固定年利率 1.98% 丁券:固定年利率 2.02%
期限	甲券:3年期,到期日:117年5月28日 乙券:5年期,到期日:119年5月28日 丙券:10年期,到期日:124年5月28日	甲券:3年期,到期日:117年9月24日 乙券:5年期,到期日:119年9月24日 丙券:7年期,到期日:121年9月24日 丁券:10年期,到期日:124年9月24日
保證機構	無	無
受託人	台北富邦商業銀行 股份有限公司	台北富邦商業銀行 股份有限公司
承銷機構	富邦證券、元大證券、凱基證券、 台新銀行、永豐金證券、元富證券、 華南永昌證券	富邦證券、元大證券、 凱基證券、永豐金證券
簽證律師	一誠聯合法律事務所 蔡宗釗律師	一誠聯合法律事務所 蔡宗釗律師
簽證會計師	安侯建業聯合會計師事務所 吳俊源會計師	安侯建業聯合會計師事務所 吳俊源會計師
償還方法	到期一次還本	到期一次還本
未償還本金	甲券:新台幣 3,300,000,000 元 乙券:新台幣 2,800,000,000 元 丙券:新台幣 1,400,000,000 元	甲券:新台幣 4,700,000,000 元 乙券:新台幣 4,400,000,000 元 丙券:新台幣 700,000,000 元 丁券:新台幣 2,200,000,000 元
贖回或提前清償之條款	無	無
限制條款	無	無
信用評等機構名稱、 評等日期、公司債評等結果	不適用	不適用
附其他權利	已轉換普通股、 海外存託憑證或 其他有價證券之 金額	不適用
	發行及轉換辦法	無
發行及轉換辦法、發行條件對 股權可能稀釋情形及對現有股 東權益影響	無	無
交換標的委託保管機構名稱	無	無

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證之辦理情形：

115年3月31日

發行日期	106年4月26日	113年4月2日
項目		
發行及交易地點	盧森堡證券交易所	盧森堡證券交易所
發行總金額	USD 469,200,000 元	USD 688,800,000 元
單位發行價格	每單位海外存託憑證交易價格為 6.9 美元	每單位海外存託憑證交易價格為 16.40 美元
發行單位總數	68,000,000 單位	42,000,000 單位
表彰有價證券之來源	環球晶圓股份有限公司普通股	環球晶圓股份有限公司普通股
表彰有價證券之數額	68,000,000 股	42,000,000 股
存託憑證持有之權利與義務	<p>海外存託憑證持有人之權利義務，應依中華民國相關法令及存託契約有關規定辦理。存託契約主要約定事項如下：</p> <p>(一)表決權之行使 除法令另有規定外，海外存託憑證持有人得依存託契約及中華民國法令規定，行使其海外存託憑證所表彰之環球晶圓普通股之表決權。</p> <p>(二)股利分配、新股優先認購權及其他權益 除存託契約另有規定外，海外存託憑證持有人原則上享有與環球晶圓普通股股東同等之股利分派及其他配股權利。如環球晶圓未來發放股票股利事宜時，存託機構將依存託契約及相關法律之規定，按海外存託憑證持有人原持有單位數比例增發海外存託憑證予海外存託憑證持有人，或提高每單位海外存託憑證所表彰之環球晶圓普通股，或代海外存託憑證持有人出售該股票股利，並將出售所得之金額(扣除稅賦及相關費用後)按比例分配予海外存託憑證持有人。 環球晶圓辦理現金增資或其他認股權時，海外存託憑證持有人在符合中華民國及其他相關法令之情形下原則上享有與環球晶圓普通股股東同等之新股優先認股權利，存託機構應於存託契約及相關法律許可之範圍內，按存託契約之規定，提供海外存託憑證持有人該等權利，或代海外存託憑證持有人出售此權利，並將出售所得之價金(扣除稅賦及相關費用後)按比例分配予海外存託憑證持有人。</p>	
受託人	不適用	
存託機構	CitiBank, N.A.	
保管機構	第一商業銀行	
未兌回餘額	121,646 單位	
發行及存續期間相關費用之分攤方式	<p>(一)海外存託憑證發行相關費用 除法令另有規定或發行公司與國外主辦承銷商及存託機構另有約定外，所有海外存託憑證之發行成本及費用，包括法律費用、上市掛牌費用、財務顧問費用及其他相關費用及支出，均由發行公司負擔。</p> <p>(二)海外存託憑證存續期間之費用 海外存託憑證存續期間之各年度上市費用、資訊揭露及其他相關費用，除法令另有規定外或發行公司與國外主辦承銷商及存託機構另有約定外，皆由發行公司負擔。</p>	
存託契約及保管契約之重要約定事項	詳如存託契約及保管契約	

每 單 位 市 價	114 年	最 高	USD 17.60
		最 低	USD 8.00
		平 均	USD 11.825
	當年度截至 115 年 3 月 31 日	最 高	USD 16.70
		最 低	USD 12.80
		平 均	USD 14.658

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍：

1. 所營業務之主要內容

CC01080 電子零組件製造業

C801990 其他化學材料製造業

F119010 電子材料批發業（限區外經營）

F219010 電子材料零售業（限區外經營）

CB01010 機械設備製造業

F401010 國際貿易業

研發、設計、開發、製造及銷售下列產品：

1. 半導體矽晶材料及其元件
2. 矽化合物
3. 碳化矽化合物
4. 半導體設備
5. 碳化矽晶體生長設備
6. 兼營與前項業務相關之進出口貿易業務

2. 營業比重

單位：新台幣仟元

產品項目	113 年度		114 年度	
	營業收入淨額	比重(%)	營業收入淨額	比重(%)
半導體晶片產品	60,762,655	97.0%	59,475,310	98.1%
半導體晶錠產品	1,372,868	2.2%	854,304	1.4%
電費收入	154,604	0.3%	172,384	0.3%
其他	335,877	0.5%	95,940	0.2%
合計	62,626,004	100.00%	60,597,938	100.0%

3. 目前之商品項目

- A、超低電阻重摻紅磷/硼/砷/銻晶圓
- B、12吋特殊磊晶晶圓應用於影像感測用元件及功率元件
- C、12吋(110)及(111)特殊晶圓
- D、SOI 晶圓
- E、拋光晶圓及磊晶晶圓
- F、退火晶圓
- G、超薄晶圓
- H、高亮度浸蝕晶圓
- I、擴散晶圓及深擴散拋光晶圓
- J、GaN_HEMT 磊晶用高強度矽基板
- K、FZ 矽晶圓

- L、中子照射超純矽晶圓
- M、Perfect Silicon
- N、客製化”ECAS”晶圓
- O、氮化鎵磊晶片
- P、4吋~8吋導電型碳化矽晶圓
- Q、4吋~8吋半絕緣碳化矽晶體與晶片
- R、太鼓晶片
- S、12吋方形矽晶片
- T、12吋散熱應用碳化矽晶圓
- U、其他化合物晶體

4. 計畫開發之新商品

- A、次世代高功率車用電子元件用碳化矽晶圓
- B、GaN_HEMT 用磊晶晶圓
- C、矽光子 SOI 晶圓
- D、高電阻 ECAS 晶圓襯底接合晶圓
- E、12吋鑽石線切割製程開發
- F、次世代 3D 記憶體用矽晶圓
- G、8吋碳化矽磊晶開發
- H、新世代碳化矽晶體生長爐
- I、先進封裝應用客製化特殊晶圓

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

A. 全球半導體市場展望與結構性成長動能

全球半導體產業在經歷 2024 年的庫存調整與循環性復甦後，正受惠於人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 相關應用的擴張。根據世界半導體貿易統計組織 WSTS 及業界研究顯示，2025 年全球半導體市場規模預計將達到約 7,722 億美元，年成長率為 22.50%；展望 2026 年，成長動能將進一步轉強，市場規模預估增至 9,755 億美元，年成長率達 26.30%，產值持續邁向一兆美元之長期目標。此一強勁成長動能，主要由 AI 基礎建設的結構性需求轉移所驅動。根據 WSTS 預測，2026 年全球半導體市場將再成長約 25%，各細分領域均呈現快速擴張，其中記憶體預計成長 39%、邏輯晶片成長 32%，其他類別如微元件 (14%)、分立元件 (11%)、感測器 (9%)、類比元件 (7%) 及光電元件 (5%) 亦將同步成長。2025 年邏輯晶片銷售額大幅成長 40% 至 3,019 億美元，記憶體銷售額成長 35% 至 2,231 億美元，主要受惠於 AI 相關投資加速擴展。伺服器相關需求佔半導體市場比重，已由 2024 年的 22% 提升，預計 2026 年將突破 40%，超越智慧手機與個人電腦的合計市佔率。在客戶端庫存水位方面，成熟規格產品在歷經前期高庫存挑戰後，近半年已逐步回歸健康水準。即便部分終端需求表現優異，過去受早期大量合約累積之高庫存，近期亦已完成相當程度之去化，為後續需求回溫奠定堅實基礎。整體產業雖因終端應用領域不同而使復甦節奏略有差異，但整體趨勢呈

現「不均勻但方向向上」之態勢。

Autumn 2025	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Americas	195,123	251,926	338,574	45.2	29.1	34.4
Europe	51,250	54,127	60,429	-8.1	5.6	11.6
Japan	46,739	44,835	50,164	0.0	-4.1	11.9
Asia Pacific	337,437	421,354	526,293	16.4	24.9	24.9
Total World - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3
Discrete Semiconductors	31,026	30,900	33,436	-12.7	-0.4	8.2
Optoelectronics	41,095	42,597	45,020	-4.8	3.7	5.7
Sensors	18,923	20,894	22,713	-4.1	10.4	8.7
Integrated Circuits	539,505	677,852	874,291	25.9	25.6	29.0
Analog	79,588	85,552	91,988	-2.0	7.5	7.5
Micro	78,633	84,839	96,620	3.0	7.9	13.9
Logic	215,768	295,892	390,863	20.8	37.1	32.1
Memory	165,516	211,568	294,821	79.3	27.8	39.4
Total Products - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3

資料來源：世界半導體貿易統計組織 WSTS (2025/2026 年預測)

人工智慧之發展正由以算力為核心之初期階段，逐步擴展至工業自動化、機器人 (Robotics) 與全面性邊緣 AI 應用，其影響力已從單一高階運算延伸至多元半導體元件需求，包含感測器 (Sensor)、功率元件與驅動 IC (Driver IC) 等，需求範圍不再侷限於先進製程。此發展趨勢預期將同時帶動 12 吋與 8 吋晶圓之需求，特別是部分功率元件與成熟製程元件因其物理特性，仍高度依賴 8 吋產能，為相關製程帶來穩定之結構性支撐。在高階應用方面，AI 晶片設計日益趨向大型化與複雜化，對先進製程 (7 奈米及以下) 的需求帶動了 12 吋矽晶圓之耗用量，使其產能利用率維持於高檔水位，對矽晶圓產業形成長期結構性支撐。此外，先進封裝技術 (如 CoWoS、HBM 及混合鍵合 Hybrid Bonding) 已成為解決運算效能瓶頸之關鍵技術。根據數據顯示，先進製程產能預計於 2025 年持續擴張，平均產能利用率穩定維持於 90% 以上。此技術趨勢不僅強化了高階晶圓之訂單穩定度，亦對矽晶圓之厚度、平整度及表面品質等技術指標提出更高標準。

展望 2025 至 2026 年，受惠於人工智慧持續推動高階邏輯製程晶片需求，以及高頻寬記憶體 (HBM) 滲透率快速提升，半導體供應鏈涵蓋設計、製造、測試及先進封裝等環節，在上下游橫縱協作之下，已進入高強度成長階段。半導體市場在 AI 基礎建設的結構性需求轉移驅動下，全球半導體市場規模有望於 2026 年接近兆美元門檻。邏輯晶片與記憶體市場將是主要驅動力，伺服器相關需求佔半導體市場比重預計於 2026 年突破 40%。成熟製程市場亦受惠於消費電子、車用與工控領域的持續復甦，帶動整體市場需求回升。然而，貿易關稅政策變動、地緣政治風險及全球經濟環境的不確定性，仍可能對供應鏈發展帶來挑戰，市場成長幅度仍需審慎觀察。整體而言，在 AI 應用加速滲透、5G、電動化、智慧座艙、自動駕駛等創新應用持續推動，以及各國半導體在地化政策激勵下，半導體市場仍具備長期成長潛力，並將展現相當的韌性。

B. 半導體晶圓產業概況

半導體製造流程係包括 IC 設計、IC 晶圓製造、IC 封裝、IC 測試等階段，依上、中、下游來劃分半導體產業整體結構，IC 設計應屬半導體上游產業、IC 晶圓製造則屬中游產業；IC 封裝、IC 測試則屬下游產業。半導體晶圓製造業於整個半導體產業架構中係擔任晶圓材料供應者角色，隨著半導體產業的蓬勃發展，對半導體晶圓材料之需求亦急速增加。

矽晶圓為目前主要製作積體電路之基底材料，其原始材料「矽」，是地殼表面取之不盡、用之不竭的二氧化矽礦石，經由電弧爐提煉、鹽酸氯化及蒸餾處理後，製成高純度的多晶矽，其純度要求達 99.999999999%。矽晶圓製造廠將此多晶矽加熱融解，並於熔融液摻入一小粒的矽晶體晶種，將其緩慢地拉出成形，讓多晶矽被拉成不同直徑大小的單晶矽晶棒，因矽晶棒是由一顆小晶粒在熔融態的矽原料中逐漸生成，此過程稱為「長晶」。矽晶棒再經過切割、研磨、拋光、切片等加工製程，即可成為積體電路產業之重要原料—「矽晶圓」。每塊數英吋直徑大小的空白矽晶圓，經過複雜的化學和電子製程後，可佈設多層精細的電子電路，而依面積大小有 3 吋、4 吋、5 吋、6 吋、8 吋及 12 吋(直徑)等規格之分，這些矽晶圓經送至晶圓廠內製造晶片電路後，再經切割、測試、封裝等程序，即成為市面上一顆顆的 IC。

目前半導體產業所使用之矽晶圓材料，依其製程設計和產品差異主要分為拋光晶圓 (polished wafer)、退火晶圓(argon anneal wafer)及磊晶晶圓 (epitaxial wafer) 三種，其均由高純度電子級多晶矽經由長晶 (crystal pulling)、切片 (slicing)、磨邊 (beveling)、磨面 (lapping)、蝕刻 (etching)、拋光 (polishing)、清洗 (cleaning) 等步驟，而生成一符合電性、表面物性、雜質標準等規格的拋光晶圓，拋光晶圓如果再經由化學氣相沉積反應，成長一層不同電阻率的單晶薄膜，就成為磊晶晶圓，由於磊晶晶圓擁有更佳的面積特性，被廣泛應用在各種分離式元件及高性能積體電路。

化合物半導體 (Compound Semiconductor) 指由兩種或以上的元素組成半導體材料，如砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP)、碳化矽 (SiC)、氮化鎵 (GaN) 等。相比傳統矽 (Si) 半導體，化合物半導體具備高頻、高功率、高耐壓、低功耗、光電特性優越等優勢，在 5G 通訊、電動車 (EV)、功率電子、光電、航太軍事領域有著廣泛應用。下表為目前化合物半導體主要的材料及其應用領域：

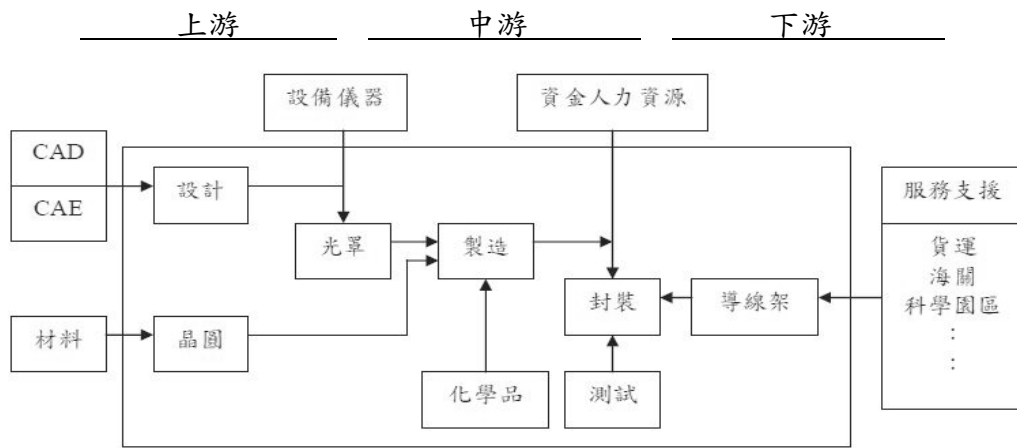
材料	能隙 (eV)	主流尺寸	晶體生長方法	磊晶方式	主要特性	主要應用
砷化鎵 (GaAs)	1.43	市場尺寸已擴展至 6 吋，降低成本並提高產能	液封直拉法 (LEC:Liquid Encapsulant Czochralski)或垂直梯度凝固法 (VGF: vertical gradient freeze method)法為主流	同質磊晶	高電子遷移率、優秀光電特性	5G、光通信、射頻元件

磷化銦 (InP)	1.35	市場由 2 吋、3 吋、4 吋逐步擴展至 6 吋	垂直梯度凝固法 (VGF)法為主流	同質磊晶	高頻、高速、低雜訊	5G、光纖通訊、雷射
氮化鎵 (GaN)	3.4	由 6 吋發展至 8 吋	以矽晶圓/碳化矽為基板	異質磊晶 GaN on Si GaN on SiC	高耐壓、高頻、高功率密度	5G 基站、雷達、電源管理
碳化矽 (SiC)	3.26	由 4 吋->6 吋發展至 8 吋	PVT 為主流	同質磊晶	高擊穿場、高熱導率	電動車、工業電源、太陽能
氧化鎵 (Ga ₂ O ₃)	4.8	發展中	發展中	同質磊晶/異質磊晶	超高耐壓、新興材料	下一代功率元件

隨著半導體技術的發展，化合物半導體（Compound Semiconductor）與矽基半導體（Si-based Semiconductor）的整合成為市場趨勢，因為這能夠同時發揮矽（Si）的成熟製程與低成本優勢，以及化合物半導體的高頻率、高功率與光電特性。透過異質整合、先進封裝、外延技術等方式，讓 SiC、GaN、GaAs、InP 等材料發揮高效能優勢，同時降低成本。這些整合技術將大幅提升 5G/6G 通訊、電動車（EV）、光電、AI 運算、光通訊等領域的應用，推動半導體技術邁向新世代。

2. 產業上、中、下游之關聯性

台灣半導體產業隨著整體半導體的垂直分工整合的趨勢演進，依製造流程可區分為上游之 IC 設計公司(IC Design)與半導體晶圓製造公司，由 IC 設計公司依客戶的需求設計出電路圖，半導體晶圓製造公司則以多晶矽及化合物半導體為原料製造出半導體晶圓；中游之 IC 晶圓製造廠(IC Manufacturing and Foundry)則依 IC 設計公司設計好之電路圖在半導體晶圓製造公司製造好的晶圓上，以光罩印上電路基本圖樣，再以氧化、擴散、CVD、蝕刻、離子植入等方法，將電路及電路上的元件，在晶圓上製作出來；而完成後之晶圓再送往下游之 IC 封裝、測試廠(IC Assembly and Testing)，將加工完成的晶圓，經切割過後的晶粒，以塑膠、陶瓷或金屬包覆，保護晶粒以免受汙染且易於裝配，並達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果，最後進行 IC 功能、電性與散熱等測試。近年來由於台灣 IC 產業蓬勃發展及分工體系走向專業化，每一個生產環節皆有許多個別廠商投入，垂直分工明確且各有專精，使台灣 IC 產業之上、中、下游結構更加完整。茲將本公司所屬產業之上、中、下游之關聯性圖示如下：



資料來源：工研院電子所 ITIS 計畫

3. 產品及產業各種發展趨勢

半導體產品與總體經濟息息相關，以下彙整國際貨幣基金組織 (IMF)、歐盟統計局 (Eurostat)、各國統計機構及主要國際研究機構之最新報告，涵蓋以下發展狀況：

A. 全球總體經濟趨勢

根據大華銀行 (UOB Bank) 2026 年第二季全球預測及國際研究機構報告，2025 至 2026 年間全球經濟成長態勢分化，先進經濟體通膨逐步回穩，而新興市場則面臨較長之調整期。在「地緣經濟學」(Geonomics) 趨勢下，貿易政策對全球成長及投資流向之影響力已不遜於傳統市場動能，驅使供應鏈在地化進程持續加速。

就主要經濟體於 2026 年之 GDP 成長展望而言，美國預計成長 2.4% 至 2.8%、歐元區預計成長 1.3% 至 1.5%、日本預計成長 0.6% 至 1.2%、中國預計成長 4.5% 至 4.8%。台灣則受惠於 AI 科技相關產品出口表現強勁，2025 年 GDP 年增率大幅躍升至 8.5% 至 8.6%，創下數十年來最高水準，預估 2026 年之成長率將介於 3.3% 至 8.5% 區間。在通貨膨脹展望方面，預測 2026 年美國通膨率為 2.4%、歐元區為 1.9%、日本為 1.7%、中國為 0.5% 至 0.7%，台灣則預計維持於 1.3% 至 1.65% 之溫和區間。

整體而言，全球經濟前景雖面臨不確定性，但在 AI 驅動的科技投資熱潮持續延燒、各國產業政策積極支持半導體及先進製造業發展的背景下，科技與半導體產業仍是全球經濟最重要的成長引擎。產業補貼、貿易關稅及利率政策的變動，可能影響央行貨幣政策的調整步伐，進而對財政可持續性與金融穩定帶來挑戰；然而，隨著通膨壓力逐步緩解，主要經濟體政策調整的空間擴大，市場可望在中長期內回歸穩定成長軌道，帶動投資信心回升。

B. 美國總體經濟趨勢

根據美國商務部經濟分析局 (BEA) 資料，2025 年美國實質 GDP 成長率為 2.1%，維持穩健擴張態勢，惟整體成長動能較前期趨緩。展望 2026 年，多家機構

預估美國 GDP 成長率介於 2.4%至 2.8%之間。就通膨與貨幣政策而言，美國聯準會於 2025 年共三度降息，累計調降 75 個基點，預計於 2026 年 9 月前達到終端利率區間 2.75%至 3.00%；2025 年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.7%，預計 2026 年底降至 2.4%附近。就業市場方面，2025 年非農就業新增僅 58.4 萬人，較 2024 年的 200 萬人大幅冷卻，預計 2026 年失業率將小幅上升至 4.4%。

就美國總體經濟而言，2025 年美國實質 GDP 成長率為 2.1%，維持穩健擴張，惟整體成長動能趨緩；展望 2026 年，GDP 成長率預計介於 2.4%至 2.8%之間。通膨方面，2025 年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.7%，預計至 2026 年底降至 2.4%。貨幣政策方面，聯準會 (Fed) 於 2025 年共三度降息，累計調降 75 個基點，預計於 2026 年 9 月前達到終端利率區間 2.75%至 3.00%。就業市場方面，2025 年非農就業新增僅 58.4 萬人，較 2024 年的 200 萬人大幅冷卻，預計 2026 年失業率將小幅上升至 4.4%。

製造業景氣方面，美國製造業採購經理人指數 (PMI) 於 2026 年 1 月重回擴張區間，終結長達近兩年的持續收縮，顯示製造業活動出現好轉跡象。貿易政策方面，美國於 2025 年 4 月宣布對所有貿易夥伴實施 10%「基準」對等關稅，並對特定國家課徵更高稅率，此舉造成市場顯著波動，亦帶動各國加速推動供應鏈多元化與在地化布局。整體而言，美國經濟雖展現一定韌性，但持續偏高的國債殖利率、借貸成本上升及關稅政策不確定性，仍是影響未來成長的主要風險因素。

半導體相關領域方面，美國受惠於 AI 基礎建設需求強勁，企業資本支出持續增加，帶動相關設備及材料需求回升。美國並透過《晶片與科學法》(CHIPS and Science Act) 持續推動半導體製造在地化，吸引台積電、英特爾、三星等國際大廠赴美設廠投資，進一步強化美國在先進半導體供應鏈中的戰略地位，惟建廠進度及人才供給仍為關鍵觀察指標。

C. 歐洲總體經濟趨勢

根據歐盟統計局 (Eurostat) 監測資料與研究機構預估，歐元區 (EA20) 2025 年實質 GDP 成長率約為 0.9% 至 1.5% 之間，展現一定程度之復甦韌性。就主要經濟體表現來看，西班牙成長動能較為顯著，法國與義大利維持溫和成長，德國則受能源成本與產業結構影響，成長表現相對承壓。

在製造業景氣方面，根據 S&P Global 與漢堡商業銀行 (HCOB) 聯合發佈之資料，歐元區製造業 PMI 於 2026 年 2 月升至 50.8，創下自 2022 年 6 月以來 (44 個月) 之最高水位，正式終結長達逾兩年半之收縮態勢。其中，德國製造業 PMI 回升至 50.7，為逾三年半以來首度重返擴張區間；受惠於新訂單強勁增長及外需恢復成長，加上國防與基礎建設支出擴張之推動，德國工業動能顯著轉強。此外，歐元區綜合 PMI 於 2026 年 2 月升至 51.9，顯示整體民間經濟活動維持擴張態勢。展望未來成長動能，歐盟委員會及 ECB 均預測歐元區 2026 年 GDP 成長率約為 1.2%，並於 2027 年回升至 1.4%；Conference Board 於 2026 年 3 月亦維持 1.3% 之成長預測，顯示市場對歐洲經濟復甦抱持穩健預期。

展望後續動能，隨歐洲中央銀行（ECB）貨幣政策逐步寬鬆，以及工資成長支撐實質消費回溫，歐元區內需市場有望持續改善。然而，中東地緣政治局勢、能源價格上行風險，以及美國對歐貿易政策之後續走向，仍為影響 2026 年歐洲經濟前景之主要不確定因素，市場成長幅度仍需審慎觀察。

D. 日本總體經濟趨勢

根據日本內閣府 2026 年 2 月發布之速報資料，日本 2025 年第四季實質 GDP 呈現微幅擴張，擺脫前期衰退困境，其中企業設備投資與政府支出為主要支撐動能。2025 年全年實質 GDP 成長率約為 1.2%，顯示日本經濟在外部貿易環境波動下仍維持正成長。展望 2026 年，受惠於薪資調升與財政擴張政策，市場預期成長動能將維持於 1.0% 左右水準。

日本物價壓力隨食品與能源價格趨緩而逐步降溫，2026 年 1 月核心 CPI（不含生鮮食品）降至 2.0%，回落至日本銀行預設目標。貨幣政策方面，日本銀行於 2025 年 12 月升息至 0.75%，市場普遍預期後續仍具備升息空間，長期終端利率估介於 1% 至 2.5% 區間。此外，2026 年春季勞資談判薪資漲幅預計達 5.2%，連續第三年維持於 5% 以上，有望帶動實質薪資轉正並支撐民間消費回溫。

日本製造業與服務業景氣表現強勁，2026 年 2 月製造業 PMI 升至 53.0，綜合 PMI 錄得 53.9，顯示民間經濟活動擴張速度加快，其中半導體與 AI 相關需求為主要驅動力。在產業政策上，日本政府持續推動半導體在地化，已承諾撥付專項補助予 Rapidus、台積電熊本廠及美光廣島廠。此外，日本議會於 2025 年 11 月通過大規模經濟振興方案，投入約 7.2 兆日圓於半導體、AI 及造船等戰略產業投資。

儘管內需與製造業動能相對正面，但外部環境仍存在不確定性。中國於 2026 年 1 月對日本加強鎢、稀土等關鍵金屬出口管制，對半導體供應鏈帶來短期衝擊。展望後續，日圓匯率走勢、能源進口成本及地緣政治引發之貿易摩擦，仍為影響日本出口與中長期成長之主要風險因素。

E. 中國總體經濟趨勢

根據統計數據顯示，中國大陸 2025 年全年實質 GDP 年增率為 5.0%，其中第四季受基期與外部環境影響，年增率回落至 4.5%。在工業產出方面，2025 年全年規模以上工業增加值成長率達 5.9%，且 12 月份單月成長動能顯著轉強，年增率回升至 5.2%。內需市場則呈現分化態勢。社會消費品零售額於 2025 年全年成長 3.7%，惟 12 月單月增幅收斂至 0.9%。投資端方面，房地產市場仍處於深度調整期，2025 年開發投資年減幅擴張至 17.2%，拖累整體固定資產投資成長率降至 -3.8%，民間投資部分亦呈現 -6.4% 之萎縮。

對外貿易表現展現一定韌性，2025 年 12 月單月貿易總額達 5,357 億美元，年增 3.9%，其中出口動能（年增 5.8%）顯著優於進口（年增 1.2%）。累計 2025 年全年出口成長率錄得 5.9%，有效抵銷部分內需疲弱之衝擊。物價與就業市場維持穩定，2025 年全年 CPI 表現與前一年度持平，12 月 CPI 年增率微幅上揚至 0.8%，顯示多數商品類別價格已逐步回穩。勞動市場部分，2025 年全國城鎮調查失業率

平均值為 5.2%，12 月單月穩定維持於 5.1% 之水位。

從領先指標觀察，製造業活動已展現回溫跡象，2025 年 12 月製造業 PMI 回升至 50.1%，除從業人員指標外，其餘分項指標均見改善。同月份非製造業 PMI 亦受惠於新訂單增加，指數回升至 50.2%，使整體商業活動已重回擴張區間。展望 2026 年，國際研究機構如 S&P Global 預估中國 GDP 成長率將落於 4.6% 區間，顯示市場對其經濟回穩抱持審慎樂觀之預期。

F. 台灣總體經濟趨勢

台灣在全球 AI 產業鏈中扮演核心樞紐角色。受惠於人工智慧與高效能運算（HPC）需求之強勁成長，根據大華銀行（UOB）最新報告，2025 年台灣實質 GDP 年增率大幅躍升至 8.5% 至 8.6% 區間，創下數十年來之最高水位。展望 2026 年，受惠於科技應用持續擴張，成長動能預期將維持穩健，預估成長率將介於 3.3% 至 8.5% 之間。在對外貿易方面，2025 年出口表現亮眼，其中 AI 與相關科技產品之出口年增幅高達 35%。特別是對美出口受惠於供應鏈重組與技術需求帶動，於 2025 年底呈現爆發式成長，年增率高達 125.9%，進一步鞏固台灣在全球供應鏈之戰略地位。進入 2026 年初，雖受季節性因素與農曆春節工作天數影響使短期數據有所波動，但資通訊與視聽產品之商機熱度依舊，帶動整體出超金額維持高檔。

製造業景氣呈現持續擴張態勢，根據 S&P Global 最新調查，台灣製造業採購經理人指數（PMI）於 2026 年初升至 51.7，錄得自 2025 年 1 月以來之最高紀錄，顯示產業活動維持熱絡。在物價與金融環境部分，台灣通膨壓力相對溫和，預計維持於 1.3% 至 1.65% 之區間。中央銀行為維持融資環境穩定，預期將政策利率維持在 2.0% 之水位至 2026 年底，有助於企業進行長期資金規劃與投資布局。

為深化台美科技與貿易合作，台灣持續擴大對美直接投資，其中涵蓋先進製程產能布局等重大項目。透過雙邊貿易合作備忘錄（MOU）之強化，台灣積極爭取優惠貿易待遇，以有效緩解潛在貿易壁壘之衝擊。

整體而言，台灣半導體產業在 AI 浪潮引領下，持續領先全球先進製程與先進封裝領域，並帶動半導體設備及材料供應鏈之群聚效應。然鑑於經濟高度仰賴出口及特定客群，全球貿易政策之變動與地緣政治風險仍為關鍵觀察指標。此外，勞動力供給與土地資源等生產要素之穩定供應，亦需仰賴政策持續支持，以確保半導體產業之長期競爭優勢。

4. 產業競爭情形

半導體晶圓產業因資本與技術高度密集，整體進入門檻仍相當明顯，本公司亦持續位於全球主要晶圓供應商之列。產業面上，2025 年需求呈現兩極化，AI 及相關先進製程需求強勁，而汽車與手機等非 AI 應用則相對疲弱；不過自 2026 年起市場已逐步出現擴散式改善，包括電源管理等非 AI 應用已有逐步回溫跡象，整體需求結構較前一年更為健康。

在產品方面，12 吋先進製程晶圓持續維持高稼動，並受 AI、HPC 與先進封裝推

動而成為最主要成長來源。成熟製程方面，8 吋產能依應用別不同，呈現不均衡的復甦跡象，特殊晶圓如 SOI、FZ 及部分化合物半導體產品之需求動能仍穩定，其中 GaN 產能維持滿載，而 SiC 在 6 吋與 8 吋節點市場競爭激烈，不過近期已逐步出現局部回溫跡象，仍需觀察此動能是否可延續。

整體而言，產業競爭仍聚焦於技術能力、產品組合、全球產能配置與客戶認證速度等面向。本公司於亞洲、美國與歐洲布局多區域產能，具備從長晶到磊晶的一貫製程，有助於因應在地化製造與不同市場政策環境，提升供應鏈彈性，並於市場逐步復甦的環境下保持競爭優勢。

(三)技術及研發概況

本公司成立以來致力於矽晶圓材料長晶及精密加工製程之改善，亦透過與學術及研究機構之交流與合作，快速提升新技術與新產品之開發能量，在製程技術發展、新產品技術研發、以及客戶認證評估上達成許多重要的指標。我們不只通過了世界頂尖客戶在尖端製程的評估，更榮獲許多重要客戶頒發最佳供應商，客戶的肯定顯示了環球晶圓在研發技術上的成功。在新產品開發方面則達到前所未有的里程碑，例如高功率元件 IC 上使用的重摻超低阻半導體、應用於通訊上使用之 RFSOI、次世代寬能隙材料 GaN on silicon 及 SiC 晶圓、先進封裝應用的客製化特殊晶圓等。除此之外，環球晶圓也積極進行專利佈局以保護公司的智慧財產權，截至 2025 年 12 月 31 日，集團有效專利申請量已達到 2,737 件(包含 1,808 件已經獲證及 929 件申請中)。

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目/年度	113 年度	114 年度
研發費用	2,317,220	2,217,644
營業收入淨額	62,626,004	60,597,938
研發費用占營收淨額之比例(%)	3.70	3.66

2. 最近年度開發成功之技術或產品

年度	技術或產品名稱
113	1. 第 3 代 PVT 碳化矽長晶爐 2. 低損耗碳化矽晶圓切割技術開發 3. 矽長晶斷線自動辨識系統開發 4. 矽長晶自動摻雜裝置開發 5. 高效節能冰水冷卻系統開發 6. 低材料損耗研磨製程開發 7. 第 3 代低能耗長晶熱場開發 8. 運用於 2 奈米製程用矽晶圓超高潔淨清洗技術開發
114	1. 12 吋方形矽晶片 2. 12 吋散熱應用碳化矽晶圓

<ul style="list-style-type: none"> 3. 12 吋碳化矽晶圓切割技術 4. 大尺寸碳化矽晶圓平坦化技術 5. 廢棄切割漿料回收再利用技術 6. 拋光液循環優化技術 7. 即時營運可視化與派工自動化平台系統開發 8. 影像邊緣量測自動回授系統開發 9. 大尺寸熱場跨徑設計開發 10. 研磨形貌控制自動回授系統 11. 奈米尺度表面形貌控制技術

(四)長、短期業務發展計畫

1. 長期計畫

- A. 運用集團尖端之領先技術開發符合次世代產品運用之 GaN/Si/SiC 晶片，朝向大尺寸重摻長晶及功率半導體磊晶技術發展，成為全球規模最大且產品完整性最高的半導體晶圓供應商。
- B. 因應客戶未來需求，持續開發下一代長晶及拋光技術，持續保持在先進製程領先的地位。
- C. 建立集團內跨部門合作，整合 LNO，SOI，SiC，Si，Solar-Si 等資源切入 2D/2.5D/3D 封裝及矽光子與異質整合所需要之特用晶體與晶圓。
- D. 落實綠色製造、實踐企業社會責任、完備公司治理，建構永續經營基礎。
- E. 藉由採用再生能源、提升能源使用效率、碳清除與購買碳補償商品，達到 2040 年前 100% 使用再生能源，並配合遍布全球的生產營運據點，建構具有韌性及彈性的在地供應鏈，建立多元供應商，敏捷因應疫情及地緣政治緊張情勢，並降低環境衝擊，提供客戶碳哩程較短的低碳晶圓。
- F. 透過擴產以增加營運規模，同時緊密掌握產業動向、積極爭取政府補助，提升在半導體晶圓產業的競爭力。
- G. 與重要合作夥伴積極簽訂長期合作計畫以鞏固合作基礎。

2. 短期計畫

- A. 加強與下游客戶的研發連結，以核心技術能力開發高效率之利基產品，並積極降低製造成本，以增加獲利空間。
- B. 加速提昇 12 吋矽晶圓、化合物半導體及特殊晶圓(FZ, SOI)生產效能，提高全球市佔率。
- C. 結合集團內技術、資源與各種可能性，優化各廠區瓶頸站點並極大化產品產能，深化跨國技術整合平臺，全面提升技術能力、產品品質及客戶滿意度，以滿足市場需求。
- D. 穩定關鍵原料與零件供應來源，確保良好生產品質與準時達交，使生產線順暢運行。

- E. 運用現有客戶網絡，擴大新產品的客戶基礎，提高產線的產能利用率，提升產品的獲利能力。
- F. 廣泛產官學合作，佈局利基型應用先進製程，快速提升新技術之開發能量。
- G. 密切掌握市場趨勢及產業脈動並適時調整經營策略，持續研發高附加價值產品並進行專利保護措施，以強化自身的企業競爭力。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

地區別		113 年度		114 年度	
		銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
內銷		12,862,361	20.5%	12,679,950	20.92%
外銷	亞洲	26,845,305	42.9%	26,017,894	42.94%
	美洲	8,364,285	13.3%	9,263,448	15.29%
	歐洲	14,324,330	22.9%	12,490,457	20.61%
	其他	229,723	0.4%	146,189	0.24%
合計		62,626,004	100.00%	60,597,938	100.00%

2. 市場佔有率

依據同業公布財報數字推估，本公司之出貨佔世界半導體晶圓製造商之 15~20%，排名第三；半導體晶圓產業有集中化及整合之趨勢，前五大廠商合計市佔率超過 90%，分別為日本信越(Shin-Etsu)、日本 Sumco、環球晶圓 GWC、德國 Siltronic AG、及韓國 SK Siltron，本公司於世界排名第三，營運穩定成長，期能在完整產品布局規畫下持續開拓市場並逐步提升市佔率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

根據國際半導體產業協會 (SEMI) 發布之最新預測報告，受惠於高效能運算 (HPC) 架構演進及邊緣運算中生成式 AI 滲透率之持續攀升，全球半導體產能維持穩健擴張。預計至 2026 年，全球晶圓月產能 (wpm) 將突破 3,500 萬片大關，年成長率維持於 6.0% 以上之水準。為因應大型語言模型 (LLM) 對算力之高度需求，晶片領先廠商持續擴增 7 奈米及以下之先進製程產能，預期該領域於 2026 年將展現約 15% 至 17% 之強勁成長力道。

晶圓代工領域仍為整體產業產能擴張之核心引擎。受惠於先進製程與特種製程需求同步走強，預計 2026 年晶圓代工月產能將由 2025 年之 1,260 萬片進一步提升至約 1,400 萬片，續創歷史新高。在記憶體市場方面，受惠於生成式 AI 對高頻寬記憶體 (HBM) 之結構性需求，HBM 產能將以超過 30% 之複合年增率持續擴張，並帶動高階 DRAM (如 DDR5 與 LPDDR5X) 之技術迭代，進而推升對極高平整度與低缺陷率矽晶圓之需求。在快閃記憶體方面，3D NAND 產能布局已全面轉向超高層數技術

(300層以上)與 QLC 高密度方案，以因應 AI 推理伺服器對大規模資料讀取之存儲效能要求。預估 2026 年整體記憶體產能將維持穩定成長，並透過製程優化與先進堆疊技術，支撐全球智慧化應用之長期發展。。

SEMI 分析指出，全球半導體產業正處於技術迭代之關鍵期，擴產投資不僅集中於先進邏輯與高階記憶體，主流製程亦在車用電子、物聯網 (IoT) 及功率元件等領域發揮關鍵支撐作用。

此外，本公司具備多元化之客戶基礎，終端應用廣泛涵蓋車用、電源管理、記憶體等關鍵領域，具備高度之市場波動抵禦能力。隨終端市場需求持續演進，以及新技術應用對高品質矽晶圓之需求不斷攀升，本公司將憑藉領先之技術優勢與穩定供應能力，持續優化產品組合，確保營運之穩健成長，並為全球半導體產業提供卓越之解決方案。

4. 競爭利基

A. 產業經驗豐富之經營及技術研發團隊

本公司自成立以來，持續投入先進半導體晶圓領域相關之技術開發與研究，主要研發人員及經營階層於半導體產業皆有多年以上之工作經驗，累積相關豐富之經驗，洞悉半導體產業趨勢，並對市場需求充分掌握，使得本公司能夠配合客戶需求適時開發關鍵技術，有助於客戶訂單之爭取。

B. 擁有先進製程技術

本公司致力於矽晶圓材料長晶及精密加工製程之改善，亦透過與國內外多個學術及研究機構之交流與合作，快速提升新技術與新產品之開發能量。歷經多年投入「單晶矽晶體成長技術及晶圓精密加工技術」與「矽磊晶沈積技術及 SOI 晶圓接合技術」之開發，不管在單晶生產力的提高、晶體阻值的降低、晶體缺陷密度的控制、晶體品質的提高、氫氣用量的減少、晶圓平坦度提升、原子級拋光晶圓表面處理技術、同質/異質磊晶技術、同質/異質晶圓接合技術、晶圓強度提升厚度下降、電用量之減少、耗水量降低、物料用量的降低、廢棄物排放減量…等皆已達到或超越國際指標，多項技術指標更成為國際上的標竿。

本公司多年來投入化合物半導體產品開發，具備碳化矽長晶爐自製與熱場設計能力，透過長晶設備與長晶製程的整合達成在晶體品質與競爭者相比具差異化。而碳化矽晶圓加工技術在矽晶圓的技術基礎上開發出比傳統碳化矽晶圓製造商更具競爭力的製程。同時透過技術整合並搭配集團碳化矽磊晶的垂直整合，通過 Tier 1 的客戶認證量產出貨。在全製程技術整合與客戶深度合作下提供客製化產品使碳化矽晶圓品質成為業界的標竿。而氮化鎵磊晶片在差異化的策略上，在技術長期累積與客戶策略合作下，提供客製化氮化鎵磊晶片成為客戶主要供應商。

除此之外，環球晶圓也積極進行專利佈局以保護公司的智慧財產權，截至 2025 年 12 月 31 日，集團有效專利申請量已達到 2,737 件 (包含 1,808 件已經獲證及 929 件申請中)，研發成果亮麗並獲得國際客戶的肯定。

C. 具規模產能、產能調度彈性及規模經濟競爭能力

本公司自成立以來，專注於半導體晶圓領域相關之技術與生產研發，生產基地橫跨美洲、歐洲及亞洲，總計擁有 18 處營運生產基地坐落於全球 9 個國家，其產能已達經濟規模。而工程師與生產線人員在製程與操作技術成熟，加上本公司有效管理製程且分散式之多樣化經營策略，使得生產效率大幅提升，單位成本亦相對降低。

D. 與客戶建立長期緊密夥伴關係

本公司提供核心技術產品全程製造之完整服務予客戶，在精密加工技術、產品品質及交期服務均能滿足客戶的需求，故本公司目前已獲得多家國內外半導體大廠之認證肯定，而半導體大廠基於技術保密、品質及共事默契考量，傾向與供應商維繫長久合作，顯示本公司與客戶已建立長期緊密夥伴關係。此外，本公司除繼續與現有客戶維持良好關係，未來將利用先進製程技術之基礎，致力於開發新客戶，有助於本公司未來的營運發展。

E. 產品多元化

本公司為專業之半導體晶圓製造商，具拉晶、切片、研磨、拋光、清洗與磊晶全製程之 3 吋~12 吋矽晶圓產品線，產品光譜廣泛，橫跨磊晶片、拋光片、退火片、擴散片、SOI、FZ 晶圓...等，另外更跨足 SiC、GaN 等化合物半導體。本公司依不同的客戶需求，提供客戶一套完整的解決方案與客製化的服務，由於產品品質穩定、效能佳、產品線完整及快速的研發設計彈性，使本公司在市場上持續保有領先競爭優勢。

F. 穩健之財務結構

大者恆大為半導體業未來發展趨勢之一，本公司擁有充足之現金流及健全資產負債結構，能夠確保本公司持續穩健投資及發展，亦為半導體產業不景氣時，維持營運穩定度之關鍵，因此穩健財務結構為本公司與客戶長期合作與共同成長之重要基礎，亦為本公司競爭利基之一。

G. 高度區域化的全球營運據點

本公司 18 處營運生產基地坐落於全球 9 個國家，待美國新廠完成後，在美洲、亞洲及歐洲將擁有長晶到磊晶的一貫製程，對客戶而言是當地的本土供應商，能就近滿足需求，在地供應可減輕地緣政治及總體經濟的變動影響。

H. 綠色永續

在半導體晶圓產業中，綠色永續已成為企業競爭力的重要成功要素，不僅因應全球碳中和趨勢，更直接影響供應鏈穩定與客戶長期合作意願。

●全球據點布局與碳關稅風險管理

本公司遍布三洲九國十八個營運據點，採取就近供應策略，有效降低長途運輸碳排放與環境成本，同時降低被各國徵收碳關稅的風險，展現高度區域化供應鏈優勢。

●再生能源承諾與行動

RE100 承諾：本公司 2021 年自主宣布 2050 年達成 100%使用再生能源，並於 2022 年正式加入 RE100。最新目標進一步加速，預計 2040 年全面達成 100%使用再生能源，展現永續決心。

●能源藍圖

台灣及海外據點持續擴建自建太陽能發電案場；簽訂購電協議 (PPA) 與購買再生能源憑證 (RECs)，確保綠電供應穩定；母公司中美矽晶以「綠色能源全方位供應商」角色，協助集團興建太陽能電廠，提升綠電自給率。

●新廠節能與碳管理

集團新建廠區在興建階段即導入高效能空調、智慧照明、製程熱能回收等節能設備，並積極採用再生能源。美國子公司 MEME LLC 與義大利子公司 Novara 廠新產線，以及美國子公司 GlobalWafers America, LLC 新廠量產階段將全面使用綠電，製程用水回收率將達 50%，符合歐盟永續標準。

5. 發展遠景之有利與不利因素

A. 有利因素

(a)資本及技術密集度高，進入門檻較高

半導體產業是資本與技術密集的工業，由於半導體產業所需之生產機台昂貴、IDM 委外代工訂單趨增及產品技術變化快速，需要投入之資本支出越發龐大。另半導體之技術密集度高，其製程技術與產品產出良率決定生產成本高低，而研發人才與製程技術具有密切關係，但研發專業人才培養及延攬不易，加上產品需經過客戶認證後方能取得訂單，造成新競爭者有較高之進入門檻。本公司擁有優秀技術研發團隊，在產業深耕多年，實務經驗豐富，充份掌握半導體晶圓趨勢與需求，且本集團已達經濟規模，產品製程技術亦取得國際大廠之信賴及品質認證，顯示本集團具有市場競爭力。

(b)半導體市場新技術串連各式應用，優質半導體晶圓需求增高

由智慧家電、穿戴式裝置與智慧城市所形成的物聯網技術持續發展，成為驅動半導體營收的一大動力，而5G也將啟動新型態行動網路世界、改變無線通訊的面貌。5G、AI、IoT等新技術發展將串連原本各自為政的消費性電子、行動裝置、網路通訊設備及電腦應用等個別市場，創新科技所奠基於先進製程，而先進製程需要品質更佳、規格更高的半導體晶圓做為關鍵的基板材料，尤其以8吋、12吋矽晶圓及化合物半導體需求更為顯著，因此全球矽晶圓材料之需求將維持不輟。

(c)產品發展符合市場需求

由於目前前五大半導體晶圓製造商以記憶體等標準應用為主，競爭激烈且擠壓獲利空間，而本集團不僅可提供客戶 3~12 吋全系列矽晶圓產品及全製程(拉晶、切片、研磨、拋光、清洗、退火、磊晶等)，以及特殊晶圓、化合物半導體之服務，並聚焦於利基型市場，且本集團積極佈局先進製程應用，與半導體產業未來發展趨勢相符，產品線完整，故未來仍具有成長空間。

(d)遍布全球的生產營運據點，建構具有韌性及彈性的在地供應鏈

本公司 18 處營運生產基地坐落於全球 9 個國家，在美洲、亞洲及歐洲擁有長晶到磊晶的一貫製程，能就近滿足客戶需求，在地供應可減輕地緣政治及總體經濟的變動影響，並降低環境衝擊，提供客戶碳哩程較短的綠色晶圓。

B. 不利因素及因應對策

(a)半導體產業之景氣波動

本公司為半導體晶圓之專業生產廠商，屬半導體產業鏈之上游，主要客戶除半導體製造廠、晶圓代工廠外，亦包含整合元件製造商及車用電子廠商等，由於晶圓係製造半導體元件不可或缺的關鍵基礎材料，因此公司營運狀況與半導體產業景氣息息相關。

因應對策：

本公司為全球第三大半導體晶圓廠，產品線涵蓋 3 吋至 12 吋，具有相當的經濟規模與市場地位，終端產品應用領域廣泛，特別是在車用及電源裝置等利基型市場表現突出，且本公司及子公司技術人才均已在半導體產業深耕多年，技術實力堅強，可藉由核心技術的運用，搭配本身技術整合及開發能力，提供完整且符合市場與客戶需求之多元化產品，並與現有客戶建立長期穩定之夥伴關係，使產能獲得充分而穩定之利用，降低景氣循環的風險。再者，本公司生產基地橫跨歐洲、美洲及亞洲等地，除可藉由採購、銷售集中化，降低營運成本外，並可充分利用各生產基地的優勢，靈活調度生產排程，因應來自市場波動的不利因素。

我們亦與許多客戶簽定長期合作合約，以確保公司訂單不因景氣波動而受到影響。環球晶圓與客戶是長期合作夥伴，為了鞏固產能以因應未來的創新科技需求，客戶藉由簽定長約藉以鞏固料源，同時也助於環球晶圓穩定生產。

(b)國際情勢變化

近年來國際情勢變化劇烈，地區性貿易衝突、俄烏戰爭與以巴戰爭等軍事衝突，以及關稅政策對總體經濟帶來不小震盪。

因應對策：

本公司在全球各地皆設有生產據點，將彈性調度生產以因應相關法規，將降低貿易關稅對營運成本之影響；遍佈全球各區域的客戶也能有效分散國際情勢及地域性事件對營收帶來的衝擊，降低單一地區的經濟風險。

(c) 關鍵原料短缺風險

隨著半導體產業蓬勃發展，對晶圓的需求增加，運輸系統亦受國際衝突情勢影響，供應商若無法適時配合或出貨受阻，將造成原料短缺導致無法生產之情形。

因應對策：

本公司之主要原料-多晶矽，係向世界知名大廠採購，並且簽訂供貨合約，以確保供料品質穩定及供應量充足。另外，避免過度仰賴單一供應商的斷鏈風險，本公司為關鍵原物料建立複數供應商，供應鏈管理部門時時注意最新情勢、機動安排運輸路線。本公司並邀請供應商加入永續行列、生產低碳綠色產品，以避免缺料或生產中斷，也更可符合客戶及各國對於低碳排的標準。

(d) 匯率風險

本公司目前在歐洲、美洲及亞洲均有生產據點，人工、水電等製造費用均係以當地幣別支付，而在銷售端則除了部份當地客戶係以當地幣別計價外，其餘客戶多為美金計價，因此美金對上述貨幣匯率大幅波動時，亦將影響本公司營運成本。

因應對策：

由於外部經濟及匯率變化情勢複雜，本公司以採負債及資產部位互抵之自然避險為原則，盡量降低曝露於匯率波動風險下之淨部位，並由財務單位密切觀察匯率之走勢，必要時搭配以避險為目的之外匯操作工具，降低匯率波動對營運成本之影響。

(e) 競爭者加入

近年陸續有半導體晶圓廠加入競爭，加上中國積極扶植其國內半導體產業，市場競爭越形激烈。

因應對策：

半導體產業是資本與技術高度密集的工業，由於所需之生產機台昂貴且產品技術變化快速，資本支出越發龐大，研發專業人才培養及延攬更是不易，加以產品需經過客戶認證後方能取得訂單，故進入門檻極高。本公司擁有優秀技術研發團隊，在產業深耕多年，充份掌握半導體晶圓趨勢與需求，產能也已在全球供應商中名列前茅，產品製程技術亦取得國際大廠之信賴及品質認證，相較新加入之競爭者具有相當的競爭優勢，本公司將持續強化其競爭利基，以保持領先地位。

(f) 氣候變遷

極端氣候出現的頻率日益增加，帶來乾旱缺水隱憂，酷熱氣候亦使用電量增加。半導體製程用水量高，亦仰賴穩定的電力供應，若供水及供電不足，恐影響生產。

因應對策：

本公司深刻了解氣候變遷對於營運環境的衝擊和限制，在制定營運決策時便評估風險範疇，並納入考量，迅速實施緊急應變計畫以對抗氣候衝擊、避免生產中斷，更持續穩定供應全球客戶。本公司致力於優化現有設備，同時也導入各項節能措施，以對環境更友善的方式生產。另外，本公司擁有數座太陽能電廠，各國子公司亦配合當地能源政策採用綠色能源，致力提升綠色電力的占比。

(g) ESG 及碳關稅

因應氣候變遷、各國紛紛制定不同的碳關稅、以遏止企業在生產過程中的碳排放，許多客戶也要求供應商承諾加入永續供應鏈，企業除了生產成本因而增加，產品的製造過程也必須符合低碳排的要求。

因應對策：

本公司擁有 9 國 18 個生產營運據點，高度區域化的特點讓環球晶圓被三大洲的客戶都視為本土供應商，就近供應可以大幅減少產品的碳哩程，同時降低被各國徵收碳關稅的可能性。另外，本公司於 2021 年即自主宣布全集團將於 2050 年實踐 100% 使用再生能源的目標，並於 2022 年正式加入 RE100 倡議組織，最新目標進一步加速，預計 2040 年全面達成 100% 使用再生能源，展現永續決心。在能源藍圖方面，藉由自建太陽能發電案場，簽訂購電協議(Power Purchase Agreement; PPA)與購買再生能源憑證(Renewable Energy Certificates; RECs)，母公司中美矽晶作為綠色能源全方位供應商(Green Energy Total Solution Provider)，利用其豐富經驗與垂直整合供應鏈優勢、協助集團興建太陽能電廠以增加綠色能源發電量。新蓋的廠區在興建時期便導入各項節能設備及方案以降低能耗、並積極使用再生能源，本公司火以永續和高度區域化的獨特優勢成為客戶的長期夥伴。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品重要用途

產品名稱	重要用途說明
半導體晶圓	為半導體元件之最主要材料，經過不同製程如拋光、擴散、曝光、蝕刻等，以及後段如：組裝、測試等方式成為分離式元件、積體電路及光電元件所需之材料。運用於二極體、整流器、電晶體、TVS、閘流體、MOSFET 等半導體分離式元件、MEMS、Power Device (功率半導體)及消費性 IC、LOGIC IC 等積體電路及光電元件。

2.產製過程：

晶圓製程

矽原料/化合物半導體原料→長晶→切斷→圓磨→切片→粗晶片清洗→熱處理
→圓邊→研磨→平晶片清洗→檢驗→成品包裝

拋光製程

晶片研磨→浸蝕→拋光前檢驗→晶片拋光→預清洗→檢驗→最終清洗→晶片
表面掃瞄→檢驗→晶片包裝

(三)主要原料之供應狀況

產品項目	主要原料	主要供應商	供應狀況
半導體晶圓	矽原料	d 公司	良好

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	d 公司	2,495,771	14.4%	無	d 公司	3,674,951	22.79%	無
2	g 公司	1,760,498	10.1%	母公司				
	其他	13,120,926	75.5%		其他	12,452,898	77.21%	其他
	進貨淨額	17,377,195	100.0%		進貨淨額	16,127,848	100.00%	

增減變動說明：

本公司及子公司主要從事半導體材料之製造及銷售等業務，其主要原料為矽，兩期供應商排名因內部策略調整而有變動。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	C 公司	8,160,987	13.0%	無	C 公司	7,271,558	12.0%	無
2	K 公司	6,713,028	10.7%	無	K 公司	6,621,172	10.9%	無
	其他	47,751,989	76.3%		其他	46,705,208	77.1%	
	銷貨淨額	62,626,004	100.0%		銷貨淨額	60,597,938	100.0%	

增減變動說明：

本公司及子公司主要從事半導體材料之製造及銷售等業務，其產品主要為半導體晶棒及客製化之半導體晶圓，其主要客戶多為半導體元件大廠，最近兩年度之主要銷售客戶排名並無重大變化。

三、從業員工資訊

年度		113 年度	114 年度	115 年 3 月 31 日
員工人數	直接	4,222	4,227	4,087
	間接	2,976	2,834	2,997
	合計	7,198	7,061	7,084
平均年齡		42.81	42.92	42.75
平均服務年資(年)		14.32	14.34	14.39
學歷分布比率(%)	博士	1.072%	1.107%	1.103%
	碩士	8.392%	8.771%	8.742%
	大專	27.842%	31.172%	31.986%
	高中(含以下)	62.694%	58.950%	58.169%

四、環保支出資訊

- 最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

處分日期	裁處書字號	裁罰金額	裁罰廠址	違反情事	改善措施
114 年 8 月 20 日	府環水字第 1140044643 號	NT\$10,000	環球晶圓 竹南廠	違反《水污染防治法》第 18 條及《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第 4 條之規定，未依核准之水污染防治措施內容運作	<p>矯正措施：確認現況後執行水污染防治措施計畫變更申請並取得核發許可文件，確保實際作業與許可文件一致。</p> <p>預防措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 廠務單位每日抄表監控，遇異常立即通報產線端採取水量管制，確保不超出許可限值。 2. 安衛單位每月依據廠務用水量異常回報資料，滾動式評估產線水量需求，提早啟動申請水污染防治措施計畫變更。
114 年 5 月 16 日	-	US\$280	韓國子公司 天安工廠	違反《廢棄物清理法》第 18 條第 3 項，未於規定期限內申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用及輸出入情形	優化內部的廢棄物清理流向程序，以防止任何移轉與收受紀錄發生遺漏。

2. 本公司除落實既有設備的日常維護與優化管理外，亦持續投入資源提升廢水與廢氣處理等環保防治設備之處理效能，以降低對環境的影響，同時也不斷探索更佳的節能及廢棄物再利用及處理方式，期望在兼顧生產效率與環境保護的前提下，實現更具永續性的經營目標，為綠色未來貢獻一己之力。本公司環保支出及效益相關資訊請參閱本公司永續報告書「第四章、永續環境／4.7 環保支出」。

五、勞資關係

- (一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施

- (1)提供優質的薪資待遇及公平公正的獎勵辦法、晉升辦法以肯定所有同仁對公司的貢獻與付出。本公司員工除享有勞保、健保、團保、退休金給付等一般福利外，由公司提供之福利包括發給年節獎金、生日及節慶禮金、舉辦年終晚會、婚喪喜慶、國內外旅遊、急難救助、獎學金補助、生育補助、提供團膳、及提供完整之教育訓練講習等。自 110 年起，亦增加員工福利儲蓄信託，員工可自行評估加入與否，參與者則依照個人提撥金額給予 100%的獎勵金。
- (2)以每月營業額 0.07%及出售下腳收入 40%提撥至職工福利委員會，職工福利委員會由委員依相關法規運作。
- (3)本公司充分體認所有員工健康攸關工作效率與士氣，期望藉由對員工的關懷，創造安心工作的環境。自 109 年起，建置員工關懷方案 (Employee Caring Program)，透過組成跨部門的小組，制訂整體規劃，以規劃工作、健康、生活、福利四個面向的子方案提供員工，提升整體員工福利。

2. 員工進修及訓練

本公司提供多元化訓練課程、各項專業在職教育訓練及自我成長課程，其中包括新進人員訓練、智財課程、在職訓練課程、勞工安全衛生教育訓練、專業課程以及各種與職務有關之外派訓練課程，以培養富有專業能力並兼具挑戰性之人才。

3. 退休制度與實施情形

- (1)同仁退休分為：自願退休及強制退休兩種。

自願退休：工作 15 年以上年滿 55 歲者、工作 25 年以上者或工作 10 年以上年滿 60 歲者。

強制退休：民國 97 年 5 月 14 日起年滿 65 歲者或身心障礙不堪勝任工作者，公司得強制其退休。

- (2)年資計算：自到職日起算；除服役外，留職停薪期間之年資應予扣除。

- (3)退休金給付標準：

舊制：按服務年資每滿一年給與兩個基數。超過 15 年之服務年資，每滿一年給與一個基數，但最高以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計。凡強制退休之勞工，如身心障礙係因執行職務所致者，則其退休金基數依前款規定加給百分之二十。

新制：民國九十四年七月以後選擇新制者，民國九十四年七月以前年資以舊制計算，民國九十四年七月後年資以新制計算。

(4)民國九十四年七月以後到職者依新制計算（雇主每月提撥薪資 6%存至勞保局之個人戶頭）。

4. 工作環境與員工人身安全之保護措施

本公司依職業安全衛生法成立「安全衛生管理單位」，設置職業安全衛生業務管理人員，並制定「職業安全衛生管理準則」，有關廠區工作環境與員工人身安全健康防護主要內容概述如下：

(1)工作環境規定與措施

- 工作人員應隨時注意自我身心健康調適，養成良好衛生習慣。
- 工作場所應適時整理整頓，經常保持整齊清潔。
- 廠內工作嚴禁抽煙、吃檳榔與飲用酒精性飲料。
- 吸煙應在規定之吸煙室內且不得隨意丟棄煙蒂。
- 處置危害物時應正確使用相關防護具。
- 危害物應確實標示並不得任意毀損。
- 工作場所內適當處所應設置符合飲用水標準之飲水設備，定期清洗並進行水質檢測。
- 每年進行全廠區之消毒工作。
- 廁所應保持良好通風，並清洗消毒。
- 全體員工必保持廠區 6S 環境整潔衛生，養成良好習慣。
- 不隨地吐痰、便溺、不亂丟煙蒂，不隨地亂丟垃圾。

(2)員工人身安全之保護

- 從事各項工作均應遵循有關安全標準、作業程序書及工作程序安全檢核表施作及檢核。
- 臨時性或非經常性作業無該類安全標準可依循者，不可貿然著手，應活用既有安全作業標準再與工作負責人會商討論後決定應採行之安全步驟及方法。
- 從事高度二公尺以上之高架作業或作業中有物體飛落或飛散等及現檢點、督導人員均應確實戴用安全帽並繫妥帽帶。
- 在未設平台及護欄且高度離地二公尺以上之管、塔、架上或工作場所邊緣及開口部分作業時，應正確使用安全帶及輔助繩或安全繩索。
- 變電設備或廠區實施部分停電作業時，應將該停電作業範圍以鐵網或施工警示帶等予以加圍、隔離，分別懸掛「停電作業」或「有電危險」之標示，以茲警示。作業完成後應先確認從事作業之員工已離開且無感電之虞，始得拆除。
- 工作時應依各站規定穿戴個人防護器具，若發現有不安全狀況、設備和作業方式，應立即報告。
- 工作中禁止追逐、戲謔或其他不安全行為。
- 機具使用不得超過最高使用負荷。

5. 勞資協調之情形

本公司之各項規定皆依勞動基準法為遵循準則，並依勞資會議實施辦法，定期舉辦勞資會議。勞資關係一向相當和諧，溝通管道暢通，同時透過勞資會議及職工福利委員會共同討論，協商勞資雙方互利互惠等事宜，除了進一步了解彼此的需求與期

待外，本公司所有同仁更本著共存共榮之經營理念，共同努力創造公司未來。

6. 各項員工權益維護措施

本公司訂有完善的管理制度，載明各項管理辦法，內容明訂同仁權利義務及福利項目，並不定期檢討修訂福利內容，以維護所有同仁權益。

7. 派遣勞工或勞務承攬（委外）人員之勞動權益保護

為促進企業永續經營並落實社會責任，本公司針對派遣勞工及勞務承攬（委外）人員之使用，建立相關管理機制，以確保其勞動權益獲得保障，並提出以下承諾：

一、合作前評估機制

本公司於選擇派遣或勞務承攬廠商前，將透過以下方式進行評估：

- 要求廠商填寫勞動法遵聲明或相關自評問卷（如工時、薪資、保險制度）
 - 審查其過往勞動檢查紀錄或重大違規情形
 - 要求簽署本公司供應商行為準則或人權政策承諾書
- 並由人資、行政與採購及其他相關單位進行審核，作為合作與否之依據。

二、履約期間管理與稽核

於合作期間，本公司透過下列方式持續管理與監督：

- 定期或不定期檢視派遣及承攬人員之勞動條件（包含工時紀錄、薪資給付、保險投保及工作環境等）
- 視風險程度進行抽查或現場訪查
- 透過內部稽核機制或第三方稽核確認合規情形
- 提供申訴或反映管道（如員工申訴機制、HR 窗口）供派遣/承攬人員使用

三、異常處理與改善機制

如發現違反勞動法令或侵害勞工權益之情事，本公司將：

- 要求廠商提出改善計畫及完成期限
- 由相關單位持續追蹤改善進度及結果
- 必要時進行複查或加強稽核

對於未改善或情節重大者，得依契約終止合作關係，並列入未來合作評估之參考。

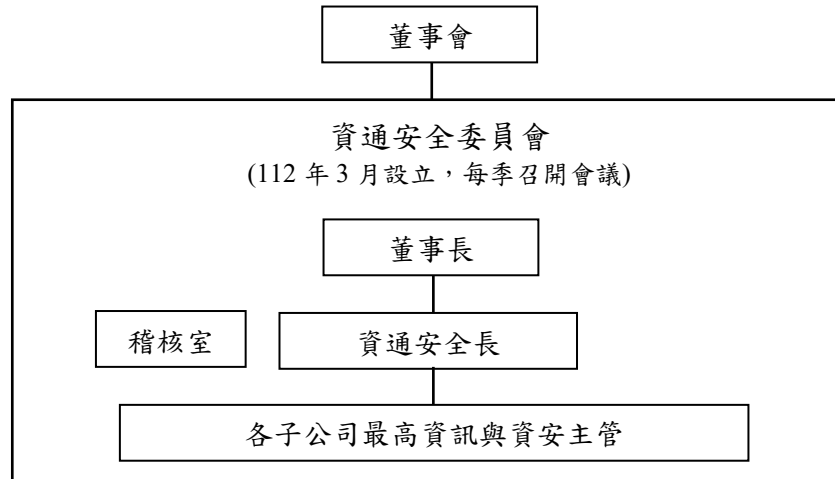
本公司（母公司台灣廠區）114 年度已依上述承諾，於派遣勞工及勞務承攬廠商合作前及履約期間，實際執行相關評估、管理與查核機制，以確保勞動條件符合法令規定並保障勞工權益，相關措施亦將持續推行並逐步擴及至其他廠區。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實；本公司勞資關係和諧，勞資爭議亦依照調解程序調解，最近年度及截至年報刊印日止，無因勞資糾紛所遭受之損失，亦無違反勞動法令而受罰鍰，並由法令遵循單位協助公司規章之制定與執行以符合勞動法令。

六、資通安全管理

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

資通安全組織架構



本公司於111年3月1日成立資通安全處，並於翌年召集集團各子公司資訊或資安最高主管設立資通安全委員會，透過每季召開資通安全委員會會議，海內外公司一同審核、交流資安風險與分析對應防護措施與策略，以統籌資通安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循。同時，為了積極推動資通安全政策，各子公司設立資通安全推動小組，由公司內部各單位代表出席，每季透過會議方式傳達公司資安方針與宣導事項。

本公司設有資安長(CISO)及資通安全組織，主導與規劃全公司資通安全作業執行以及資安風險管理機制之有效性、適用性與適切性，至少每年一次向董事會彙報資安管理成效及資安策略方向，並由具有電腦科學相關背景的徐秀蘭董事長督導整體資通安全管理組織相關資安管理作業及制度之執行成效，定期檢討修正。最近一次提報董事會日期為114年5月6日。

本公司資訊系統委由集團母公司（中美矽晶製品股份有限公司）代為管理，每年由稽核單位主導進行資訊系統暨資通安全檢視，並定期向董事會報告查核狀況。

為了能強化資訊安全與風險管理，本公司於113年9月導入資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS）ISO 27001:2022，系統化管理與保護資訊資產，並持續透過規劃、建立、執行與監督的循環機制，持續精進改善，確保資產的機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）以及可用性（Availability），目前證書有效期間為113年9月21日至116年9月21日。

資通安全政策

本公司訂有資通安全政策，並經董事會通過。資安策略主軸以「資安治理」

—依循資通安全政策管理辦法執行，適時引進新科技改善資安治理能力；「法令遵循」—定期檢視法令新規定，引進新科技產品增強資安管理；及「科技應用」—吸收產業新知與業界相關專業單位交流，以求改善資安治理能力等三方面進行，並緊密結合相互支持，透過不斷的改善優化來提升整體資安防禦能力。

在具體運作模式方面，採取 PDCA 循環模式，以確保目標之達成且持續改善、透過設立資訊安全監控系統弱點掃描預防外部駭客侵入與內部機密洩漏、資訊軟硬體設備控管（包含網際網路及個人資訊設備）以落實個人資料及內部保護機密資料安全。

資安風險管理與持續改善架構：



資安管理面向

資安具體管理方案分 3 大面向執行，以確保資安實務有效並降低風險：

1. 資訊系統安全管理

- 伺服器及個人電腦或筆記型電腦安裝端點防護軟體，並自動更新病毒或特徵碼。
- 郵件主機建置郵件安全閘道器，具備垃圾郵件過濾、惡意檔案偵測、釣魚郵件偵測等資安模組，提升藉由郵件發動攻擊的防護能力。
- 重要系統及資料庫，定期備份及異地存放，確保資料可用性。
- 定期執行資訊系統弱點掃描，修補系統漏洞。
- 公司電腦作業系統或伺服器，依照資安風險進行安全性更新。
- 內部網路設置防火牆並且設定防火牆規則，以保護重要資訊系統。
- 導入 EDR/MDR 系統，加強端點威脅偵測、分析與即時回應能力。
- 重要應用系統每年進行災難復原演練計畫。

2. 資訊系統存取控管

- 應用系統與檔案存取設定權限控管，以保障資訊機密性。

- 制定與實施帳號/密碼複雜度原則，並定期更新密碼，確保身份認證有效性。
- 針對離職、部門異動員工，資訊部門依據單據調整權限，確保資料授權即時且正確。
- 訂有非公司員工（協力廠商、外包商）申請帳號及系統使用管理辦法，通過申請後，開啟權限方可連線進入系統，並記錄處理情形。
- 針對外接資訊儲存媒體禁止接入個人終端裝置。
- 禁止私人電腦設備連接存取公司網路與資源，並建立設備認證管理機制。

3. 網路安全管理

- 對外設置防火牆來保護網路對外連結，並根據防火牆異常紀錄進行分析加強防護。
- 運用人工智慧（AI, Artificial Intelligence）快速辨識惡意攻擊，將資安情資匯入資安防禦系統。
- 連接網際網路及公司內部網路界接採多迴路機制來避免因斷線造成影響。
- 設置有資訊服務監控平台監看網路流量與連線狀態，當網路有狀況時能及時處理排除問題。
- 資訊部門不定期寄發郵件安全提醒宣導訊息予全體同仁，提醒同仁應保持開啟收到郵件的警覺心，以防日趨嚴重的釣魚惡意詐騙信件。
- 內部員工電腦皆安裝防毒軟體，防毒中控平台一但發現有中毒事件，將寄發通知信給 IT 相關人員進行電腦的病毒排除。
- 限制員工在外透過遠端連線至公司內部網路須符合資安控管，只有必要人員執行必要功能並經過授權可遠端連線回公司，遠端連線並須使用多因子認證的 VPN 安全連線。

有鑑於目前資安新興趨勢，如 DDoS 攻擊、勒索軟體、社交工程軟體、網站側錄與漏洞問題等，本公司已加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）會員與科學園區資安資訊分享與分析中心（SP-ISAC）會員，藉由每年與知名資安廠商交流及專案合作，持續關注最新資安議題並規劃因應計畫，針對不同資安情境進行 DDoS、APT 攻防演練，強化處理人員的應變能力，以期能在第一時間即時偵測並阻擋。

114 年度資通安全措施推動執行成果：

- 專責人員：設有資安處且配置專責資安人員 3 人，於 114 年度完成 30 小時的專業資通安全相關訓練。
- 教育訓練：集團全體員工均須通過資安認知與社交郵件教育訓練並通過測驗。
- 社交工程：每年執行社交工程演練，未通過者須進行補課或再訓練課程，降低社交攻擊風險。114 年度社交工程演練測驗全體使用者皆通過考驗。
- 資安公告：資安公告與宣導，追蹤資安新知不定期發布與宣導資訊安全相關事宜。
- 資安維運：投入適當資源，持續改進或調整，使公司達到制定之資訊安全目標。
- ISO 驗證：113 年 9 月取得 ISO27001 資訊安全管理系統認證，並於 114 年 9 月通過複驗。
- 資安稽核：第三方稽核，第三方廠商進行資訊安全稽核。
- 資安成效：Security Scorecard 之系統弱點掃描工具評分平均得分 98 分。

- 資安保險：本集團已投保部分資安保險，作為因應資安威脅的風險管理解決方案之一。
- 委由專業資安廠商進行紅隊演練，提升應對潛在攻擊的能力與防護。
- 透過資訊安全委員會制定並定期稽核資安相關 KPI，提升組織的資安成熟度，114 年達成三項指標 100%落實於全球海內外子公司。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
土地租賃契約	新竹科學園區管理局	110.01.01~ 129.12.31	面積 4,633 平方公尺	限目的事業用途使用
土地租賃契約	新竹科學園區管理局	107.01.29~ 126.12.31	面積 12,004.74 平方公尺	限目的事業用途使用
土地租賃契約	新竹科學園區管理局	109.02.01~ 128.12.31	面積 47,632.03 平方公尺	限目的事業用途使用
供貨合約	客戶 C	106~116	矽晶圓供貨合約	依合約約定
離岸風電購售契約	續興股份有限公司	114~146	購買離岸風電 15.5MW 設備產生電量	依合約約定

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	114 年度	113 年度	差 異	
				金 額	變動比例%
流動資產		86,629,456	80,491,722	6,137,734	8%
不動產、廠房及設備		107,241,239	119,074,144	(11,832,905)	-10%
無形資產		2,318,929	2,448,363	(129,434)	-5%
其他資產		22,153,193	22,566,342	(413,149)	-2%
資產總額		218,342,817	224,580,571	(6,237,754)	-3%
流動負債		54,108,725	65,064,566	(10,955,841)	-17%
非流動負債		70,939,034	68,488,214	2,450,820	4%
負債總額		125,047,759	133,552,780	(8,505,021)	-6%
股本		4,781,137	4,781,137	-	-
資本公積		44,763,934	45,720,158	(956,224)	-2%
保留盈餘		52,139,099	47,641,022	4,498,077	9%
股東權益總額		93,295,058	91,027,791	2,267,267	2%
1. 最近二年度增減比例達 20%者分析說明：無					
2. 影響重大者之未來因應計劃：無。					

二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入		60,597,938	62,626,004	(2,028,066)	-3%
營業毛利		14,623,541	19,803,501	(5,179,960)	-26%
營業損益		8,636,332	14,118,185	(5,481,853)	-39%
營業外收入及支出		880,044	(1,689,619)	2,569,663	-152%
稅前淨利		9,516,376	12,428,566	(2,912,190)	-23%
所得稅費用		2,204,715	2,589,786	(385,071)	-15%
本期淨利		7,311,661	9,838,780	(2,527,119)	-26%
其他綜合損益(稅後淨額)		(1,219,488)	493,595	(1,713,083)	-347%
本期綜合損益總額		6,092,173	10,332,375	(4,240,202)	-41%
最近二年度增減比例達 20%者分析說明：					
(1)營業毛利及營業損益：本期因海外廠區擴廠進行試產，致毛利率下降，獲利減少。					
(2)營業外收入及支出：本期持有海外有價證券因股價波動評價認列利益增加。					
(3)其他綜合損益：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額變動。					

三、現金流量：

(一)最近年度(114 年度)現金流量變動之分析說明

(1)財務分析

單位：新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額 (1)	全 年 來 自 營 業 活 動 淨現金流量(2)	全 年 現 金 流 出 (入) 量 (3)	現 金 剩 餘 (不 足) 數 額 (1)+(2)-(3)	現 金 不 足 額 之 補 救 措 施	
				投 資 計 劃	理 財 計 劃
38,929,337	12,744,715	32,189,896	19,484,156	NA	NA
本 年 度 現 金 流 量 變 動 情 形 分 析： (1)營業活動：本年度持續獲利，營業活動淨現金為淨流入。 (2)投資活動：本年度購置固定資產，使投資活動為淨現金流出。 (3)籌資活動：本年度發行公司債，使籌資活動為淨現金流入。					

(二)流動性不足之改善計畫：本公司無現金不足額之情形，尚無流動性不足之虞。

(三)未來一年度(115 年度)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額 (1)	預 計 全 年 來 自 營 業 活 動 淨現金流量(2)	預 計 全 年 現 金 流 出 (入) 量 (3)	預 計 現 金 剩 餘 (不 足) 數 額 (1)+(2)-(3)	預 計 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施	
				投 資 計 劃	理 財 計 劃
19,484,156	10,328,955	4,487,599	25,325,512	NA	NA
1.未來一年度現金流動性分析： (1)營業活動：預期持續獲利，使營業活動產生淨現金流入。 (2)投資活動：預期補助款可如期入帳，使投資活動產生淨現金流入。 (3)融資活動：因償還外部借款使融資活動產生淨現金流出。 2.預計現金不足額之補救措施：無。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司 114 年度重大資本支出為取得不動產、廠房及設備，資金來源主要係以自有資金及銀行借款支應。本公司進行的產能擴充計劃將能有效提升產能和技術領先優勢，有助於公司在半導體市場中保持領先地位，並為股東創造持續的價值。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)轉投資政策：

本公司依循主管機關訂定之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂有「取得或處分資產處理程序」作為本公司進行轉投資事業之依據，以掌握相關之業務與財務狀況；另本公司為提升對轉投資公司之監督管理，於內部控制制度中訂定對子公司監控管理辦法，針對其資訊揭露、財務、業務、存貨及營運之管理制定相關規範，使本公司之轉投資事業得以發揮最大效用。

(二)最近年度轉投資事業獲利或虧損之主要原因及改善計畫

單位：新台幣仟元

轉投資事業名稱	114 年度認列之投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
GlobalSemiconductor Inc.	201,501	營業狀況正常	無
GlobalWafers Japan Co., Ltd.	1,023,371	營業及獲利狀況穩定	無
GlobalWafers GmbH	(895,362)	營業狀況正常	無
GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.	2,510,690	營業狀況正常	無
GlobalWafers B.V.	(2,875,757)	受海外廠區擴廠影響	無
旭愛能源股份有限公司	20,232	營業狀況正常	無
旭信電力股份有限公司	(8,503)	營業狀況正常	無
寰球鑫投資股份有限公司	53,318	營業狀況正常	無
環球晶資本股份有限公司	496,329	營業狀況正常	無
弘望投資股份有限公司	48,009	營業狀況正常	無
兆遠科技股份有限公司	733,824	營業狀況正常	無
Crystalwise Technology (HK) Limited	(179)	營業狀況正常	無
元鴻(山東)光電材料有限公司	(37)	營業狀況正常	無
昆山中辰矽晶有限公司	197,396	營業及獲利狀況穩定	無
MEMC Electronic Materials Sdn. Bhd.	67,622	營業及獲利狀況穩定	無
昆山辰巨電子科技有限公司	7,658	營業狀況正常	無
上海召業申凱電子材料有限公司	(5,632)	營業狀況正常	無
忻州元鴻信息材料有限公司	(3,365)	營業狀況正常	無
MEMC Japan Ltd.	95,876	營業及獲利狀況穩定	無
MEMC Electronic Materials S.p.A.	(942,127)	本期擴廠進行試產	無
MEMC Electronic Materials France SarL	975	營業狀況正常	無
Topsil GlobalWafers A/S	101,937	營業狀況正常	無
GlobiTech Incorporated	(2,535,105)	轉投資公司擴廠進行試產	無
MEMC LLC	(1,148,597)	本期擴廠進行試產	無
GlobalWafers America, LLC	(1,198,161)	本期擴廠進行試產	無
MEMC Korea Company	451,028	營業及獲利狀況穩定	無
MEMC Ipoh Sdn. Bhd.	581	結束營業	無
安科思資本股份有限公司	132,549	營業狀況正常	無

(三)未來一年投資計畫：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1.利率：本公司及子公司財務體質健全，信用記錄良好，金融機構授信條件較為優惠，因此公司在借款成本上能享有較佳之條件，借款內容依實質資金需求區分為短期借款及中長期借款，公司借款項目評估基準以取得資金之成本以及還款條件為主要考量，又部分週轉之短期信用借款屬於外幣幣別，動用時皆會考量匯率狀況作為工具選擇判斷。
- 2.匯率：本公司及子公司進銷貨交易外幣部位以採負債及資產部位互抵之自然避險為原則，盡量降低曝露於匯率波動風險下之淨部位，並由財務單位密切觀察匯率之走勢，必要時搭配以避險為目的之外匯操作工具，降低匯率波動對營運成本之影響。
- 3.通貨膨脹：通貨膨脹壓力衝擊世界經濟並擠壓企業利潤，惟本公司透過建立複數供應商及積極議價以降低前端採購成本，並同步調整終端售價以保留獲利，本公司及子公司亦隨時注意物價波動情形，必要時採取對應措施。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司及子公司並無從事高風險、高槓桿之投資。
- 2.本公司及子公司從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易，係依本公司及子公司之資金貸與他人作業程序、背書保證辦法、從事衍生性商品交易處理程序及主管機關相關規定辦理，並依規定期稽核及公告，執行單位亦會依循相關管理辦法進行內部審核及監控，不致對營運造成風險。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

半導體晶圓為半導體元件之基本，隨著半導體產品應用領域越趨廣泛且品質規格要求與日俱進，本公司持續觀察市場脈動及技術發展方向，配合客戶現在及潛在需求，積極投入新技術、新產品之開發，未來主要開發項目如下：

A、12吋奈米製程矽基板技術開發

B、新世代感測元件與通訊元件基板技術開發

在研發費用方面，主要是依據新產品及新技術之開發時程逐步配合編列，本公司113年及114年研發費用佔營業收入總額之比重分別為3.70%及3.66%，115年本公司預計投入之研發費用約占當年度營收之3%至5%，並將視營運狀況及市場情勢變化適時規劃調整，以保持本公司在產業市場之競爭優勢。

類別	預計研究開發案說明
製程改善研究開發	<ol style="list-style-type: none"> 1. 低能耗長晶熱場設計開發 2. 低污染低能耗線切割製程開發 3. 先進長晶/晶圓製程良率提升
品質改善研究開發	<ol style="list-style-type: none"> 1. 晶體缺陷控制與量測技術開發 2. 超平坦矽晶圓加工技術開發 3. RFSOI 製程良率技術開發 4. 光激發螢光(PL)與 FTIR 技術應用於低碳矽晶體量測技術開發
設備改善研究開發	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自動化與數位化製造系統開發 2. 高生產力、高晶體品質、長晶爐設計開發 3. 低能耗製程設備設計開發 4. 微小 LPD 矽表面檢測方法開發 5. 次世代功率元件用 8 吋 FZ 長晶爐
新產品開發	<ol style="list-style-type: none"> 1. 導電型與半絕緣與較大尺寸碳化矽晶體與晶圓開發 2. 次世代 RF 元件用 SOI 基板開發 3. 8 吋氮化鎵磊晶新產品開發 4. 8 吋碳化矽磊晶晶圓開發 5. 12 吋碳化矽長晶關鍵設備及長晶技術開發計畫 6. 先進封裝應用客製化特殊晶圓 7. 矽光子應用客製化特殊晶圓

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司及子公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握市場環境變化，並適時主動提出因應措施，截至年報刊印日止，本公司及子公司並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意所處行業相關科技改變情形，掌握市場趨勢，並評估其對本集團營運所帶來之影響。惟近年尚無重大科技改變或產業變化而對本公司及子公司財務業務有重大影響之情事。

本公司已設立資通安全組織並建立網路與電腦相關資安防護措施，透過持續檢視和評估資訊安全管理辦法及程序，以確保其適當性和有效性。本公司持續加強資訊安全防護措施，以期保護公司免於惡意軟體及駭客攻擊，另建置有完善的備份備援機制，期能在遭受攻擊後，於很短的時間內恢復系統正常運作，使傷害降到最低。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司自設立以來專注於本業經營，遵守相關法令規定，積極強化內部管理與提昇管理品質及績效，以持續維持優良企業形象，增加客戶對公司之信任，本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，尚未有因企業形象改變而造成公司營運危機之情事。惟企業危機之發生可能對企業產生相當大之損害，故本公司及子公司將持續落實各項公司治理要求，以降低企業風險之發生及對公司之影響。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司辦理併購相關事項，均依「企業併購法」及「取得或處分資產作業程序」等相關規範審慎評估其策略效益與潛在風險，並於決策過程中兼顧整體營運發展、財務健全性及股東權益，以適時採取必要之風險控管與因應措施。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

為滿足科技創新所帶來的半導體單位含量增加需求，並著眼於半導體長期發展動能，本公司執行大規模產能擴充計劃，主要用於擴增 12 吋晶圓和化合物半導體的產能，投資地區橫跨亞洲、歐洲和美國。擴產項目包含 12 吋晶圓與磊晶、8 吋與 12 吋 SOI、8 吋 FZ、SiC 晶圓（含 SiC Epi）、GaN on Si 等大尺寸次世代產品。擴充廠區包括義大利、丹麥、美國、日本、韓國及台灣，擴產計劃積極進行中，除了客戶以預付款預定產能外，本公司並掌握各國半導體自主化浪潮，同步申請實施資本支出計畫當地的政府補助。截至年報刊印日止，大部分現有廠區擴建（brownfield projects）已完工並開始貢獻營收，位於美國的新建廠區計畫（greenfield expansion）順利進行，已進入量產爬坡與客戶驗證階段，新產能將逐步提升。

有鑑於半導體產業之景氣波動可能對新增產能帶來風險及影響，本公司此次的產能擴增是依據客戶確認的長約訂單進行，新產能將優先提供給長約客戶；產能總規模亦會視全球經濟最新發展而彈性調整；關於通膨帶來的原料漲價影響及世界政經情勢變化所衍生的運輸限制及成本增加，本公司持續與供應商及客戶積極議價與溝通，以降低景氣波動及充滿不確定性的總體經濟對公司之影響。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司為原物料建立複數供應商，以避免過度仰賴單一供應商的斷鏈風險。在銷貨方面，本公司的客戶地區別佔比分配均衡，在亞洲、歐洲及美洲皆有重要客戶，綿密的銷售渠道及生產據點亦遍布全球，以在地供應、在地銷售降低總體經濟、地緣政治及全球運輸系統所帶來的不確定性。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件

- 1.截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無
- 2.公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1. 智慧財產權之管理及風險因應措施：

【智慧財產管理計畫】

(1) 智慧財產管理策略

為了呼應公司營運策略，成為全球規模最大、產品最完整的晶圓供應商，同時搭配研發策略於次世代產品技術的持續開發，本公司擬定智財管理策略，期望透過智財管理制度的運作提升智財管理能力，強化產品專利佈局、建構完善的機密管理機制，提升公司競爭力、保障公司及客戶權益。

(2) 智慧財產管理制度與 TIPS 認證

環球晶圓自成立以來沿襲母公司對智慧財產權的重視，於 2013 年開始進行『台灣智慧財產管理系統(TIPS)』的導入，以專利與營業秘密為主要標的，逐步強化智財管理系統各項辦法，包括：

- ✓ **專利管理**：對提案審查、專利申請與維護進行規範，透過獎勵制度鼓勵員工創新提案。專利審查時除考量法規規定外，亦會考量是否具有節能減碳之綠色影響力，以鼓勵綠色專利布局。
- ✓ **機密管理**：對公司各項機密資料進行等級區別，加強標示識別、權限管控等作業。透過每年度的 TIPS 內部稽核，針對機密資料是否妥善管理進行確認。
- ✓ **研發管理**：建立自行開發與委外合作管理規範，包括研發前的風險分析、研發中的紀錄管理、研發後的成果審查等。同時建立與外部合作時的合約審核原則，確保公司權益。

此外公司也持續參與 TIPS 稽核驗證，期望藉此落實智財管理機制。陸續於 2013 年通過 TIPS 基礎驗證、2014 及 2015 年通過 TIPS 深入驗證，2016、2017、2019、2021、2023 與 2025 年通過 AA 級驗證，最新證書有效期間至 2027 年 12 月 31 日止。

(3) 可能遭遇風險與因應政策

有鑒於機密外洩事件於新聞上時有所聞，為了避免公司辛苦產出技術遭人竊，同時必須保障客戶權益，公司持續強化機密管制方案，避免可能的風險發生。在人員管理部分，定期舉辦機密管制訓練宣導，提升員工對於營業秘密管理認知，強化員工對於釣魚郵件的認知，避免網路資安問題發生。在設備管制部分，透過電子郵件外寄管制、電子儲存裝置管制，減低內部資料外洩可能。最重要的是，定期舉辦 TIPS 內部稽核，對各單位機密管制落實程度進行調查，提升管理量能。

【智慧財產管理計畫執行成果】

(1) 2025 年智財系統執行情況

智財政策	執行情況摘錄說明
提升智財管理能力	針對各部門新進同仁提供所需的智慧財產權訓練課程，涵蓋智慧財產權介紹、公司機密管理機制、專利檢索策略、專利地圖製作、TIPS 執行要點及 TIPS 內部稽核員訓練等多元化內容。
強化產品專利佈局	2025 年總公司專利累積量 519 件，其中已獲證專利 395 件、申請中專利 124 件，寬能隙產品與技術佔比較高約 70%，已累積達 381 件專利。
完善機密管理機制	今年度 TIPS 內部稽核稽核總數為 359 件，總缺失件數 9 件，總觀察建議事項件數 16 件。已妥善進行原因分析與矯正預防措施，避免相同問題再發。

(2) 智財權成果清單

截至 2025 年 12 月 31 日，環球晶圓集團(含海外)於全球有效專利量已突破 2,737 件，其中已獲證專利數量累積達 1,808 件。集團專利佈局方向涵蓋各種主要產品(不同材料尺寸)之晶體生長、晶圓加工、品質檢驗等關鍵技術。除申請專利外，亦根據不同技術發展包含相關特殊長晶、加工製程之營業秘密。

(3) 智慧財產之主要用途與貢獻

智慧財產權對集團來說，除了可以彰顯技術發展能量外，亦可創造策略聯盟機會，提升公司整體競爭力，爭取客戶信賴與認同。尤其在發展新技術或新產品時，在該領域進行專利佈局，避免可能的智財風險相當重要。智慧財產權不只是開發下一代產品的競爭利器，同時也是能夠抵禦所有競爭者造成影響、公司得以永續經營的重要利器。

針對前述智財管理規劃與執行情況，本公司至少每年一次提報至董事會說明，最近一次提報日期為 2025 年 11 月 4 日。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：本公司最近年度之關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書，請參見公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)

首頁>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區 (公司代號：6488)。

網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

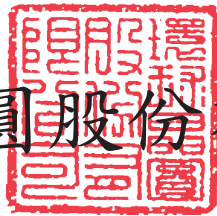
三、其他必要補充說明事項：

本公司於上櫃掛牌後，應續行之承諾事項辦理情形

上櫃承諾事項	承諾事項辦理情形
本公司於「取得或處分資產處理程序」訂有上櫃承諾事項－「本公司不得放棄對 Global Semiconductor Inc.(以下簡稱 GSI) 及 Global Wafers Japan Co., Ltd. 未來各年度之增資; GSI 不得放棄對昆山中辰矽晶有限公司未來各年度之增資; 本公司及本公司之子公司不得放棄對 GlobiTech Incorporated 未來各年度之增資。未來若各該公司因策略聯盟考量或其他因素，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須先經櫃買中心同意，復提經公司董事會特別決議通過。且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報櫃買中心備查。」	<p>本公司於 104 年 11 月 9 日董事會及 105 年 6 月 22 日股東會通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」一增訂上櫃承諾事項。</p> <p>為集團組織整合，本公司之子公司 GWafers Inc. 與 Global Wafers Japan Co., Ltd. 已於 107 年 1 月 1 日正式合併。因應此組織調整，本公司於 107 年 3 月 20 日董事會及 107 年 6 月 25 日股東會通過修訂「取得或處分資產處理程序」之上櫃承諾事項，並輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露及函報櫃買中心。</p> <p>為集團組織整合，本公司之子公司 GlobiTech Incorporated 之股權由原本公司子公司 Global Wafers Inc. 項下移轉至本公司子公司 Global Wafers B.V. 項下，仍為本公司持股百分之百之子公司。鑑於以上，本公司於 108 年 3 月 19 日董事會及 108 年 6 月 25 日股東會通過修訂「取得或處分資產處理程序」之上櫃承諾事項，並輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露及函報櫃買中心。</p> <p>為響應政府境外資金回台政策及增進集團資金運用效能，本公司於 108 年 12 月 10 日董事會通過境外資金匯回案。於境外資金匯回案下，本公司之子公司 GWI 將於完成盈餘分配並出售其項下持有之新加坡子公司 GWafers Singapore Pte. Ltd.(簡稱 GWS) 股權予本公司二年期滿後進行清算。本公司於 GWI 清算後，仍持有 GWS 及其子公司 100% 股權，於集團整體股權控制及合併損益無影響。因應前述二年期間已滿，GWI 於 111 年 11 月 1 日已清算完成。鑑於以上組織架構調整，本公司於 111 年 12 月 6 日董事會及 112 年 6 月 20 日股東會通過修訂「取得或處分資產處理程序」之上櫃承諾事項，並輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露及函報櫃買中心。</p>

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

環球晶圓股份有限公司



負責人：徐秀蘭



